

苏州英尔捷微电子股份有限公司
Inbest Micro Electronic(Suzhou) Co., Ltd.

公开转让说明书
(申报稿)

主办券商



二零一八年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）实际控制人变更风险

有限公司成立初期，李伟为公司的控股股东及实际控制人。2017 年 9 月，李伟将其持有的股权全部转让，不再是公司的控股股东及实际控制人。同时，英尔捷智能向公司进行增资，持股比例为 59.28%，成为公司的控股股东，陆孙华同时成为公司的实际控制人。公司实际控制人变更前后，公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未产生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

（二）公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和总经理组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了公司治理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较晚，公司治理层对相关规章制度还尚未理解和全面执行。因此，短期内仍存在公司治理不规范的风险。

（三）行业政策变动的风险

集成电路产业属于国家鼓励发展的行业，国家相关主管部门多年来陆续颁布了多项支持集成电路产业发展的规划和政策，充分体现出国家对集成电路产业的重视。国家的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前一系列的政策性文件对行业的发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业的发展，另外还存在一些政策落实不到位、与市场脱节的情况，这些都可能对公司生产经营造成不利影响。

（四）宏观经济波动的风险

集成电路芯片运用范围广，产品涉及消费类电子、工业控制、汽车电子、医疗等诸多领域，尤其是消费类电子领域，市场规模大，产品更新速度快等特点为集成电路芯片的应用提供了巨大的发展空间。但同时消费类电子也是受宏观经济波动影响较为明显的行业，一旦宏观经济发生波动，下游市场的需求萎缩将会阻碍本行业的持续发展。

（五） 技术研发与创新风险

集成电路行业所面对的下端终端市场产品更新换代迅速，因此芯片产品生命周期很短，升级频繁。为了在行业中保持一定的竞争力，要求集成电路公司在技术创新及新产品开发方面持续投入，不断创新，开发出市场认可的新产品和升级产品，才能实现持续成长。公司未来若无法保持对行业高端人才的吸引力，维持一支具有持续创新能力、良好项目管理能力和敏锐市场判断能力的人才队伍，则可能因研发和创新能力不足导致技术落后企业发展停滞。

集成电路企业还面临新产品研发风险，包括产品规划、研发周期及投入风险。产品规划包括产品路线图、新产品的开发以及功能定位。新产品的研发周期通常在两到三年，这取决于公司对未来两到三年甚至更长期的市场预判，而对未来市场预测的准确性往往存在一定的局限。若未来公司产品研发失败，或者不能被市场接受，不能实现量产，则投入的大量的研发资金不能产生效益。此外，研发周期如果过长会导致研发投入大幅增加，增加产品的研发成本，对公司的经营业绩造成不利影响。

（六） 应收账款坏账风险

公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快。2018 年 7 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 10,408,346.38 元、11,524,790.43 元、3,193,752.02 元。随着公司业务发展，企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

（七）经营场所后期装修未办理消防备案，存在被行政处罚的风险

公司经营场所-苏州市工业园区双马街2号星华产业园19-2建设完成时已取得苏园公消竣复字（2015）第0010号的验收并已备案，但公司后期对经营场所的装修中未按相关规定及时进行第一时间进行消防备案。虽然公司备案工作已经开始办理，然而，仍然存在被消防部门行政处罚的风险，可能会对公司及子公司经营产生不利影响。

目录

声明	II
重大事项提示	III
目录	VI
释义	8
第一节 基本情况	10
一、公司概况	10
二、公司股票基本情况	11
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	13
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	26
五、报告期主要会计数据及主要财务指标	28
六、本次挂牌的有关机构	31
第二节 公司业务	33
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途	33
二、公司内部组织结构图和业务流程	39
三、公司业务相关的关键资源情况	42
四、公司业务相关情况	53
五、公司的商业模式	60
六、公司所处行业的情况	62
七、公司未来发展规划	75
第三节 公司治理	77
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	77
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估	78
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况 ..	80
四、公司的独立性	81
五、公司报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	82
六、同业竞争的情况	83
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明	86
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	89

第四节 公司财务会计信息	92
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表	92
二、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	121
三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标分析	147
四、营业收入、主要费用、利润形成的有关情况	152
五、报告期的主要资产情况	165
六、报告期的主要负债情况	185
七、报告期的股东权益情况	193
八、关联方、关联方关系及关联交易	194
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	202
十、报告期内的资产评估情况	203
十一、股利分配情况	203
十二、控股子公司情况	205
十三、风险因素及自我评估	207
第五节 有关声明	211
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	211
二、主办券商声明	212
三、律师事务所声明	214
四、会计师事务所声明	215
五、资产评估机构声明	216
第六节 附件	217

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、英尔捷、股份公司	指	苏州英尔捷微电子股份有限公司
英尔捷有限、有限公司	指	苏州英尔捷微电子有限公司
英尔捷智能	指	苏州英尔捷智能控制有限公司，曾用名“苏州英深微纳米科技有限公司”
英格诺	指	苏州英格诺智能科技有限公司
捷研芯	指	苏州捷研芯纳米科技有限公司
英尔捷芯片	指	苏州英尔捷芯片设计有限公司，公司全资子公司
英尔捷半导体	指	苏州英尔捷半导体有限公司，公司全资子公司
喜之家	指	上海喜之家创业投资中心（有限合伙）
寰旭文化	指	上海寰旭文化传播有限公司
朴存创业	指	上海朴存创业投资中心（有限合伙）
曙荣信息	指	上海曙荣信息科技有限公司
同济建筑	指	上海同济建筑工程有限公司
同舟电梯	指	上海同舟电梯有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	苏州英尔捷微电子股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	苏州英尔捷微电子股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	苏州英尔捷微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州英尔捷微电子股份有限公司董事会
监事会	指	苏州英尔捷微电子股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

		《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京盈科（上海）律师事务所
工商局	指	工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品
IC	指	集成电路(integrated circuit)，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及设计创新的能力上。
QC	指	质量控制(Quality Control) 为达到规范或规定对数据质量要求而采取的作业技术和措施。质量控制是为了通过监视质量形成过程，消除质量环上所有阶段引起不合格或不满意效果的因素。以达到质量要求，获取经济效益，而采用的各种质量作业技术和活动。
WB	指	集成电路焊接工艺
半导体分立器件	指	泛指半导体晶体二极管、半导体三极管简称二极管、三极管及半导体特殊器件。
IDM 模式、IDM	指	Integrated Device Manufacture，集成器件制造模式；整合组件制造商。
ASML	指	是总部设在荷兰 Veldhoven 的全球最大的半导体设备制造商之一，向全球复杂集成电路生产企业提供领先的综合性关键设备。
ASM	指	太平洋科技有限公司，全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商之一。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称:	苏州英尔捷微电子股份有限公司
英文名称:	Inbest Micro Electronic(Su Zhou) Co., Ltd.
法定代表人:	陆孙华
有限公司设立日期:	2011 年 8 月 17 日
股份公司设立日期:	2018 年 2 月 27 日
注册资本:	4,880 万元
住所:	苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 19-2 号厂房
办公地址:	苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 19 幢 01 室
邮编:	215121
电话:	0512-65952847
传真:	0512-65952847
互联网网址:	http://www.inbest.org/
电子邮箱:	inbest@inbest.org
董事会秘书:	沈霞
信息披露负责人:	沈霞
经营范围:	从事电子科技、半导体科技、纳米科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让;从事半导体集成电路相关设备及配件的研发、制造、销售及技术支持;生产、销售:传感器、半导体材料、纳米材料、电子产品、半导体集成电路产品,从事上述产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业:	根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码为 C39);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码为 C39)—集成电路制造(代码为 3973)。根据公司具体业务情况,公司所在的细分子行业为集成电路行业,根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为集成电路制造(代码为 C3963);根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为半导体产品与设备(代码为 171210)。

主要业务：	半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及封装测试和集成电路封装测试设备的维修改造升级。
统一社会信用代码：	91320594581044211R

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：48,800,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：集合竞价

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东

及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东已按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条以及《公司章程》第二十五、二十六条的要求锁定其所持有的公司股份。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无其他自愿锁定的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

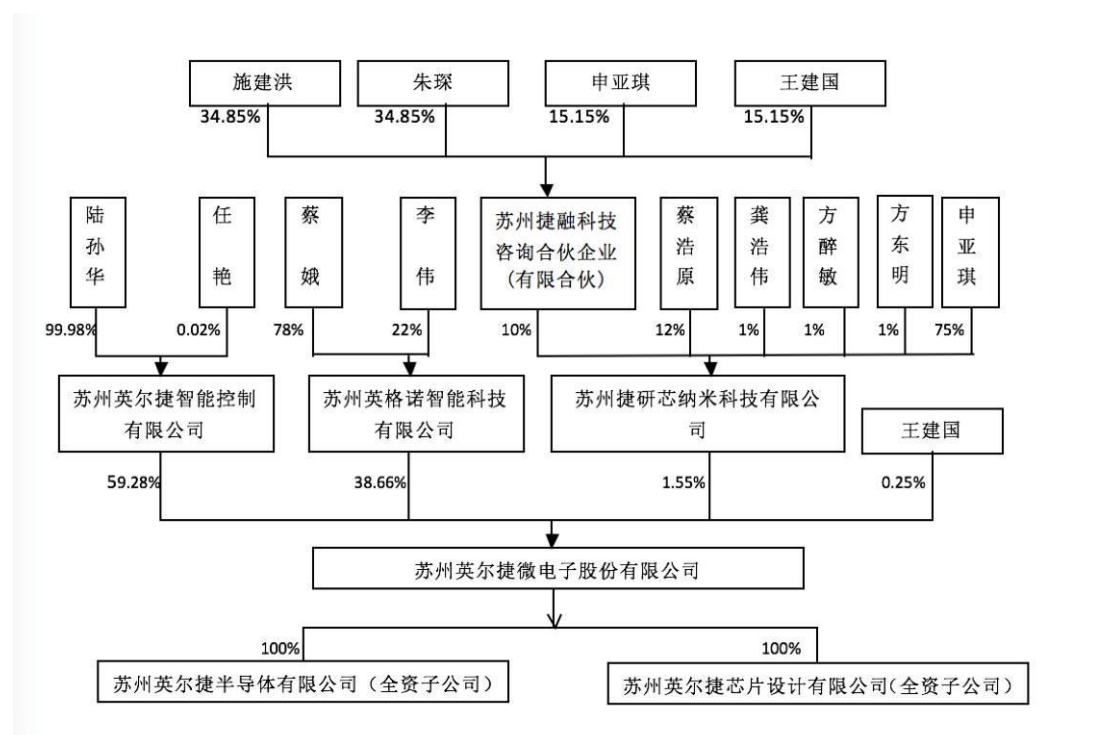
截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条规定、《公司章程》第二十五条的规定，本次无可进入全国股转系统公开转让的股份。具体情况如下：

序号	股东名称/ 姓名	股东性质	是否担任 董监高	挂牌前持有 股份数(股)	持股比例 (%)	挂牌后 可转让 股份数 (股)	挂牌后转让 限售股份数 (股)
1	英尔捷智能	法人股东	-	28,927,835	59.28	0	28,927,835
2	英格诺	法人股东	-	18,865,980	38.66	0	18,865,980
3	捷研芯	法人股东	-	754,639	1.55	0	754,639

4	王建国	自然人股东	否	251,546	0.52	0	251,546
合计			-	48,800,000	100	0	48,800,000

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

(一) 公司的股权结构图



公司股权均为股东本人真实出资且真实持有，报告期内曾经存在股权代持的情形，2017年9月已全部解除，现公司股权清晰，不存在代持的情形。公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格的情况。

(二) 前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况

1、前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况如下：

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	英尔捷智能	法人股东	28,927,835	59.28	否
2	英格诺	法人股东	18,865,980	38.66	否
3	捷研芯	法人股东	754,639	1.55	否
4	王建国	自然人股东	251,546	0.52	否

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
合计			48,800,000	100.00	--

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押或其他转让限制情况。公司股东所持公司股份不存在直接或间接代持的情形，股权结构清晰、权属分明、真实确定，股东所持公司股份也不存在权属争议或潜在纠纷。

公司股东的基本情况如下：

（1）苏州英尔捷智能控制有限公司

曾用名“苏州英深微纳米科技有限公司”，英尔捷智能现持有公司股份 28,927,835 股，占公司股份总额的 59.28%。

英尔捷智能现持有苏州市吴江区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320509MA1Q4CUX8Q），住所为苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号，法定代表人为陆孙华，注册资本为 4,800 万元，经营范围为“自动化控制系统、计算机及物联网领域内的技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本公开转让说明书签署日，英尔捷智能的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例(%)
1	陆孙华	4,799.00	99.98
2	任 艳	1.00	0.02
合计		4,800.00	100.00

英尔捷智能未以非公开方式向投资者募集资金而设立，其资产并未由基金管理人进行管理，其自身亦无专业的基金管理人员，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。

（2）苏州英格诺智能科技有限公司

曾用名“苏州英格诺纳米科技有限公司”，英格诺现持有公司股份 18,865,980 股，占公司股份总额的 38.66%。

英格诺现持有苏州市吴江区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320509MA1Q4CMD3N），住所为苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号，法定代表人为蔡娥，注册资本为 2,000 万元，经营范围为“智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本公开转让说明书签署日，英格诺的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例(%)
1	蔡 娥	1,560.00	78.00
2	李 伟	440.00	22.00
合计		2,000.00	100.00

英格诺未以非公开方式向投资者募集资金而设立，其资产并未由基金管理人进行管理，其自身亦无专业的基金管理人员，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。

（3）苏州捷研芯纳米科技有限公司

捷研芯现持有公司股份 754,639 股，占公司股份总额的 1.55%。

捷研芯现持有苏州工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320594339247846R），住所为苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 05 幢 102 室，法定代表人为申亚琪，注册资本为 1,258.40 万元，经营范围为“从事纳米科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；生产、销售:半导体材料、纳米材料、电子产品、半导体集成电路产品、金属材料、五金交电；销售：化工产品；维修、销售:通讯器材、仪器仪表、环保设备、电子设备、半导体设备；从事上述产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本公开转让说明书签署日，捷研芯的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例(%)
1	申亚琪	943.80	75.00
2	蔡浩原	151.01	12.00

3	苏州捷融科技咨询合伙企业(有限合伙)	125.84	10.00
4	龚洁伟	12.58	1.00
5	方东明	12.58	1.00
6	方醉敏	12.58	1.00
合计		1,258.40	100.00

捷研芯未以非公开方式向投资者募集资金而设立,其资产并未由基金管理人进行管理,其自身亦无专业的基金管理人员,不属于私募投资基金或私募投资基金管理人,不需要进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。

(4) 王建国,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年8月至2004年6月,苏州金像电子有限公司,任助理工程师;2004年7月至2007年11月,飞索半导体苏州有限公司,任工程师;2007年11月至2009年6月,万代半导体上海有限公司,任高级工程师;2009年7月至2013年9月,上海星科金鹏半导体有限公司,任项目经理;2013年10月至2016年9月,苏州晶方半导体股份有限公司,任技术经理;2016年9月至今,苏州捷研芯纳米科技有限公司,任副总经理。

(三) 股东之间关系

股东捷研芯的实际控制人申亚琪女士是股东王建国先生的配偶,王建国与申亚琪系夫妻关系。

公司其他股东之间不存在关联关系。

(四) 公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

(1) 控股股东

公司控股股东为英尔捷智能。

英尔捷智能现持有公司 28,927,835 股,占股本总额的 59.82%。《公司法》第二百一十六条第二款规定:“控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上

的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。英尔捷智能所持股份比例占公司股本总额百分之五十以上，故认定其为公司的控股股东。

（2）实际控制人

公司的实际控制人为陆孙华。

陆孙华持有英尔捷智能 99.98%的股权，为英尔捷智能的实际控制人。另外，陆孙华现任公司董事长、总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，因此认定陆孙华为公司的实际控制人。

基于上述，公司的实际控制人为陆孙华，认定依据充分合法。

2、控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人基本情况如下：

（1）公司控股股东基本情况

英尔捷智能的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况”。

（2）公司实际控制人基本情况

陆孙华，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学电子技术专业。1989 年 7 月至 1994 年 5 月，任上海柴油机股份有限公司动力科科员；1994 年 6 月至 1999 年 10 月，任上海同济系统工程公司工程部经理；1999 年 10 月至 2000 年 11 月，任上海同致科技有限公司工程部经理；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，任上海同方科技有限公司执行董事；2004 年 12 月至 2010 年 6 月，任上海同讯网络工程有限公司经理；2010 年 7 月至 2016 年 5 月，任上海同济建筑工程有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，任上海同济物业有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 1 月，任有限公司执行董事；2018 年 2 月至今，任股份公司董事长、总经理。

3、控股股东及实际控制人报告期内变化情况

报告期内，2016 年 1 月至 2016 年 12 月，李伟持有公司 100%的股权；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，经过股权转让及增资，李伟持有 72%的股权，这期间李伟一直为公司的控股股东及实际控制人。2017 年 9 月，李伟将其持有的股权全部转让，不再是公司的控股股东及实际控制人。同时，英尔捷智能向公司进行增资，持股比例为 59.28%，成为公司的控股股东，陆孙华同时成为公司的实际控制人。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、2011 年 8 月，有限公司设立

2011 年 7 月 11 日，江苏省苏州市工商局下发《名称预先核准通知书》（名称核准号：320500M25693），核准有限公司名称为“苏州英尔捷微电子有限公司”。

2011 年 8 月 15 日，苏州瑞兴会计师事务所出具《验资报告》（苏瑞[2011]B274 号）：“截至 2011 年 8 月 15 日，英尔捷有限已收到李伟以货币缴纳的注册资本 50 万元，李华锋以货币缴纳的注册资本 50 万元，实收资本共计 100 万元。”

李伟、李华锋上述出资资金来源为自有资金，不存在股权代持的情形，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

2011 年 8 月 17 日，有限公司取得江苏省苏州工业园区工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320594000203950），住所为苏州工业园区娄葑镇新泽路 80 号，注册资本为 100 万元，实收资本为人民币 100 万元。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	李 伟	50.00	50.00	50.00	50.00	货币
2	李华锋	50.00	50.00	50.00	50.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	100.00	--

2、2015 年 10 月，有限公司第一次股权转让

2015年8月18日，有限公司股东会通过决议，同意股东李华锋将其持有的有限公司50%的股权以50万元的价格转让给李伟。同日，李华锋与李伟签订了《股权转让协议》。受让方李伟已足额支付给转让方李华锋股权转让价款。

2015年10月22日，有限公司取得江苏省苏州工业园区工商局换发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	李伟	100.00	100.00	100.00	100.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	100.00	--

3、2016年12月，有限公司第二次股权转让及第一次增资

2016年12月29日，有限公司股东会作出决定，股东李伟将持有的有限公司12%的股权以12万元的价格转让给新股东捷研芯；将10%的股权转让给新股东袁文武；将5%的股权转让给新股东潘道强；将1%的股权转让给王端富。同日，李伟与捷研芯、袁文武、潘道强、王端富就上述股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》。其中，袁文武、潘道强、王端富所受让的股权实际是为李伟代持并签订了《股权代持协议》，上述三人未支付股权转让对价。

同日，有限公司作出股东会决议，同意注册资本由100万元增至200万元，出资方式为货币，其中捷研芯增资12万元，袁文武增资10万元，潘道强增资5万元，王端富增资1万元，李伟增资72万元，出资时间截止到2026年12月28日。其中，袁文武、潘道强、王端富的增资均为在李伟的授意下代李伟增加认缴的注册资本。

2017年1月6日，有限公司取得江苏省苏州工业园区工商局换发的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	李伟	144.00	72.00	72.00	50.00	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
2	捷研芯	24.00	12.00	12.00	50.00	货币
3	袁文武	20.00	10.00	10.00	50.00	货币
4	潘道强	10.00	5.00	5.00	50.00	货币
5	王端富	2.00	1.00	1.00	50.00	货币
合计		200.00	100.00	100.00	50.00	—

4、2017年5月，有限公司第二次增资

2017年5月3日，有限公司作出股东会决议，同意注册资本由200万元增至500万元，出资方式为货币，其中捷研芯增资36万元，袁文武增资30万元，潘道强增资15万元，王端富增资3万元，李伟增资216万元，出资时间截至2026年12月28日。其中，袁文武、潘道强、王端富的增资均为在李伟的授意下代李伟增加认缴的注册资本。

2017年5月19日，有限公司取得江苏省苏州工业园区工商局换发的《营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	李伟	360.00	72.00	72.00	20.00	货币
2	捷研芯	60.00	12.00	12.00	20.00	货币
3	袁文武	50.00	10.00	10.00	20.00	货币
4	潘道强	25.00	5.00	5.00	20.00	货币
5	王端富	5.00	1.00	1.00	20.00	货币
合计		500.00	100.00	100.00	20.00	--

5、2017年9月，有限公司第三次股权转让及第三次增资

2017年9月3日，有限公司股东会通过决议，同意李伟将其持有的有限公司72%的股权（认缴出资360万元，实缴出资72万元）以72万元的价格转让给新股东英格诺；同意袁文武将其持有的有限公司10%股权（认缴出资50万元，实缴出资10万元）以10万元的价格转让给新股东英格诺；同意潘道强将其持有

的有限公司 5%股权（认缴出资 25 万元，实缴出资 5 万元）以 5 万元的价格转让给新股东英格诺；同意王端富将其持有的有限公司 1%股权（认缴出资 5 万元，实缴出资 1 万元）以 1 万元的价格转让给新股东英格诺。同日，各方就上述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。

上述股权转让行为中，袁文武、潘道强、王端富的股权转让行为是在李伟的授意下代为转让。同日，袁文武、潘道强、王端富分别与李伟签署了《股权代持终止协议》，代持行为已全部解除。

同日，有限公司股东会通过决议，同意注册资本由 500 万元增至 3,880 万元，本次新增注册资本 3,380 万元人民币，由新股东英格诺以货币增资 1,060 万元人民币，由新股东苏州英深微纳米科技有限公司以货币增资 2,300 万元人民币，新股东王建国以货币增资 20 万元人民币。

2017 年 9 月 12 日，有限公司取得江苏省苏州工业园区工商局换发的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	苏州英深微纳米科技有限公司	2,300.00	59.28	0.00	0.00	货币
2	英格诺	1,500.00	38.66	88.00	5.87	货币
3	捷研芯	60.00	1.55	12.00	20.00	货币
4	王建国	20.00	0.52	0.00	0.00	货币
合计		3,880.00	100.00	100.00	2.58	--

注：2017 年 9 月 20 日，股东苏州英深微纳米科技有限公司更名为苏州英尔捷智能控制有限公司。

6、2017 年 11 月，有限公司注册资本实缴完毕

根据苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司于 2018 年 1 月 4 日出具的“苏万隆验字（2018）第 1-0060 号”《验资报告》，截至 2017 年 11 月 29 日，有限公

公司已收到全体股东以货币缴纳的新增注册资本 3,780 万元，实收资本共计 3,880 万元。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	英尔捷智能	2,300.00	59.28	2,300.00	100.00	货币
2	英格诺	1,500.00	38.66	1,500.00	100.00	货币
3	捷研芯	60.00	1.55	60.00	100.00	货币
4	王建国	20.00	0.52	20.00	100.00	货币
合计		3,880.00	100.00	3,880.00	100.00	--

7、整体变更设立股份有限公司

2018 年 1 月 31 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司。

根据上海仟一会计师事务所有限公司 2018 年 1 月 12 日出具的沪仟专字（2018）第 3022《审计报告》（审计基准日为 2017 年 11 月 30 日），有限公司经审计账面净资产为 50,125,672.13 元；根据北京亚超资产评估有限公司 2018 年 1 月 15 日出具了北京亚超评报字（2018）第 A013 号《资产评估报告书》（评估基准日为 2017 年 11 月 30 日），有限公司净资产评估值为 5,027.48 万元。

2018 年 1 月 19 日，公司 4 名股东签订了《发起人协议书》。

2018 年 1 月 31 日，公司 4 名股东作为发起人召开创立大会，审议通过了关于有限公司整体变更为股份公司的议案，以公司经审计的净资产 50,125,672.13 元中的 38,800,000.00 元折算为股份公司股份，每股面值 1 元，其余 11,325,672.13 元计入资本公积金，股份公司总股本为 38,800,000 股；

2018 年 2 月 10 日，上海仟一会计师事务所有限公司出具了沪仟验字（2018）第 0011 号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本 3,880 万元。

2018 年 2 月 27 日，公司取得了江苏省工商局颁发的统一社会信用代码为 91320594581044211R 的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。

股份公司设立时各发起人的持股数及持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	英尔捷智能	23,000,000	59.28	净资产
2	英格诺	1,500,000	38.66	净资产
3	捷研芯	600,000	1.55	净资产
4	王建国	200,000	0.52	净资产
合计		38,800,000	100.00	--

注：鉴于上海仟一会计师事务所不具备从事证券期货业务资格，公司采取了如下补救措施：

①委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至审计基准日 2017 年 11 月 30 日的净资产审计情况进行复核，并出具了《审计报告》：“截至 2017 年 11 月 30 日，苏州英尔捷微电子股份有限公司的净资产为 50,019,785.46 元，与净资产折股时的净资产 50,125,672.13 元相差-105,886.67 元。”

②委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更申请股份公司设立登记时的注册资本实收情况进行了验资复核，并出具了《验资复核报告》，对上述出资情况进行了复核：“截至 2017 年 11 月 30 日止，苏州英尔捷微电子股份有限公司（筹）折合股本人民币 38,800,000.00 元，该股本总额不高于经审计的净资产值，余额 11,219,785.46 元计入资本公积，净资产为 50,019,785.46 元，与净资产折股时的净资产 50,125,672.13 元相差-105,886.67 元。”

根据上述事实，主办券商认为，有限公司整体变更时的发起设立行为存在的瑕疵已依法得到了规范，该瑕疵不会对公司本次申请挂牌转让造成实质性的法律障碍。

8、股份公司第一次增资

2018 年 3 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会并通过决议，同意公司以资本公积转增股本，以现有总股本 38,800,000 股为基数，以资本公积 10,000,000 元向全体股东以每 10 股转增 2.577320 股，资本公积转增共计 10,000,000 股，转增股本后股本增至 48,800,000 股。

2018 年 4 月 4 日，公司取得江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。

2018 年 6 月 4 日，上海仟一会计师事务所有限公司出具了“沪仟验字(2018)第 0036 号”《验资报告》，验证截至 2018 年 3 月 31 日，公司已收到资本公积 1,000 万元转增股本。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	英尔捷智能	28,927,835	59.28
2	英格诺	18,865,980	38.66
3	捷研芯	754,639	1.55
4	王建国	251,546	0.52
合计		48,800,000	100.00

注：本次增资过程中，自然人股东王建国已足额缴纳个人所得税。

（六）子公司相关情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 2 家全资子公司，分别是英尔捷半导体及英尔捷芯片。公司子公司的基本情况如下：

1、苏州英尔捷半导体有限公司

英尔捷半导体成立于 2017 年 8 月 28 日，法定代表人为李伟，住所为苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 19-2 号厂房，注册资本为 1,500 万元，经营范围为“开发、生产、销售；半导体及电子元器件、电子产品、电器、仪器仪表及设备；集成电路和半导体器件制造、测试服务,并提供与集成电路和半导体器件相关的售后服务和技术咨询;从事上述产品的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

英尔捷半导体的历史沿革如下：

2017 年 8 月 16 日，江苏省苏州市工商局下发《名称预先核准通知书》（编号：（05940319-yc）名称预先登记[2017]第 08160153 号），核准拟设立公司名称为“苏州英尔捷半导体有限公司”。

2017年8月28日，经苏州工业园区市场监督管理局登记注册，英尔捷半导体取得统一社会信用代码为91320594MA1Q5HLP4D的《营业执照》。

英尔捷半导体设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴比例（%）
1	英尔捷	1,500.00	100.00	600.86	40.06
合计		1,500.00	100.00	600.86	40.06

（2）苏州英尔捷芯片设计有限公司

英尔捷芯片成立于2017年11月24日，法定代表人为陆孙华，住所地为苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场1幢1507室，注册资本为2,000万元，经营范围为：“半导体、集成电路芯片设计、销售，并提供相关技术服务；计算机信息系统集成；软件开发、销售，并提供技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

英尔捷芯片的历史沿革如下：

2017年11月23日，江苏省苏州市工商局下发《名称预先核准通知书》（编号：（05940299-yc）名称预先登记[2017]第11230086号），核准拟设立公司名称为“苏州英尔捷芯片设计有限公司”。

2017年11月24日，经苏州工业园区市场监督管理局登记注册，英尔捷芯片取得统一社会信用代码为91320594MA1TC1951T的《营业执照》。

英尔捷芯片设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴比例（%）
1	英尔捷	2,000.00	100.00	0	0.00
合计		2,000.00	100.00	0	0.00

截至本公开转让说明书签署之日，注册资本尚未缴纳，其章程中规定的缴纳期限为2037年11月23日前。公司将根据英尔捷芯片实际经营需要，在章程规定的缴纳期限内完成出资。

公司子公司开展业务合法、合规，不存在因违法违规被主管机关进行处罚的情形。

（七）公司设立以来重大资产重组情况

公司成立以来无重大资产重组。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司现任董事会由 5 名董事组成，任期自 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

公司董事基本情况如下：

1、陆孙华，董事长：简历情况详见本节之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、沈霞，董事：女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至 2009 年 6 月，任苏州石路国际商城有限公司出纳；2009 年 7 月至 2011 年 4 月，任苏州盛世通网络技术有限公司主办会计；2011 年 5 月至 2017 年 3 月，任苏州创易技研股份有限公司财务主管；2017 年 3 月至 2017 年 7 月，任苏州英多智能股份科技有限公司财务经理；2017 年 8 月至 2018 年 1 月，任有限公司财务总监；2018 年 1 月至今，任股份公司董事、董事会秘书、财务总监。

3、李伟，董事：男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月至 2011 年 8 月，任三星 Techwin 上海分公司售后服务部经理；2011 年 8 月至 2018 年 1 月，先后任有限公司总经理、执行董事；2017 年 8 月至今，任苏州英格诺智能科技有限公司监事；2018 年 1 月至今，任股份公司董事。

4、张建，董事：男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 5 月至 2017 年 3 月，任江苏长电科技（股份）有限公司工程师；

2017年4月至2018年1月，任有限公司工程师；2018年1月至今，任股份公司董事、工程师。

5、叶明，董事：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2018年6月，任临沂泰源资产管理有限公司副总经理；2017年5月至今，任潍坊弘景源投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；2017年5月至今，任潍坊泰兴源投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；2018年1月至今，任股份公司董事。

（二）公司监事

公司现任监事会由3名监事组成，其中陈荣、任艳为股东监事，沈平为职工代表监事，任期自2018年1月31日至2021年1月30日。

公司监事基本情况如下：

1、陈荣，监事会主席：女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至2016年11月，任可利科技（苏州工业园区）有限公司主办会计；2016年12月至2017年3月，待业；2017年4月至2017年8月，任苏州原本图像科技有限公司主办会计；2017年9月至2018年1月，任有限公司主办会计，2018年1月至今，任股份公司监事会主席、主办会计。

2、任艳，监事，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2015年5月至今，任上海寰旭文化传播有限公司监事；2015年9月至今，任上海曙荣信息科技有限公司行政主管；2017年8月至今，任苏州英尔捷智能控制有限公司监事；2017年12月至今，任上海鼓霓新能源科技有限公司监事。2018年1月至今，任股份公司监事。

3、沈平，职工代表监事：男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月至2017年6月，任苏州晶方半导体科技股份有限公司生产主管；2017年7月至2018年1月，任有限公司制造经理，2018年1月至今，任股份公司监事、制造经理。

（三）公司高级管理人员

公司现任高级管理人员共 2 名，任期自 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

公司高级管理人员基本情况如下：

1、陆孙华，总经理：简历情况详见本节之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、沈霞，财务总监兼董事会秘书：简历情况详见“（一）公司董事”。

根据《公司法》及相关法律法规有关董事、监事、高级管理人员任职资格的相关规定，公司现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定担任董事、监事、高级管理人员的任职资格。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,051.24	6,970.44	2,483.71
股东权益（万元）	5,228.92	5,170.01	373.85
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）	5,228.92	5,170.01	373.85
每股净资产（元）	1.07	1.33	3.74
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	1.33	3.74
资产负债率(%) 母公司)	16.94	25.57	84.95
流动比率（倍）	2.08	1.32	0.60
速动比率（倍）	1.65	1.25	0.16
项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
营业收入（万元）	1,047.35	3,511.60	1,768.93
净利润（万元）	58.91	1,016.16	245.01
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	58.91	1,016.16	245.01

扣除非经常性损益后的净利润（万元）	79.28	1,013.48	245.05
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	79.28	1,013.48	245.05
毛利率(%)	30.08	47.45	23.35
净资产收益率(%)	1.13	84.90	97.48
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	1.52	84.67	97.50
基本每股收益（元/股）	0.0121	2.4486	2.4501
稀释每股收益（元/股）	0.0121	2.4486	2.4501
应收账款周转率（次/年）	0.96	4.77	3.43
存货周转率（次/年）	9.99	3.61	1.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-124.95	2,278.94	1,169.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.59	11.69

注：1、报告期内上述各项财务指标，均采用合并报表数据计算。

2、净资产收益率（加权平均）= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$ ，参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

3、归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。

4、每股净资产=所有者权益÷期末股本总额

5、资产负债率=总负债/总资产

6、流动比率=流动资产÷流动负债

7、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）÷流动负债，考虑到公司其他流

动资产为银行理财产品，期限较短，流动性较强，故将其计入速动资产。

8、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

9、基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

10、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

11、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

12、存货周转率=营业成本÷存货平均余额

13、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系电话：029—88365802
传真：029—88365835
项目负责人：张磊
项目组成员：张潇、魏云芳、雷炳苹

（二）律师事务所

名称：北京盈科（上海）律师事务所
负责人：李举东
住所：上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心15、16楼
电话：021-60561288
传真：86-21-60561299
经办律师：赵柄竹、殷新

（三）会计师事务所

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕桦
住所：西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五
电话：029-88275918
传真：029-88275912
经办注册会计师：张琴、桂标

（四）资产评估机构

名称：北京亚超资产评估有限公司
法定代表人：李应峰
住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202
电话：010-51716863
传真：010-51716863
经办人员：赵彦杰、吴学舟

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话：010-58598980
传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：谢庚
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
电话：010-63889512
邮编：100033

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主要业务

公司主要业务为半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试和集成电路封装测试设备的维修改造升级。

半导体集成电路的生产过程包括设计、制造、封装、测试，公司主要为产业链的上游集成电路设计及制造公司提供晶圆的研磨、切割及测试服务，属于半导体集成电路封装前的关键环节。

集成电路封装测试设备的维修改造升级，是公司基于客户的特殊需求，购进源设备并通过定制化加工改造后交付给客户。

公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

根据公司战略规划，公司会向产业链上下游拓展业务，苏州英尔捷芯片设计有限公司未来将主要承担产业链中上游的集成电路设计环节，主要业务为半导体、集成电路芯片设计、销售，并提供相关技术服务。苏州英尔捷半导体有限公司将承担产业链下游晶圆切割之后的晶圆衔接及键合。未来母公司将和两家子公司共同承担产业链的纵深。

目前苏州英尔捷芯片设计有限公司尚未实际运营，苏州英尔捷半导体有限公司负责晶圆切割之后的晶圆衔接及键接，业务已逐步开展。经核查，目前母公司与子公司苏州英尔捷半导体有限公司人员、业务相对独立，但由于公司整体规模较小，有存在少量人员身兼两职，随着公司的发展及业务规模的不断增加，子公司人员及管理体系将更加独立。

两个子公司均为公司的全资子公司,对于两个子公司的经营决策能够产生重大影响。母公司对于两个子公司的经营管理根据《公司法》及《公司章程》的规定以股东会的形式形成决策性文件,授权经营管理人员负责日常经营管理工作;母公司对两个子公司的经营管理、人事任免等均能产生重大影响。子公司的利润分配方案由母公司召开股东会作出决议后方可实施,即母公司作为两个子公司的控股股东,对于其利润分配能够起到决定性作用。公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关规定,结合自身实际核算情况制订和实施了公司统一的《财务管理制度》,采用相关财务软件,建立了公司内部统一的会计核算和财务管理体系,对子公司的财务信息资料进行集中管理,实现对子公司会计信息的实时监控。

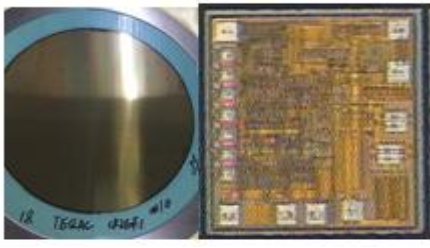
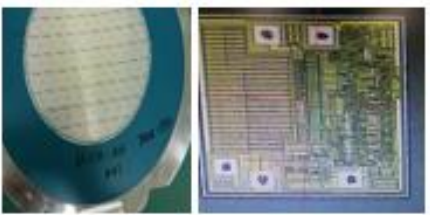
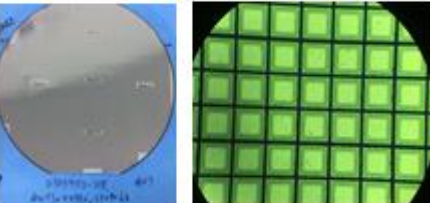
公司已严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,实现了对子公司在人员、财务、业务上的控制。

(二) 主要产品及用途

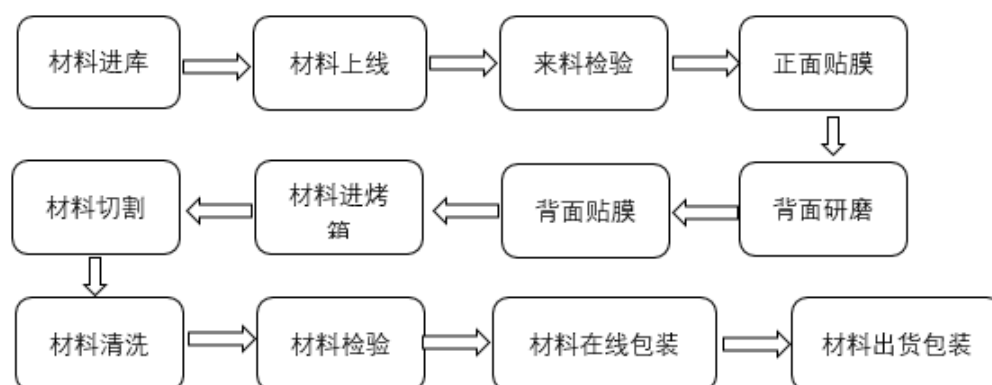
(1) 晶圆的研磨、切割及测试服务

公司主要提供集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试服务,未来公司将逐步引入集成电路的封装服务。公司完成切割、研磨及测试后的产品在电子整机端的应用主要分为三大方向:一是电源、照明及LED领域;二是移动通信领域;三是传感器领域。

公司主要产品具体情况如下：

产品名称或型号	应用领域	图片
IC 主片	TESLAC/MWCLATWOB/ KWCAM/MWC1A730B/ MWCIATIQC/MWCIATIQC/ MWAIATSIC	电源、照明、LED 
	6X127A-A03/LDP77D01/ L0211/CA607D/CH9999D/ AS1001/MA1127/MA1127	移动通信 
MOS F 背银片	AWTS044PRO/AWTS028PR5_C T100GS/ AWTS041PRO_CT090GS/ MC068/MC055/ AWTS071PR0-CT090GS	传感器 

公司业务属于半导体产业链的中间环节，因为公司提供的产品或服务采用来料加工的经营模式，具体生产流程如下：



1、材料进库，材料运到仓库，仓库管理员开箱检验核对材料信息并打印生产流程单，把流程单贴附在料盒上。如遇到材料信息不符或有任何异常及时通知主管进行处理。

2、材料上线，仓库管理员根据生产需要安排材料由仓库发往生产线，将材料包装拆掉并将材料放到生产线传递窗内。

3、来料检验，材料由在线QC人员接收，并在指定地点做来料检验，确定来料信息以及材料是否有异常并做好登记记录，并将检查完毕的材料存放到指定的货架，如遇到材料信息不符或有任何异常及时通知主管进行处理。

4、正面贴膜，贴膜人员将检验好的材料分装并按照产线教育标准进行贴膜操作。

5、背面研磨，研磨人员选择相对应的研磨程序将正面贴好膜的材料根据流程单上的加工要求进行研磨。

6、背面贴膜，根据圆片实际厚度尺寸选择不同的台盘，将研磨好的材料、铁圈在相应的设备进行背面贴膜作业。

7、材料进烤箱，操作员将背面贴好膜的材料放入烤箱中，将圆片与蓝膜紧密贴合。

8、材料切割，操作员将待切割材料装载到切割设备台盘上，按订单要求对整片材料进行切割。

9、材料清洗，操作员将切割完成的材料装载到清洗设备台盘上，对圆片冲洗，部分材料需手工清洗。

10、材料检验，操作员将切割好的材料自检后通过QC高倍显微镜检验切割品质。

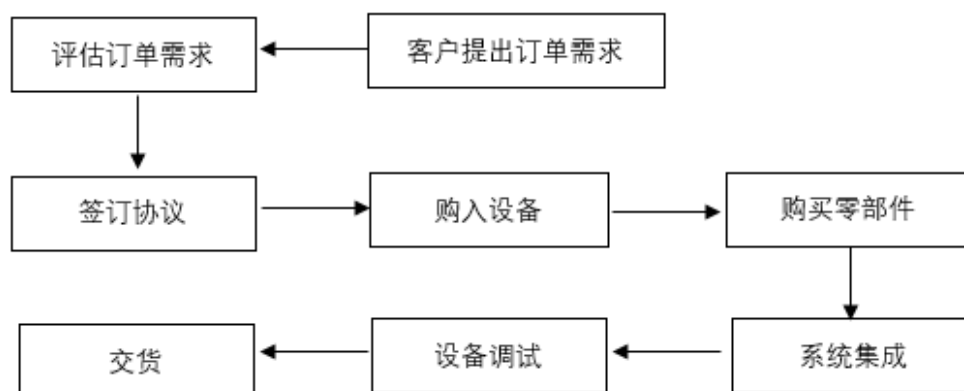
11、产品在线包装，产品检验合格后，由在线包装人员进行在线包装和标签打印。

12、材料出货包装，材料加工完成后，选取合适的包装纸盒，将材料打包出货。

(2) 集成电路封装测试设备的维修改造升级。

不同的集成电路封装测试厂商因为业务条线的不同及产品规格的不同,对于集成电路封装测试设备有不同的需求,但很多大型的专业设备厂商对于小额订单无法提供定制化的服务或提供定制化服务价格较高,导致一些中小厂商无法采购满足其需求的生产设备。公司成立之初即基于客户的需求从事集成电路封装测试设备的维修改造升级业务。

集成电路封装测试设备的维修改造升级生产流程如下:



客户提出订单需求,公司根据客户的订单需求组织研发部和设备部评估该订单的可行性。评估后,如果公司能满足客户订单需求,将及时联系客户签订协议。随后,公司将根据市场上现有的标准设备或者二手设备匹配客户订单需求购买整机,并购买诸如轨道、压板、显示器、控制器等零部件。工程师根据客户需求对整机设备及外购零部件进行设计改造,将各个零部件及设备源进行系统集成。系统集成后,工程师将对设备按客户要求进行调整,以保证设备的稳定性及精确性。

经过公司维修改造升级后的设备如图:



AD830 贴片机



AD898 贴片机



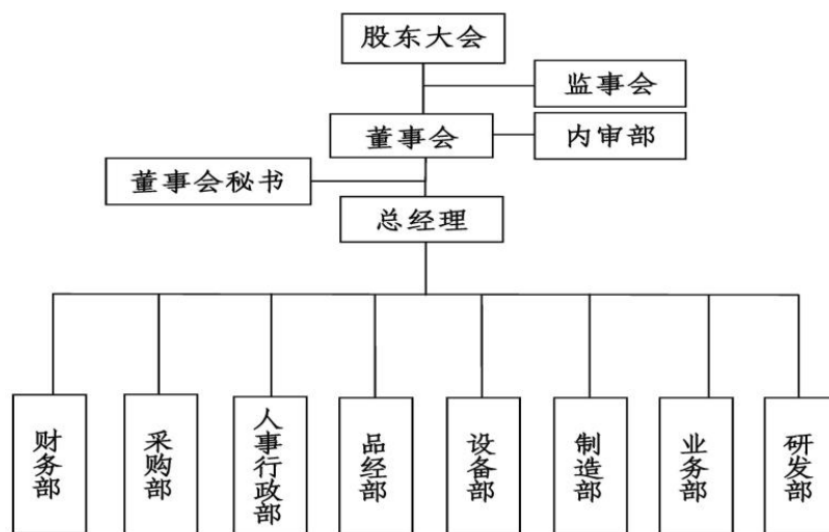
KS MAXUM 焊线机



KSICONN 焊线机

二、公司内部组织结构图和业务流程

（一）公司内部组织结构图

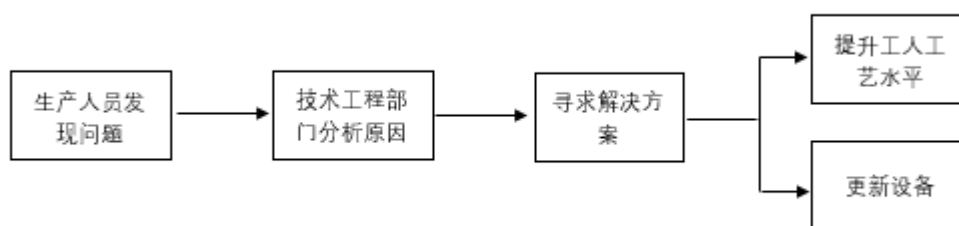


序号	部门	职能
1	制造部	负责生产计划编制、生产任务执行、生产设备维护、数据统计上报
2	业务部	负责市场开发、维护工作
3	财务部	负责公司财务核算、财务管理
4	人事行政部	负责全公司日常行政事务管理、人事管理及各部门的协调
5	采购部	负责公司营运所需物资及配件的采购、供应商的管理
6	研发部	负责公司软件及硬件的开发、研究
7	设备部	负责集成电路封装测试设备的维修改造升级
8	品经部	负责原材料入库及产品出库的质量检测

（二）主要生产或服务流程及方式

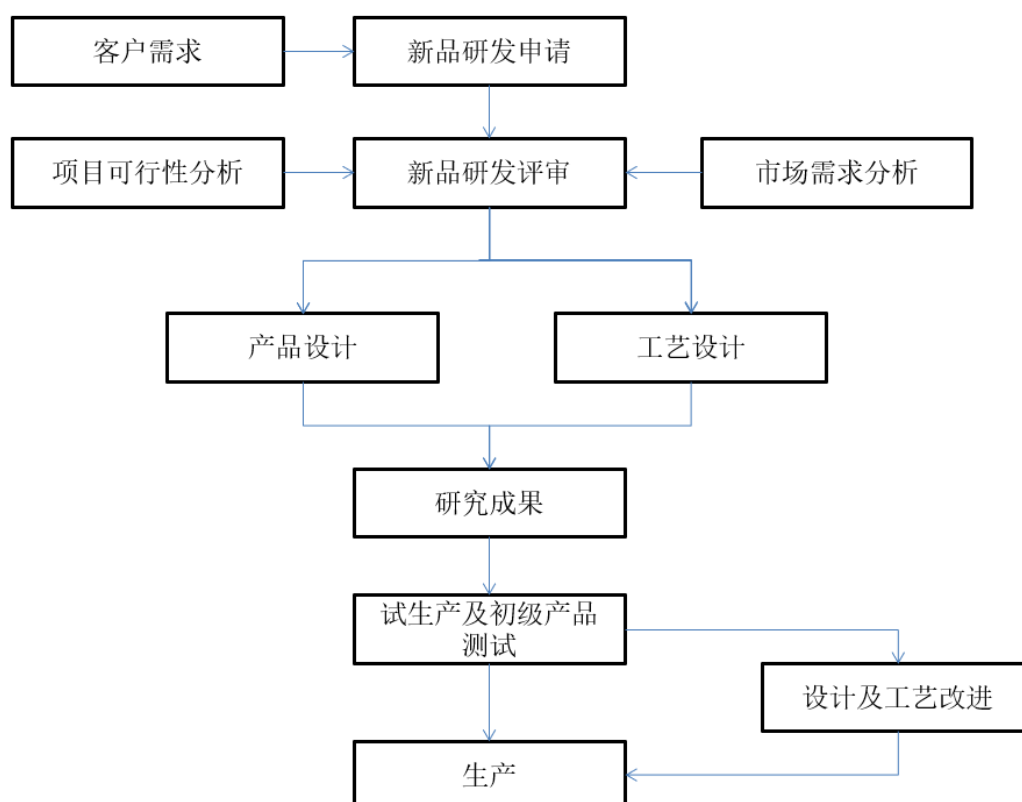
1、研发流程

公司的研发主要是对公司加工工艺的改进研发和硬件及软件的开发。工艺研发流程如下：

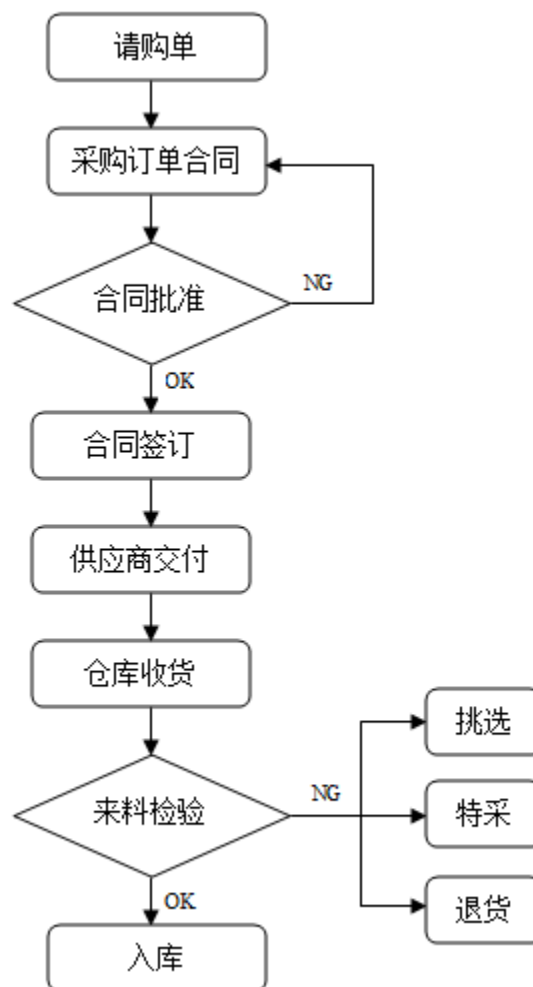


在生产加工过程中为了提高生产加工的良品率，提高产能，通常需要进行加工工艺的改造，一线加工人员在加工过程中发现导致加工瑕疵的问题或者公司加工产品未达到客户预期，研发部会组织研讨会议对该问题进行研究分析，并寻求解决该问题的方案，一般来说，解决方案有两种方式：通过技能培训或者业务学习的方式提升操作工人的工艺水平；购进新设备或者对现有设备进行更新改造。

硬件、软件研发流程如下：



2、采购流程

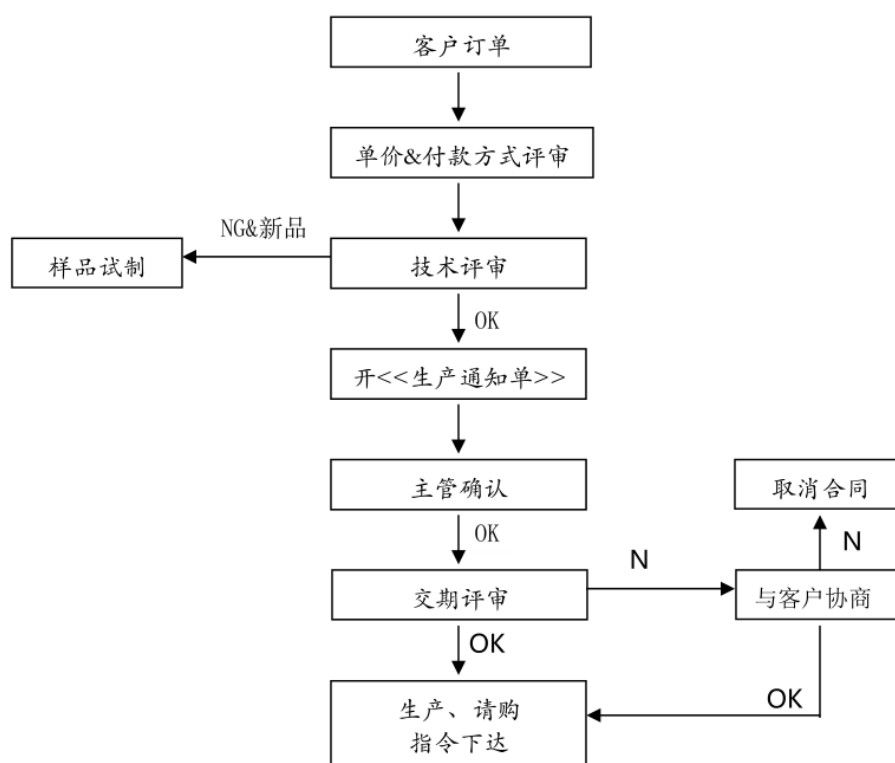


公司针对客户下达的订单，由工程师分析所需物料的种类及数量，并开立物料清单提交给部门负责人审核，审核通过后采购部门按照公司的采购制度执行采购流程，通过询价、比价、议价的方式确定价格及供应商并开立采购订单，提交采购部门负责人审批，审批通过后，将采购订单发给供应商，供应商供货，收到货物后进行检验并入库，对检验不合格的产品进行退货处理，同时提供纠正预防方案给供货商，避免再次出现同类情形。

3、业务流程

公司采用订单模式进行销售，具体业务流程如下：

业务部在市场上获取信息后，与客户取得联系并进行谈判和议价，取得一致性意见签订合同。公司按照合同制定加工计划准备所需耗材，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司检验后入库并组织生产部门加工，加工完成后包装入库，检验合格后打包将货物发送给客户并由其验收合格。



三、公司业务相关的关键资源情况

（一）公司主要产品（服务）的核心技术

1、公司主要产品（服务）的核心技术情况

（1）双刀切割技术

晶圆切割----晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。进行集成电路的封装时，必须将一定厚度的晶圆切割成单粒芯片。切割过程中要控制芯片没有破裂、裂纹、刮伤等，否则芯片受损会影响产品功能的实现。双刀切割----传统为单刀切割技术，即切割一定厚度的晶圆是一次切穿，这种切割对于普通芯片是可以满足要求的；但现在产品都是朝着多元化的方向发展，该技术已较难适应，切割过程中很容易出现芯片破裂、裂纹等。双刀切割，是分两次切割晶圆，第一次切割一定厚度；第二次完全切穿晶圆。整个过程中应力得到了很好的释放，该技术可以很好的解决当前的技术难题。

（2）超薄研磨技术

晶圆研磨，主要是将晶圆通过背面打磨使之厚度控制在一定的范围，这道工艺对于设备的精度要求较高，而且加工成本也较高，在研磨的过程中很容易造成晶圆破裂，尤其是现在的晶圆直径越来越大，更增加了控制难度。不同的产品对晶圆的厚度要求不同，有些器件要求晶圆的厚度必须很小，而且如果晶圆太厚会造成散热不良，所以晶圆研磨所能达到的厚度必须控制在要求的范围内，目前市场上一般的晶圆研磨厚度在 200-400 微米之间，而公司配备了最先进的研磨设备，通过精准的操作，可使晶圆的研磨厚度达到 40 微米。

2、研发基本情况

单位：元

项目	2018 年 1-7 月金额	2017 年金额	2016 年金额
研发费用	500,318.19	1,039,400.75	478,716.37
研发费用占主营业务收入的比重	4.78%	2.96%	2.71%

公司的研发主要为加工工艺的改造研发，公司的研发费用主要包括研发人员的人工费用，公司未来将加大研发投入，积极培养研发人才，提高研发成果的产出。

报告期内，公司研发费用按项目归集的明细如下：

单位：元

2016 年研发费用明细				
研发项目编号	芯片算法在线编程控制系统的研发	芯片设计开发一体化系统的研发	芯片设计数据远程传输系统的研发	合计
人员人工	104,380.32	65,345.06	64,366.30	234,091.68
直接投入	64,079.48	98,785.94	74,245.24	237,110.66
折旧费用	3,350.01	2,172.81	1,991.22	7,514.04
合计	171,809.81	166,303.81	140,602.77	478,716.38
2017 年研发费用明细				
研发项目编号	高性能新型封装电路的密闭结构的研发	基于多层堆叠式芯片的新型封装结构的研发	高效新型晶圆表面贴膜装置的研发	合计

人员人工	119,688.83	133,795.95	74,942.40	328,427.18
直接投入	147,062.97	310,752.76	128,331.42	586,147.16
折旧费用	4,271.18	4,271.23	2,124.43	10,666.84
长期待摊费用摊销	46,190.38	46,190.33	22,298.85	114,679.56
合计	317,213.36	495,010.27	227,697.11	1,039,920.74
2018年1-7月研发费用明细				
研发项目编号	高性能半导体封装装置的研发	基于分架式晶圆清洗装置的研发	高精度新型晶圆位置校准装置的研发	合计
人员人工	74,344.64	75,544.64	65,357.08	215,246.36
直接投入	97,158.91	56,892.42	57,750.94	211,802.27
折旧费用	2,427.84	2,427.86	1,517.45	6,373.15
长期待摊费用摊销	25,484.34	25,484.32	15,927.75	66,896.41
合计	199,415.73	160,349.24	140,553.26	500,318.19

3、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

核心技术人员现任职务及持股情况如下：

序号	姓名	现任职务	持股数（股）
1	胡建军	工程师	-
2	乔广军	设备工程师	-
3	任玉东	WB 工程师	-
合计			-

核心技术人员简历如下：

胡建军，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2010年7月至2017年6月任三星电子（苏州）半导体有限公司工程师，2017年7月至今任公司工程师。

乔广军，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，专科学历，2004年3月至2017年3月任三星电子（苏州）半导体有限公司工程师，2017年4月至今任公司工程师。

任玉东，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月至2017年7月任职于长电科技股份有限公司担任WB技术员、工程师；2017年7月至2017年10月，任职于无锡豪邦高科技股份有限公司，担任WB工程师；2017年10月至今，任职于本公司担任WB工程师。

（2）核心员工竞业禁止的情况

核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

（二）公司采取的质量标准

公司现持有 ISO9001：2015 质量体系认证证书，证书编号为：U17Q28005136ROS，证书有效期至2020年4月23日。

（三）公司主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，本公司无商标专用权。

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司已获得27项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	开发完成日期	权利取得方式
1	芯片算法评估与优化系统 V1.0	2017SR594870	公司	2017/05/08	原始取得
2	芯片设计数据远程识别系统 V1.0	2017SR595205	公司	2017/03/31	原始取得
3	芯片设计用户反馈系统 V1.0	2017SR595212	公司	2017/04/08	原始取得
4	芯片算法结果导向系统 V1.0	2017SR594877	公司	2017/04/26	原始取得
5	芯片算法自动执行系统 V1.0	2017SR592169	公司	2017/03/23	原始取得

6	芯片设计信息化与自动化系统 V1.0	2017SR541999	公司	2016/09/30	原始取得
7	芯片设计自动改进升级系统 V1.0	2017SR567537	公司	2016/09/20	原始取得
8	芯片设计合理化评估系统 V1.0	2017SR567482	公司	2016/09/05	原始取得
9	芯片算法参数控制系统 V1.0	2017SR567436	公司	2016/11/12	原始取得
10	芯片算法远程控制 V1.0	2017SR567429	公司	2016/11/30	原始取得
11	芯片算法调试控制系统 V1.0	2017SR592142	公司	2017/03/18	原始取得
12	芯片设计数据远程传输系统 V1.0	2017SR592171	公司	2017/02/05	原始取得
13	芯片设计专家评审系统 V1.0	2017SR595219	公司	2017/04/12	原始取得
14	芯片算法在线显示系统 V1.0	2017SR596336	公司	2017/05/13	原始取得
15	芯片设计自动化应用系统 V1.0	2017SR595548	公司	2017/04/17	原始取得
16	芯片算法参数动态输入系统 V1.0	2017SR594908	公司	2017/04/22	原始取得
17	芯片算法控制识别系统 V1.0	2017SR541961	公司	2016/11/02	原始取得
18	芯片设计动态协作系统 V1.0	2017SR595188	公司	2017/03/27	原始取得
19	芯片设计流程化审核系统 V1.0	2017SR592719	公司	2017/01/23	原始取得
20	芯片算法在线编程控制系统 V1.0	2017SR541955	公司	2016/11/15	原始取得
21	芯片算法动态化调用系统 V1.0	2017SR592814	公司	2017/02/28	原始取得
22	芯片算法参数库软件 V1.0	2017SR592172	公司	2017/02/23	原始取得

23	芯片算法建模 控制系统 V1.0	2017SR592984	公司	2017/03/12	原始取得
24	芯片算法检测 与分析系统 V1.0	2017SR592707	公司	2017/03/03	原始取得
25	芯片设计数据 库搭建系统 V1.0	2017SR292725	公司	2017/01/25	原始取得
26	芯片设计信息 动态交互软件 V1.0	2017SR542006	公司	2016/10/15	原始取得
27	芯片设计开发 一体化系统 V1.0	2017SR542010	公司	2016/10/25	原始取得

3、专利

(1)截至本公开转让说明书签署日,公司已获得9项专利,全部为实用新型,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	取得方式
1	一种新型封装电路 的密闭结构	201721225386.1	公司	2017-09-22	原始取得
2	一种晶圆切割机的 可调夹具	201721207148.8	公司	2017-09-19	原始取得
3	一种新型晶圆承载 器	201721187781.5	公司	2017-09-17	原始取得
4	一种新型晶圆表面 贴膜装置	201721187938.4	公司	2017-09-17	原始取得
5	一种多层堆叠式芯 片封装结构	201721190747.3	公司	2017-09-16	原始取得
6	一种移动物联网系 统故障测定装置	201720233800.7	公司	2017-03-11	原始取得
7	一种 LED 灯具的 高效封装装置	201720052460.8	公司	2017-01-17	原始取得
8	一种物联网终端设 备的电线防脱落连 接结构	201720025694.3	公司	2017-01-10	原始取得
9	一种基于物联网的 宣传展示结构	201621229727.8	公司	2016-11-16	原始取得

(四) 公司取得的业务资格和资质情况

本公司及子公司取得的相关业务资格和资质,具体情况如下:

序号	名称	证明内容	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
1	对外贸易经营者备案	对外贸易经营者备案登记	02776490	2018-05-29	对外贸易经营者备案登记	长期有效
2	集成电路芯片的封装加工和服务	集成电路芯片的封装加工和服务	U17Q28005136ROS	2017-04-24	卡狄亚标准认证(北京)有限公司	2020-04-23

公司主营业务是半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试和集成电路封装测试设备的维修改造升级，属于集成电路制造行业。公司所在行业不需要行政许可部门经营许可证。公司不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况。

（五）公司拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

（六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、主要固定资产

单位：元

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率（%）
机器设备	46,060,051.27	7,350,364.40	38,709,686.87	84.04
电子设备	150,660.42	87,901.22	62,759.20	41.66
办公设备	210,307.69	53,809.18	156,498.51	74.41

2、截至2018年7月31日，公司主要机器设备的情况如下：

生产设备名称	数量	原值（万元）	累计折旧（万元）	净值（万元）	成新率（%）
集成电路全自动晶圆减薄抛光生产线	1	1,452.99	195.55	1,257.44	86.54
集成电路全自动封装线	1	940.17	126.53	813.64	86.54
全自动晶圆切割设备	1	791.39	194.22	597.17	75.46

集成电路产品测试系统	1	598.29	80.52	517.77	86.54
切割机	1	205.58	26.04	179.54	87.33
切割机	1	74.00	10.54	63.46	85.75
切割机	1	73.00	10.40	62.60	85.75
切割机	1	60.25	8.59	51.66	85.75

（七）公司员工

截至2018年7月31日，公司及子公司共有员工33人，构成情况如下：

（1）按专业结构划分：

专业结构	人数（人）	占比（%）
管理人员	7	21.21
研发与工程技术人员	5	15.15
生产人员	19	57.58
市场营销人员	2	6.06
合计	33	100.00

（2）按年龄划分：

年龄	人数（人）	占比（%）
30 岁以下	20	60.61
30-39 岁	10	30.30
40-49 岁	3	9.09
合计	33	100.00

（3）按受教育程度划分：

教育程度	人数（人）	占比（%）
博士或硕士研究生	1	3.03
本科	5	15.15
专科	15	45.45
专科以下	12	36.36
合计	33	100.00

根据公司的确认并经项目组核查，截止 2018 年 7 月 31 日，公司为签订劳动合同的 33 名员工，其中 32 名缴纳社保，31 名员工缴纳公积金。其中，1 名员工为新入职，尚未办理社保及公积金，另有 1 名员工签订了自愿放弃公积金的承诺。

公司实际控制人陆孙华出具《承诺》：“本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，若因未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴的，本人将无条件按主管部门核定的金额代苏州英尔捷微电子股份有限公司补缴相关款项；若因未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使苏州英尔捷微电子股份有限公司产生其他任何费用或支出的，本人将无条件代苏州英尔捷微电子股份有限公司支付相应款项，且保证苏州英尔捷微电子股份有限公司不会因此遭受任何损失。”

（八）公司环保事项

1、公司不属于重污染行业

公司主要从事半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39），细分行业集成电路行业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为：C3973 集成电路制造。

根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105 号）、《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373 号）等相关法律法规和规范性文件规定的重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（酿造、造纸、发酵）、纺织、制革，因此公司不属于重污染行业。

2、建设项目环评批复和验收情况

2017 年公司生产经营地址由“苏州工业园区娄葑镇新泽路 80 号”搬迁到“苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 19-2 号厂房”。公司搬迁后及时办理了环评批复及验收：

2018年5月15日，公司获得了苏州工业园区国土环保局出具的《建设项目环保审批意见》，项目名称为：苏州英尔捷微电子有限公司晶圆片、集成电路颗粒生产搬迁项目。

2018年7月12日，苏州英尔捷微电子股份有限公司根据《苏州英尔捷微电子股份有限公司晶圆片、集成电路颗粒生产搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和苏州工业园区国土环保局审批决定等要求对本项目进行验收。

2018年8月24号，苏州工业园区国土环保局出具了《建设项目固体废物、噪声环境保护设施竣工验收合格通知书》，“该项目配套建设的固体废物和噪音环境保护设施验收合格，同意投入生产或者使用”。

3、排污许可证办理情况

公司已获得苏州工业园区国土环保局颁发的《排放污染物许可证》（编号20180094），有效期为2018.6.15-2019.6.14。

4、公司日常环保合法规范运营情况

在日常环保制度建设与执行中，公司严格执行主管部门的环保规定，报告期内，公司及子公司日常环保合法合规，不存在严重环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，不存在因环保重大违法违规而受处罚的情况。

公司环保主管机关苏州工业园区国土环保局已出具《企业环保情况说明》，证明本公司在生产活动中能够自觉履行环保“三同时”要求，无环境保护方面的违法情况。

（九）安全生产情况

公司主要经营半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试和集成电路封装测试设备的维修改造升级。公司所属行业不属于《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》所规定的适用安全生产许可制度的企业范围，无需取得相关部门的安全生产许可。

公司制定了《安全生产管理制度》对生产车间管理制度、操作规程、设备管理与维修等安全生产事项进行了规范并严格执行，报告期内，公司不存在安全生产方面的重大事故、纠纷或处罚。

公司安全生产主管机关苏州工业园区安全生产监督管理局 2018 年 9 月 17 日已出具《证明》，证明公司自 2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日，未受到过安监部门的行政处罚。

（十）公司消防安全情况

公司租赁的房产消防情况如下：

序号	出租房	租赁期限 (日期)	房屋地址	消防 备案 情况	消防备案验收情 况
1	苏州工业园区兆阳资产管理有限公司	2016. 11. 01-2021. 12. 31	苏州市工业园区双马街 2 号星华产业园 19-2	已备 案	苏园公消竣复字 (2015) 第 0010 号

此外，项目组通过与公司管理层访谈，了解消防设施配备情况及公司消防管理制度制定及执行情况。公司所在经营场所前期已按照相关规定通过了消防验收、完成消防备案，配置了较为完善的消防设备，制定了较为完善的消防安全管理制度。

然而公司后期对其经营场所进行了装修，根据《建设工程消防监督管理规定》（119 号令），“第二十四条 对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程，建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内，通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。”公司在工程竣工后未第一时间进行消防备案，目前已经着手办理。实际控制人陆孙华，就公司因消防未及时备案导致公司承担赔偿责任或受到相关主管部门处罚，其本人将无条件对公司全额补偿，且不要求公司支付任何对价。

为预防消防安全风险，公司制定了《消防安全管理制度》，定期检查消防栓、灭火器等消防设施设备；定期开展消防安全教育、培训，要求员工在生产经营的过程中严控消防安全。

四、公司业务相关情况

（一）公司业务收入构成及主要产品或服务销售情况

1、按产品分类业务收入构成

单位：元

产品或服务类别	2018年1-7月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
设备、配件销售	3,307,518.63	31.58	9,094,869.37	25.90	16,631,821.19	94.02
晶圆研磨切割	6,886,525.75	65.75	25,720,090.20	73.24	799,276.45	4.52
封装测试	279,437.95	2.67	301,068.26	0.86	258,178.02	1.46
合计	10,473,482.33	100.00	35,116,027.83	100.00	17,689,275.66	100.00

公司营业收入主要包括设备、配件销售、晶圆研磨切割和封装测试收入。

2、按地区分布情况

单位：元

地区名称	2018年1-7月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华北	49,572.65	0.47		0.00	6,957.26	0.04
华东	8,374,868.73	79.96	33,891,177.57	96.51	15,993,066.78	90.41
华南	510,000.00	4.87	792,000.00	2.26	431,256.40	2.44
西南	1,539,040.95	14.69	281,598.29	0.80		0.00
国外		-	151,251.97	0.43	1,257,995.22	7.11
合计	10,473,482.33	100.00	35,116,027.83	100.00	17,689,275.66	100.00

报告期内，公司的主要销售区域是国内市场，国外市场销售比例较小。国内的销售主要来自于华东地区，主要是公司身处华东地区，利用区域客户群体优势，

深度挖掘客户，拓展本区域业务及周边地区业务。后期随着业务的发展，公司市场会逐渐拓展到其他区域。

（二）报告期公司业务成本构成

单位：元

营业成本构成	2018 年 1-7 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	1,457,670.77	19.91	10,619,750.96	57.55	11,074,107.08	81.67
直接人工	615,783.52	8.41	872,367.92	4.73	612,912.79	4.52
制造费用	5,249,247.31	71.68	6,959,940.80	37.72	1,872,427.02	13.81
合计	7,322,701.60	100.00	18,452,059.68	100.00	13,559,446.89	100.00

报告期内，设备、配件销售的营业成本主要为原材料成本，2016 年、2017 年、2018 年 1-7 月直接材料占总成本的比例分别为 81.67%、57.55%、19.91%；晶圆研磨切割的营业成本主要为制造费用，2016 年、2017 年、2018 年 1-7 月制造费用占总成本的比例分别为 13.81%、37.72%、71.68%。

（三）报告期前五名客户销售情况

客户名称	营业收入（元）	占公司营业总收入的比例（%）
2018 年 1-7 月		
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	1,539,040.95	14.69
上海增祥电子科技有限公司	1,445,463.30	13.80
苏州格尼达机电有限公司	875,592.29	8.36
苏州埃缇益自动化科技有限公司	692,091.63	6.61
苏州富斯达康半导体科技有限公司	646,551.72	6.17
合计	5,198,739.89	49.64
2017 年		
苏州德瑞恩电子有限公司	2,410,200.00	6.86
上海增祥电子科技有限公司	2,227,500.00	6.34
苏州新美光纳米科技有限公司	2,197,039.74	6.26
苏州拓为机电有限公司	1,735,000.00	4.94
苏州日月新半导体有限公司	1,594,940.40	4.54

合计	10,164,680.14	28.95
2016 年		
苏州格尼达机电有限公司	4,495,807.67	25.42
江苏格立特电子股份有限公司	2,170,431.20	12.27
苏州冠群微电子有限公司	1,538,461.59	8.70
浙江红果微电子有限公司	1,380,998.29	7.81
苏州市锐拓微电子有限公司	1,356,923.10	7.67
合计	10,942,621.85	61.86

2016 年、2017 年、2018 年 1-7 月公司向前五名客户销售金额占当期销售总额的比例分别为 61.86%和 49.64%。根据公司所在细分行业特性，公司客户较为分散，公司不存在对单一客户严重依赖情况。

持有公司 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方均未在上述客户中占有权益。

（四）报告期前五大供应商采购情况

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
2018 年 1-7 月		
上海睿通机器人自动化股份有限公司	667,500.00	31.35
上海新阳半导体材料股份有限公司	343,486.97	16.13
上海优秘展览有限公司	300,970.87	14.14
苏州净佰仟环保净化工程有限公司	223,300.97	10.49
上海铭杰工贸有限公司	130,000.00	6.11
合计	1,665,258.81	78.22
2017 年度		
上海睿通机器人自动化股份有限公司	20,512,820.51	47.80
嘉兴景焱智能装备技术有限公司	9,401,709.40	21.91
上海建善建筑装饰工程有限公司	4,545,454.55	10.59
苏州晶方半导体科技股份有限公司	1,000,000.00	2.33

深圳市蓝科星科技有限公司	948,717.97	2.21
合计	36,408,702.43	84.84
2016 年度		
苏州冠群微电子有限公司	3,608,868.38	19.98
深圳市天瑞威电子有限公司（深圳市联璧合电子有限公司）	1,574,999.99	8.72
杰富意商事电子（上海）有限公司	1,719,900.00	9.52
苏州晶方半导体科技股份有限公司	1,239,409.27	6.86
苏州新美光纳米科技有限公司	966,650.00	5.35
合计	9,109,827.64	50.44

2016 年、2017 年及 2018 年 1-7 月份，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 50.44%、84.84%和 78.22%。报告期内公司采购的主要为机器设备、切割刀具及装修服务。2016 年、2017 年及 2018 年 1-7 月份，公司前五名供应商变动较大，单个供应商占比不超过 50%，且公司上游供应商所处行业均为完全竞争状态，不存在对单一供应商存在重大依赖的情况，随着公司发展，各项业务模块区域成熟，公司的供应商会趋于稳定。

除 2016 年的供应商苏州冠群微电子有限公司为公司董事李伟报告期内曾经的公司的实际控制人（2017 年 12 月已退出），关于此公司与公司之间的交易事项及分析详见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”之“（三）关联方交易”。

其他持有公司 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方均未在上述供应商中占有权益。

报告期内公司主要供应商与客户重合的情况如下：

单位：万元

客户名称	2018 年 1-7 月		2017 年度		2016 年度		交易内容
	销售额	采购额	销售额	采购额	销售额	采购额	
苏州新美光纳米科技有限公司	1.20	1.02	219.70	23.94	5.66	96.67	晶圆研磨加工，购买硅片

嘉兴景焱智能装备技术有限公司	-	-	0.88	940.18	59.35	-	晶圆研磨切割, 购买封装测试线
上海增祥电子科技有限公司	144.55	10.77	222.75	-	-	-	晶圆研磨切割, 购买清洗液
苏州冠群微电子有 限公司	-	-	-	-	153.85	360.89	卖磨削机, 购买贴膜机、切割机、贴片机、焊接机

具体采购及销售内容及价格如下:

向苏州新美光纳米科技有限公司采购的硅片原片(不含芯片信息), 作为公司晶圆切割的样本原片, 公司为了保证样品的良品率, 一般都是先用样本进行多次切割研磨测试之后, 才对客户的晶圆进行切割。对其销售的是晶圆切割研磨服务, 价格都为市场价格。

嘉兴景焱智能装备技术有限公司: 根据公司发展战略, 公司将拓展产业纵深, 加强封装测试业务, 故向嘉兴景焱智能装备技术有限公司采购封装测试线系统, 向该公司采购是经过公司对比供应商报价、性能等之后的综合衡量结果, 价格为协议价格。公司向其销售的是晶圆切割研磨服务, 是因为其本身除了做封装测试系统外, 也承接封装测试业务, 但没有涉及切割与研磨的市场细分。经核查, 交易价格为市场价格。

向上海增祥电子科技有限公司采购的是清洗液, 该类商品市场上为标准产品, 价格采用市场价格, 向其销售的晶圆切割研磨, 价格为市场价格。

向苏州冠群微电子有限公司采购的为贴片机、贴膜机、切割机、焊接机等, 向其销售的为磨削机(定制), 销售及采购的都为二手半导体设备, 因二手设备因成新率、规模等因素, 价格差异很大, 而且不同渠道获得的半导体设备相应的

价格差异加大,公司与苏州冠群微电子有限公司的交易价格采用的为基于市场价格的协议价格,未显著高于或者低于其他公司的价格。

公司与上述客户及供应商定价公允,符合市场行情,而且相应的合同签订严格按照公司管理制度,均经过了公司总经理审批,不存在损害公司利益的情况。

(五) 公司重大业务合同及履行情况

1、销售合同

序号	客户名称	合同标的	签订时间	合同金额(元)	履行情况
1	苏州冠群微电子有 限公司	磨削机	2016.8.2	1,500,000.00	履行完毕
2	江苏格立特电子股 份有限公司	ASM AD830	2016.11.02	1,404,000.00	履行完毕
3	浙江红果微电子有 限公司	焊线机	2016.4.4	1,125,000.00	履行完毕
4	江苏格立特电子股 份有限公司	二手 Disco	2016.11.01	1,093,950.00	履行完毕
5	苏州格尼达机电有 限公司	配件、耗材	2016.10.12	1,038,215.00	履行完毕
6	苏州富斯达康半导 体科技有限公司	粘片机	2018.1.10	750,000.00	履行完毕
7	苏州格尼达机电有 限公司	配件、耗材	2016.1.4	697,620.00	履行完毕
8	苏州格尼达机电有 限公司	配件、耗材	2016.5.11	671,710.00	履行完毕
9	苏州格尼达机电有 限公司	配件、耗材	2016.5.23	531,950.00	履行完毕
10	苏州格尼达机电有 限公司	配件、耗材	2018.3.9	493,720.00	履行完毕
11	苏州德瑞恩电子有 限公司	配件、耗材	2017.10.13	412,893.00	履行完毕
12	苏州德瑞恩电子有 限公司	切割、研磨	2017.11.08	412,425.00	履行完毕
13	苏州埃缇益自动化 科技有限公司	配件	2018.1.6	388,547.20	履行完毕
14	苏州埃缇益自动化 科技有限公司	设备改造升级	2018.4.27	360,000.00	正在履行
15	南京矽邦半导体有 限公司	晶圆切割、研磨	2016.3	框架合同	正在履行

16	上海增祥电子科技有限公司	晶圆切割、研磨	2017.4.8	框架合同	履行完毕
17	上海琛毓精机有限公司	晶圆切割、研磨	2017.2	框架合同	正在履行
18	上海旧香电子科技有限公司	晶圆切割、研磨	2017.2	框架合同	正在履行

注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书签署之日。重大合同选取金额 30 万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同披露。

2、采购合同

序号	合同相对方	合同内容	合同金额（元）	签署日	履行情况
1	上海睿通机器人自动化股份有限公司	集成电路全自动晶圆减薄抛光生产线及辅助设备	17,000,000.00	2017.1	履行完毕
2	嘉兴景炎智能装备技术有限公司	封装测试线	11,000,000.00	2017.2	履行完毕
3	上海睿通机器人自动化股份有限公司	集成电路产品测试系统	7,000,000.00	2017.2	履行完毕
4	上海建善建筑装饰工程有限公司	装修工程	5,000,000.00	2016.11.1	履行完毕
5	杰富意商事电子（上海）有限公司	切割机	1,719,900.00	2016.11.7	履行完毕
6	苏州冠群微电子有限公司	贴片机	1,200,000.00	2016.9.2	履行完毕
7	深圳市蓝科星科技有限公司	固晶机	1,100,000.00	2017.10.20	履行完毕
8	深圳市天瑞威电子有限公司	分选机	1,075,000.00	2016.4.15	履行完毕
9	上海新阳半导体材料股份有限公司	切割刀片	框架合同	2017.12	正在履行

注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书签署之日。重大合同选取金额 100 万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同披露。

3、房屋租赁合同

序号	出租方	签署日期	租赁金额	租赁期限（年）	租赁面积	合同履行情况
----	-----	------	------	---------	------	--------

1	苏州工业园区兆阳资产管理有限公司	2016.11	1,969,500.00 元	2016.11.01-2021.12.31	3205,56 平方米	正在履行
2	苏州旭智科技有限公司	2011.5	2011.6.1-2014.5.31 减免 2014.6.1-2017.5.31 8,000 元/月	2011.6.1-2019.5.31	1000 平方米	履行完毕

五、公司的商业模式

公司专注于半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试和集成电路封装测试设备的维修改造升级。公司通过晶圆加工、销售升级改造的集成电路封装测试设备来获取利润。在研发方面，公司根据市场信息、用户反馈改进需要、技术储备和规划自主或合作研发新产品和新技术。在项目实施方面，公司独立完成晶圆的研磨、切割及测试等流程；对于集成电路封装测试设备，公司与客户沟通后，按照其所需设备及技术指标进行方案设计、研发，购入源设备升级改造后交付给客户。

（一）销售模式

1、晶圆的研磨、切割及测试

公司主要从事半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试，公司主要客户为产业链的上游集成电路设计及制造公司，采取以销定产的订单销售模式，上游集成电路设计及制造公司给公司下加工订单，公司按照客户的订单型号及要求的进行晶圆的研磨、切割及测试，加工完成并经过检验达成客户要求之后完成货品的包装，并发货给客户。

公司是较早的一批晶圆研磨、切割及测试的生产商，而且早期创始团队具有丰富的业内客户资源，所以在国内市场有一定的知名度和品牌认可度，有存量的老客户，同时经过客户介绍及转嫁，拓展公司新客户。同时，公司会定期参加行业展会，并通过网站推广来加大产品的市场认可度等方式招揽新客户，宣传公司品牌形象，挖掘培养潜在客户以及维护老客户关系等。

2、集成电路封装测试设备的维修改造升级

公司采取直销的方式进行销售，与客户签订订单进行合作。公司的客户主要是专业的高端集成电路制造商，公司与客户沟通后，按照其所需设备及技术指标进行方案设计、研发，之后确定合作意向，进行设备供应以及后续技术服务支持。对于其他新客户、新项目，公司主要通过展会、会议等形式宣传，公司在行业内从业多年，积累了一定的品牌优势，客户会根据自身需求主动与公司进行合作。

（二）采购模式

1、晶圆的研磨、切割及测试

公司采购的产品主要包括切割刀片、研磨磨轮、覆盖膜、清洁药水等，公司所采购的物品一般会对比两家以上的供应商，以工艺的稳定性为前提控制成本，决定供应商。为保证公司所采购货品供应的时效性，会确定两家以上供应商，以确保公司正常生产。

公司采购部是供应商管理的职能部门。对于原材料供应商的选择，确保其有生产能力、时效性及性能指标都能符合公司要求，以保证公司正常的生产进度和产品质量。供应商资格审查包括资料审查、其他客户查询、现场考察评价和商务谈判等内容。采购部门对供应商考核合格后，由采购部门报相关授权人员及总经理审批，批准后，采购部门将该供应商列入“合格供应商名录”。对同一种主要原材料，公司会保证安全库存，定期评估原材料是否符合安全库存的标准以便及时采购。

2、集成电路封装测试设备的维修改造升级

公司采购的主要内容为研发、生产过程中的生产材料、设备、外协加工及其他商品。发生采购行为时，需求部门需完成填写采购申请单及相应审核工作，并负责来料检验工作；采购部按照采购申请单内容，负责联系供应商下达订单及货物交接，并按照合同或采购协议规定内容按期付款。对于主要原辅材料，公司定期与合作供应商进行洽谈，认定合格供应商的资格、确定主要供应商并签署意向性采购框架协议。

对于设备的采购,采购部门配合技术人员收集设备信息,并对厂家进行评估,由技术部门与供应商协商确定技术协议,规定产品的技术参数、验收检验标准、售后服务等内容,再由采购部门与供应商签定合同。

（三）研发模式

公司的研发模式主要在加工工艺的改进方面,以企业为主体,整合企业内外资源,对新产品新型号的切割工艺的研究,公司着重研究产品加工过程中制约产品良品率提高的关键工艺环节,分析影响良品合格率提升的核心因素。通过对现有制造设备改造升级以及工艺参数的优化,实现对生产环境的有效控制;通过计算机系统模拟设计合理的工作流程,有效节约制造时间和降低公司原材料成本,最终研发出能够有效提高良品率的工艺技术,以提高公司的竞争优势。

（四）盈利模式

公司主要业务包括两个方面,半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试和集成电路封装测试设备的维修改造升级。

公司提供的集成电路封装测试设备的维修改造升级业务将客户需求与专业改造技术相结合,通过自主研发和对外技术合作等手段将采购的设备改造成个性化的集成电路生产线,并提供安装、调试、保养、备件替换等一系列服务,每条生产线都有严格的质量标准,经过客户的检验后确认收入。

半导体集成电路生产过程中的晶圆的研磨、切割及测试主要是通过客户订单的方式来进行盈利,该业务分淡季和旺季,淡季一般在第一季度,旺季在三四季度,淡季的时候公司积极开拓客户源,加强员工培训,淡季控制成本,旺季的时候加紧生产进度,满足客户需求量,公司主要通过不断开拓客户扩大销售规模的方式提高收益。

六、公司所处行业的情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码为 C39）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码为 C39）——集成电路制造（代码为 3973）。根据公司具体业务情况，公司所

在的细分子行业为集成电路行业，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为集成电路制造（代码为 C3963）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为半导体产品与设备（代码为 171210）。

（一）行业概况

1、行业主管部门、监管体制、行业主要法律法规及产业政策

（1）行业主管部门及监管体制

公司所从事的业务属于半导体集成电路行业，该行业实行行业主管部门监管、全国和地方性行业协会自律规范相结合的监管体制。

本公司所处行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。其主要职责为提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

公司业务相关的行业协会是中国半导体行业协会，该协会是中国集成电路行业的行业自律管理机构。协会下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会以及半导体支撑业分会。协会在工信部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

（2）行业主要法律法规及产业政策

行业内主要法律法规及产业政策如下：

序号	时间	文件名称	主要内容	发文单位
1	2000 年 6 月	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国	该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产	国务院

		发 18 号文)	权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。	
2	2002 年 3 月	《集成电路设计企业及产品认定管理办法》(信部联产 86 号)	为集成电路设计企业享受“国发 18 号文”制定的审定办法和认定程序。	信息产业部、国家税务总局
3	2005 年 3 月	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》(财建[2005]132 号)	明确由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金,鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。	财政部、信息产业部、发改委
4	2006 年 5 月	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》	将“突破制约信息产业发展的核心技术,掌握集成电路及关键元器件等核心技术”作为信息产业重要的发展思路。	国务院
5	2007 年 1 月	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007)》年度	明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业(第十三项)。	发改委、科技部、商务部
6	2007 年 10 月	《关于组织实施新型电力电子器件产业化专项有关问题的通知》	提高新型电力电子器件技术和工艺水平,促进产业发展,满足市场需求,以技术进步和产业升级推进节能降耗为目的,突破核心基础器件发展的关键技术,完善功率半导体产业链,促进具有自主知识产权的芯片和技术的推广应用,增强企业自主创新能力,支持功率半导体芯片、模块、应用装置、专用工艺设备和测试仪器四大类产品的产业化发展。	国家发改委
7	2009 年 4 月	《电子信息产业调整和振兴规划》	提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标,并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施,加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。	国务院
8	2010 年 10 月	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32 号)	提出了“着力发展集成电路、高端软件、高端服务器等核心基础产业”,集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分,是国家未来重点发展的战略新兴产业。	国务院
9	2011 年 12 月	《集成电路产业“十二五”发展规划》	作为行业 2011-2015 年发展的指导性文件,明确了未来发展的指导思想、基本原则和发展目标。	工信部
10	2012 年 4 月	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	进一步落实国发[2011]4 号)精神,推动科技创新和产业结构升级,促进信息技术产业发展,明确对软件产业和集成电路产业的企业实施所得税优惠政策。	财政部、国家税务总局

		财税[2012]27 号		
11	2014 年 6 月	《国家集成电路产业发展推进纲要》	提出建立与集成电路产业发展规律相适应的管理决策体系、融资平台和政策环境，全行业销售收入于 2015 年超过 3,500 亿元。	国务院
12	2015 年 2 月	《关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	明确进一步鼓励集成电路产业发展的相关企业所得税政策。	财政部、国家税务总局、发委、工信部
13	2017 年 5 月	《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019）》	聚焦智能终端、物联网、智能制造、汽车电子等重点应用领域，有效提升中高端产品供给能力，推动我国智能传感器产业加快发展。	工业和信息化部

2、行业发展概况

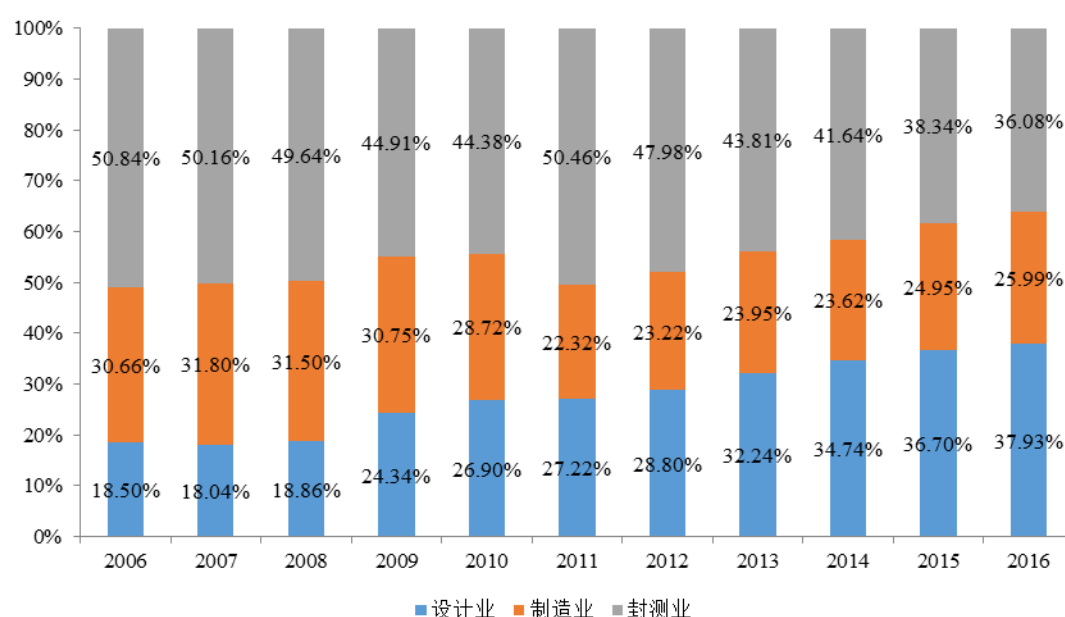
集成电路产业是目前世界上发展最快、最具影响力的产业之一，随着产业的发展，产业结构也不断的发生变化。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强，倍增效应大，在推动经济发展上发挥着重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出，各国对该行业都极为重视，发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展，使得这一行业的竞争非常激烈，激烈的竞争也使得集成电路技术得以不断更新。

从国际产业环境来讲，为了降低成本和贴近市场，全球集成电路生产线开始向中国转移，集成电路产业竞争也变得日益激烈。对集成电路制造厂商而言，降低投入和提供便捷服务能力成为更加迫切的需求，也为中国集成电路装备以及专业技术服务产业带来了巨大的发展机遇。

集成电路产业从诞生至今的 60 多年中，随着技术进步、行业竞争和市场需求的不断变化，经历了多次结构调整之后，已经逐渐由原来“大而全”的 IDM（整合组件制造商）模式的逐渐演化成目前“专而精”的多个专业细分产业，适应了企业发挥核心专长、创造价值大化的要求。目前，集成电路产业越来越显示出产业链细分和模式多元化的发展趋势，已形成了设计业、制造业、封测业协调互动共同发展的格局。

我国集成电路产业也形成了较为完善的产业链格局。在发展早期，我国以劳动密集型的封装测试环节作为切入口并大举发展，带动了早期集成电路产业由欧美向中国的转移。封装测试业成为我国集成电路产业发展的源动力，也是我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节。近年来，通过技术积累并随着我国对芯片设计行业扶持力度的不断加大，芯片设计所占比重呈逐年上升趋势，设计环节逐渐成为我国集成电路行业发展的重要驱动力量。

图：2006-2016 年我国集成电路产业销售结构



资料来源：中国半导体行业协会（CSIA）

（1）全球半导体产业发展概况

半导体产业中半导体分立器件和集成电路是重要的电子元器件，被广泛应用于消费类电子、通讯、智能仪器、汽车电子、工业自动化等产品中，是电子信息产业的基础，是衡量一个国家或地区技术水平的重要标志之一，代表着当今世界最先进的主流技术发展。终端电子产品的不断发展也推动了半导体产业的不断进步，如上世纪70年代的大型计算机，80年代初的小型PC，90年代的上网PC，21世纪的移动通讯以及正在兴起的可穿戴设备、智能家居、智能驾驶、物联网等。

2015年以来，全球经济整体复苏乏力，增速放缓。受全球PC市场衰退、移动通信终端市场增速减缓以及平板等主要电子产品市场发展放缓的影响，全球半

导体产业也结束了2013~2014年的增长期，步入平稳发展期。2016年，全球半导体市场销售额为3,389亿美元。

目前全球半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓，但消费类电子产品仍将是推动未来几年半导体产业增长的主要动力。随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。2018年全球半导体销售额将增长至3,690亿美元。

（2）我国半导体产业发展现状

自改革开放以来，我国半导体产业经过大规模的引进、消化、吸收以及上世纪90年代以来的重点建设，目前已经成为全球最大的半导体产业市场。我国半导体产业经历了一个从技术引进到自主创新的过程，在这个过程中，通过不断吸收融合发达国家的先进技术，我国半导体设计、制造以及封装测试技术得到了快速发展，与国际半导体产业的联系愈发密切，与发达国家的差距也不断缩小。但总体而言，我国半导体产业还处于成长期，发展程度低于国际先进水平。

在产业规模方面，我国已经成为全球最大的半导体市场，而且占全球的市场份额在不断增长。2015年，全球半导体市场整体下滑，而我国是全球唯一保持增长的国家，实现销售额达5,609.5亿元，产业增长速度达14.8%，在世界半导体市场份额占比达26.9%。2016年，全球半导体产业年初虽成长缓慢，但年中在全球经济小幅回升的激励下，一直维持增长。国内作为“十三五”开局之年，“中国制造2025”、“互联网+”以及“国家大数据战略”的组织实施，我国半导体产业发展取得了一系列成果，未来发展更值得憧憬。预计到2018年，我国半导体产业销售额将增长至8,295.3亿元。

（二）市场规模

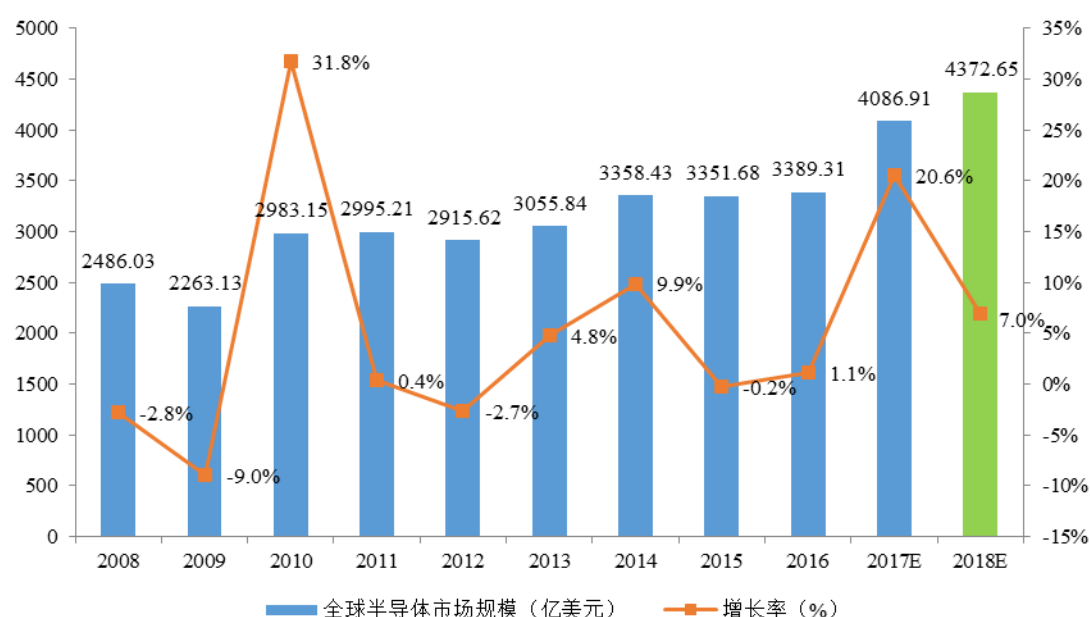
（1）全球集成电路市场平稳发展

作为半导体产业主导类型，集成电路自诞生以来，带动了全球半导体产业20世纪60年代至90年代的迅猛增长。进入21世纪以后市场日趋成熟，行业增速逐步放缓，2011年、2012年因受欧债危机、美国量化宽松货币政策、日本地

震以及终端电子产品需求下滑影响，半导体销售增速分别下降为 0.4%和-2.7%。随着全球经济的逐步复苏，PC、手机、液晶电视等消费类电子产品需求不断增加，同时在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，2013 年全球半导体产业恢复增长，增速达 4.8%。2014 年全球半导体销售继续保持增长态势，增速达 9.9%，销售规模达 3,358.43 亿美元。2015 年、2016 年的全球半导体市场规模分别为 3,351.68 亿美元、3,389.31 亿美元，2015 年虽较 2014 年稍有衰退，但于 2016 年实现回升，市场基本维持平稳发展态势。

据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2017 年全球半导体市场规模将达到 4,086.91 亿美元，同比增长 20.6%，至 2018 年或达到 4,372.65 亿美元，其中美国地区增速高，2017 年约为 31.9%，亚太地区以 18.9%的增幅位居第二。

图：2008-2018 年全球半导体销售情况及预测



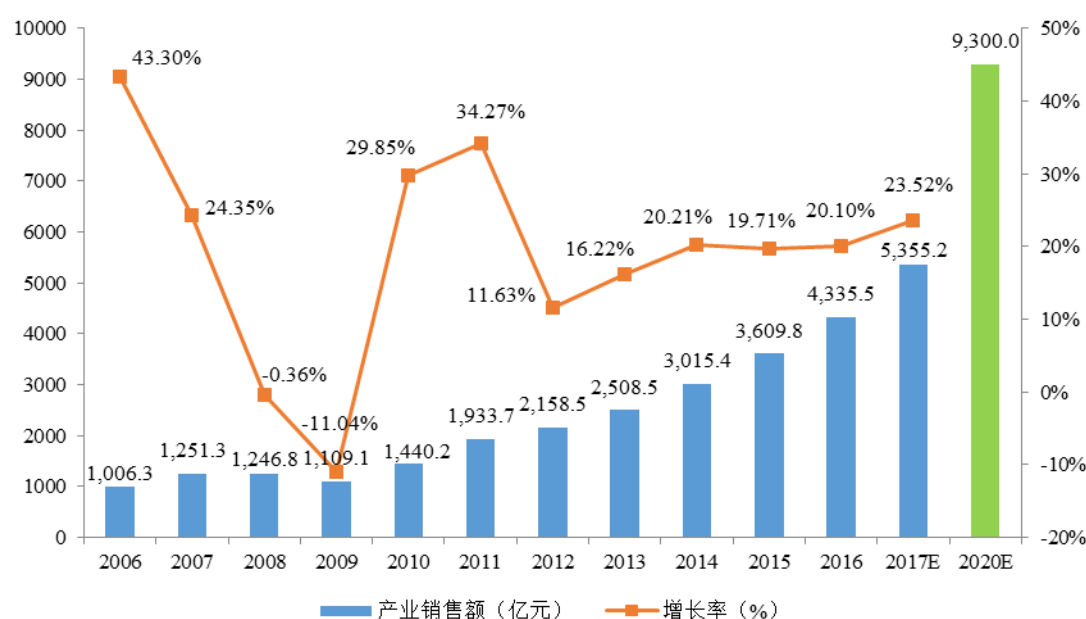
资料来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）

目前，全球半导体市场主要由美国、欧洲、日本、韩国及中国台湾企业所占据，2016 年世界前 20 大半导体厂商中，8 家为美国企业、3 家为欧洲企业、3 家为日本企业、3 家为中国台湾企业、2 家为韩国企业、1 家为新加坡企业（数据来源：IC Insights）。

（2）我国集成电路市场稳健增长

相比全球市场而言，我国集成电路市场起步较晚，但发展速度明显快于全球水平。2006 年，我国集成电路产业销售额首次突破 1,000 亿元大关，虽然在 2012 年由于受全球金融危机冲击以及全球经济低迷影响，增速有所放缓，但仍保持了 11.63% 的增长速度。随着全球经济的逐步好转以及下游需求的增加，2016 年我国集成电路产业销售额达 4,335.50 亿元，同比增长 20.10%。2017 年继续保持良好发展势头，1-9 月实现销售额 3,646.10 亿元，同比增长 22.40%。据中国半导体行业协会（CSIA）预测，中国集成电路行业销售额在未来三年中年复合成长率约为 20.20%，到 2020 年中国集成电路产业销售额将达到 9,300.00 亿元。

图：2006-2017 年我国集成电路行业销售额及增长情况



资料来源：中国半导体行业协会（CSIA）

同时，我国集成电路产业销售规模占全球产业销售收入比重呈逐年上升的态势：

表：我国集成电路产业销售额占全球产业销售收入的份额

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
比重	8.60%	12.42%	14.41%	16.10%	18.00%	21.10%	23.60%

资料来源：《中国半导体产业发展状况报告（2017 年版）》

从应用方面来看，计算机、网络通信和消费电子仍然是中国 IC 主要的应用市场，三者合计共占整体市场 78.9% 的份额。从发展速度来看，得益于国内移动互联网、物联网、工业物联网、数据中心、汽车电子等的快速发展。目前，汽车电子领域的 IC 市场增长快，增速为 34.4%。除此以外，工业控制领域成为 2016 年中国 IC 市场增长另一个重要引擎，2016 年增长率为 21%。

（三）风险特征

1、宏观经济波动风险

集成电路芯片运用范围广，产品涉及消费类电子、工业控制、汽车电子、医疗等诸多领域，尤其是消费类电子领域，市场规模大，产品更新速度快等特点为集成电路芯片的应用提供了巨大的发展空间。但同时消费类电子也是受宏观经济波动影响较为明显的行业，一旦宏观经济发生波动，下游市场的需求萎缩将会阻碍本行业的持续发展。

2、技术研发与创新风险

集成电路行业所面对的下游终端市场产品更新换代迅速，因此芯片产品生命周期很短，升级频繁。为了在行业中保持一定的竞争力，要求集成电路公司在技术创新及新产品开发方面持续投入，不断创新，开发出市场认可的新产品和升级产品，才能实现持续成长。公司未来若无法保持对行业高端人才的吸引力，维持一支具有持续创新能力、良好项目管理能力和敏锐市场判断能力的人才队伍，则可能因研发和创新能力不足导致技术落后企业发展停滞。

集成电路企业还面临新产品研发风险，包括产品规划、研发周期及投入风险。产品规划包括产品路线图、新产品的开发以及功能定位。新产品的研发周期通常在两到三年，这取决于公司对未来两到三年甚至更长期的市场预判，而对未来市场预测的准确性往往存在一定的局限。若未来公司产品研发失败，或者不能被市场接受，不能实现量产，则投入的大量的研发资金不能产生效益。此外，研发周期如果过长会导致研发投入大幅增加，增加产品的研发成本，对公司的经营业绩造成不利影响。

3、市场竞争风险

集成电路产业技术更新快，市场竞争激烈。从竞争格局来看，从事集成电路设计的国内企业数量众多，同时国外 IC 设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强资金及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争；封装测试行业技术壁垒较低，加上良好的政策环境和旺盛下游市场需求的刺激，企业数量也呈现上升趋势。上述因素会对公司扩大市场份额产生不利的影响，可能存在因竞争优势减弱而导致公司经营业绩下滑的风险。

4、政策风险

集成电路产业属于国家鼓励发展的行业，国家相关主管部门多年来陆续颁布了多项支持集成电路产业发展的规划和政策，充分体现出国家对集成电路产业的重视。国家的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前一系列的政策性文件对行业的发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业的发展，另外还存在一些政策落实不到位、与市场脱节的情况，这些都可能对公司生产经营造成不利影响。

（四）影响该行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性产业，是电子信息产业的核心。我国政府一直以来高度重视集成电路产业的发展，相继出台了多项支持性政策措施。这一系列政策的出台不仅保持了对集成电路产业支持的长期性、连续性，而且支持力度越来越大，产业政策也越来越完善，为我国集成电路产业的进一步发展提供了坚实的保障。

（2）下游市场发展推动行业增长

集成电路芯片用途广泛，产品应用涉及工业控制、汽车电子、网络设备、消费类电子、移动通信、智能家电等众多领域。广阔的应用领域及相关应用终端的繁荣是芯片产业稳步上升的有力支撑。同时，以移动互联网、三网融合、物联网、

云计算、智能电网、新能源、节能照明等为代表的战略性新兴产业快速发展，成为继计算机、网络通信、消费类电子之后推进集成电路产业发展的新动力。中国内需市场在未来几年将进一步扩大，各种电子终端设备对智能化、节能化的要求不断提高，这将加速电子产品的更新换代，进而推动集成电路行业的发展。

2、不利因素

（1）核心技术薄弱

国内集成电路企业在技术积累方面与国外厂商存在较大差距。尽管我国政府和企业愈发重视对集成电路产业的研发投入，但由于技术发展水平、人才培养等方面的滞后性，以及企业资金实力不足等原因，我国集成电路产业的研发力量薄弱、缺乏自主创新能力的状况依然存在。

（2）高端人才稀缺

集成电路行业涉及硬件、软件、电路、材料等多个学科，专业人才需要有相关学科的知识交叉，以及长期在该领域一线工作的经验积累。虽然国内集成电路行业已历经一段快速发展时期，但就目前及未来的发展需要而言，人才尤其是同时具备知识储备和经验积累的高端人才还是相对匮乏。

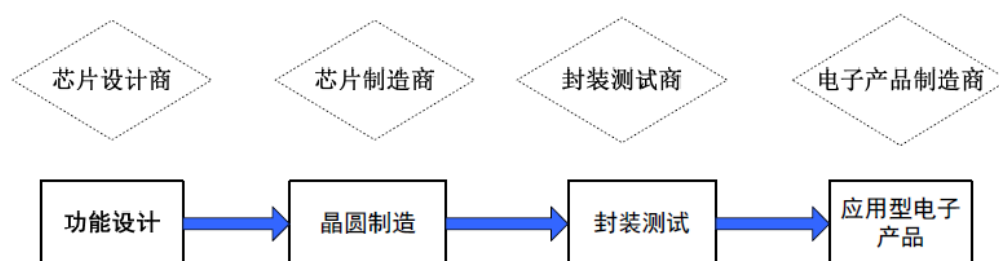
（3）贸易保护主义

后冷战时代，美国、英国、俄罗斯、韩国、日本和德国等 33 个国家签署了《瓦圣那协议》。根据该协议，上述国家不可向一些特定国家扩散潜在军事用途的技术，其中包括先进的芯片与集成电路制造设备，导致国内集成电路芯片、设备市场的技术主要通过自主创新完成，阻碍了我国半导体技术和市场的发展。但是，英特尔在中国大连晶圆工厂、中芯国际向德州仪器订购设备等事件说明近年来出口限制在逐步放开，国际巨头都在激烈争夺国内市场。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司所处的行业地位

公司所处的行业为半导体行业中的集成电路封装行业的前置环节，主要从事集成电路的封装前的晶圆的研磨、切割及检测，从整个行业来看，公司规模在行业内无规模优势，但公司定位于行业内的差异化竞争优势。



芯片的产业链如上图所示，公司所从事的主要业务处于封装测试前的关键环节，业内不乏大的芯片设计商、芯片制造商及封装测试商，但这些细分市场的中小客户，一般只有研发能力，或者制造、封装能力，无法完成整个产业链的需求，对于产业链完整的大厂商，当中小企业的订单量较小的时候，一般难以为其提供专业的晶圆的研磨、切割及测试服务，公司准确定位并充分契合国内市场需求，定位于给客户提供差异化、定制化的订单服务，这种差异化竞争使得公司在行业内保持较大的竞争优势。

自成立以来，公司不断引进国际先进生产设备，持续加大研发投入和工艺创新，凭借核心管理团队丰富的技术研发和生产管理经验，取得了一系列创新成果，公司通过不断研发陆续获得 9 项实用新型专利与 27 项计算机软件著作权，公司拥有晶圆切割机的可调夹具、新型晶圆承载器、新型晶圆表面贴膜装置等一系列工艺创新，在保证和提高加工产品性能的同时提高了加工效率，降低了生产成本，各项指标均符合国际认证及环保标准，并通过 ISO9001 质量体系认证。

同时，公司以客户需求为中心，提供高品质、定制化的集成电路封装测试设备的维修改造升级。通过对设备或生产线维修改造升级，有效减少生产时间，提高生产效率，减少材料浪费与人工成本。专业化的服务赢得了客户的广泛认可与赞誉。随着公司持续深入的研发和技术的不断升级，公司的生产及服务能力能进一步完善，产品类型和客户群体将进一步扩充，未来公司的市场占有率将继续提升。

2、行业壁垒;

(1) 资金壁垒, 集成电路行业属于资金密集型行业, 生产加工所需要的机器设备需要大量资金投入, 同时由于原材料、人才价格的不断上涨, 对公司流动资金的占用额也持续增长, 高尖端人才的引入, 也会提高资金门槛。

(2) 管理壁垒, 集成电路行业对整个核心团队的管理要求比较高, 与传统的粗放式管理经验不同, 该行业对工艺、技术的高要求需要核心团队具备精细化管理操作的能力, 同时要形成系统的管理体系, 管理模式要适应生产模式, 如果仅依靠外聘管理团队的方法无法满足企业长期发展的要求。

(3) 技术壁垒, 整个集成电路行业属于技术密集型的行业, 行业的进入需要丰富的生产加工经验的积累, 技术工艺水平要求较高。集成电路行业属于高度标准化的行业, 行业的创新表现在产品工艺改进的创新, 生产工艺的创新源于企业长时间、大规模加工生产的经验的积累。

3、公司的竞争优势

(1) 服务灵活

公司专注于行业内的晶圆的研磨、切割、测试以及设备的维修升级, 行业内中小企业订单较小时, 鉴于成本及时间的考虑大型的专业企业无法接单, 而公司自身定位于差异化竞争的地位, 对于小额及个性化订单, 公司经过研究并及时调整生产加工方案后都能提供个性化的服务。这一灵活的服务方式为公司积累了大量的客户并建立了长期稳定的合作关系。

(2) 经验丰富

公司进入集成电路行业时间较长, 公司核心技术及管理人员都具有多年的行业经验, 能及时满足客户提出的各种要求, 同时对生产加工过程中出现的问题能及时分析并找出原因, 极大地提高了公司的研发效率及生产加工效率。

(3) 生产组织与质量管理优势

集成电路产业涉及的产品种类繁多, 但不同的产品类型往往需要不同生产工艺和设备, 这对企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，培养了一大批经验丰富的研发技术人员和生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司高度重视产品质量工作，按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格、完善的品质保障体系，在产品的加工生产等各个环节建立了相应的质量保障流程和标准，并由各部门负责人严格监督执行，以确保公司所有产品品质均符合 ISO9001 标准。

4、公司的竞争劣势

（1）公司规模相对较小

尽管公司在行业内已拥有一定的品牌效应及客户资源，但与一些大型企业相比，企业规模还相对较小。公司的资产规模在一定程度上制约了业务的扩张。公司迫切需要加大资金投入促进技术创新，扩大业务规模，以适应不断增长的市场需求。

（2）资金不足限制公司发展

集成电路行业属于资金密集型和技术密集型行业，公司需要不断加大投入购买先进的生产设备，研发新的技术和生产工艺，才能不断抢占市场，巩固竞争优势。然而，公司运营资金主要来源于自身的积累及部分银行贷款，与国内已上市的同行业公司相比，融资渠道较窄，融资能力和规模有限。尽管公司现金流运转良好，财务结构比较健康，但是随着业务和规模的不断扩大，公司需要扩大生产规模。同时，公司需要持续和足够的研发创新资金来开拓高端产品，资金不足制约了产品种类的延伸拓展和产业化进度，已经成为限制公司快速发展和规模化经营的主要瓶颈。公司亟需资金来扩大生产规模、提升技术层级，进一步增强公司的综合实力。

七、公司未来发展规划

（1）业务方向-积极布局 MEMS 传感器封装业务

随着高新技术的发展，微机电系统(MEMS)技术突破传统传感技术，利用微纳米加工技术和半导体材料，将传感器、执行器、微型机械、信号处理和控制电路等集成为一个整体，一个微米甚至纳米量级的 MEMS 系统具备体积微小、低功耗、灵敏度高等特点，可大批量、低成本制造，大大拓宽了传感器的应用领域，成为目前最炙手可热的传感器技术之一，是物联网、智能设备、无人驾驶等的“心脏”，将迎来巨大的发展空间。

MEMS 封装提供多种功能，包括电源和信号通路、热管理、机械支撑以及环境和接口保护等。MEMS 工艺可以与 COMS 工艺集成，带来 SOC 级的系统和架构，MEMS 面临大量封装方面的挑战。公司将在诸多业内专家以及学术精英的带领下，在传感器器件制造领域不断创新，专注于先进的封装技术、传感器模块技术，致力于微纳传感器的定制化研发、生产和销售。

（2）技术方向-加大技术研发力度，提高产品核心竞争力

以客户需求为导向提升技术研发水平是公司提高竞争能力的关键，公司在满足现有客户需求的基础上将进一步加强与潜在客户的交流，深入了解客户需求，掌握行业动向，将不断改进生产工艺，提高产品性能，研发新产品，加大技术改造力度，开发新产品技术，通过拓宽产品的应用领域，提高公司核心竞争力，实现公司长期可持续发展。

（3）人才方向-培养集成电路行业复合型人才

高素质人才队伍是集成电路企业发展的根本支撑，公司一直着力于构建健全的员工培训体系，除了对在岗员工的工艺技能及操作能力进行定期培训与测试外，还由公司核心管理团队与核心技术团队对员工进行管理意识、质量体系意识、产品知识、集成电路行业发展状况的综合培训。

第三节 公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司设立之初，公司未设立董事会及监事会，仅设1名执行董事及1名监事。有限公司股东、股东会及相关管理人员均能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。公司董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。但由于有限公司阶段公司治理机制未能完全建立起来，会议通知多以口头、电话或书面通知的方式表达，告知或分发完毕即视为会议通知行为的完成，有限公司股东会会议的召开并没有履行提前通知的程序；没有保存相关的会议通知资料；会议记录资料也不完整。公司治理机制的健全和执行有待进一步完善。

2018年2月27日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定和完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由5人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由3人组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责，监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长兼总经理一名，财务总监兼董事会秘书一名。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开5次股东大会、5次董事会会议和2次监事会会议，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期

召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司建立与股东之间的协商、仲裁、诉讼等多元化纠纷解决机制；公司切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。

（三）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联事项进行决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者2/3以上通过。有关关联事项的表决投票，应当由2名非关联股东代表参加计票和监票。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，如关联股东未主动回避，非关联股东有权要求其回避。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（四）与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《财务管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（五）公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为,公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的要求。报告期内公司与关联方之间存在较大关联交易和资金往来,但截至本公开转让说明书签署之日,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。公司治理机制存在的不足之处主要在于公司董事会目前尚未聘请独立董事,公司今后根据自身的发展,将聘请独立董事,弥补这一不足,进一步完善公司治理机制。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善,以适应公司不断发展壮大的需要。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况

(一) 公司、子公司的违法违规及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据公司提供的资料及公司董事、监事、高级管理人员提供的说明,并经登录全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)以及全国法院被执行人信息查询网(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)查询,公司不存在违法违规情形,不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。公司已就此出具声明。

(二) 公司控股股东、实际控制人的违法违规及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

经登录全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)以及全国法院被执行人信息查询网站(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)查询,公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在违法违规的情形,不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立

公司主拥有独立、完整的业务流程，独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）公司的资产独立

根据公司的确认并经核查，公司资产完整，拥有与其开展业务相适应的房屋使用权、设备、商标等资产，公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵，权属争议纠纷或其他权属不明的情形。公司资产不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

（三）公司的人员独立

公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东大会任免的情况；公司高级管理人员均在股份公司领取报酬；公司员工的劳动关系、工资报酬以及相应的社会保障均完全独立。截至本公开转让说明书签署日，不存在公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬的情形。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

（四）公司的财务独立

根据公司的声明并经核查，公司设有财务部，下设财务组、出纳组等部门。公司财务部中，财务负责人和大多数财务人员均具有财务专业背景及多年从业经验，公司的财务人员能满足财务核算的需要。公司设置了独立的财务会计部门，

建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度并施行良好，公司财务独立。

（五）公司的机构独立

公司已依照法律和有关规范性文件的要求设有“三会一层”，以及公司经营所必需的业务部门等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责。董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股东利益。公司总经理领导经营管理层负责公司的日常经营管理。

五、公司报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（二）公司报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在改制为股份公司后建立了较为完善的公司治理机制。目前，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》对规范股东及关联方资金占用进行了制度安排，包括需要履行的决策程序

及监督机制等。另外，公司在《关联交易管理制度》中详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司还通过相关规章制度对股东大会、董事会、总经理的相关权限做出明确规定，明确了股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司或者其他股东造成损失的应当依法承担赔偿责任。公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供其本人或其控制的关联方使用。公司的上述资金控制制度能够从制度层面有效地规范及避免公司股东及关联方的资金占用行为。

六、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

1、公司控股股东为英尔捷智能，实际控制人为陆孙华。截至本公开转让说明书签署日，除公司及子公司外，控股股东英尔捷智能未投资于其他企业；实际控制人陆孙华除控制公司、子公司及控股股东英尔捷智能外，连同其近亲属对外投资及担任董监高的其他企业如下：

姓名	职务 (与公司其他关系)	投资公司名称	担任其它控制企业的职务	持股比例(%)
陆孙华	董事长、总经理	苏州英尔捷智能控制有限公司	法定代表人、执行董事	99.98
		上海喜之家创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	50.00
		上海同济建筑工程有限公司	董事	-
		上海同舟电梯有限公司	董事	-
王静红	控股股东、实际控制人 陆孙华之妻	上海寰旭文化传播有限公司	法定代表人、执行董事	50.00
		上海朴存创业投资中心(有限合伙)	-	29.96
		上海喜之家创业投资中心(有限合伙)	-	50.00
陆祎文	陆孙华之子	上海曙荣信息科技有限公司	法定代表人、执行董事	100.00

2、上表中涉及企业的基本情况

(1) 苏州英尔捷智能控制有限公司

情况详见”第一节、基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“(二)前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况”。

(2) 上海喜之家创业投资中心(有限合伙)

喜之家成立于 2016 年 4 月 5 日,住所地为上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J723 室,注册资本:1,000 万元人民币。执行事务合伙人:陆孙华。经营范围:创业投资,投资管理,投资咨询(除金融、证券), (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(3) 上海同济建筑工程有限公司

同济建筑成立于 1992 年 6 月 26 日,住所地为上海市杨浦区四平路 1239 号,法定代表人:成斌。注册资本:1,000 万元人民币。经营范围:建筑装修装饰建设工程设计施工一体化,建筑施工,绿化工程施工,建筑装潢材料,化工产品(不含危险品),机电产品,房屋装潢,通风管道安装,水电安装,制冷设备安装;木制家具的生产、销售;花卉、盆景制作销售与租赁,工艺品制作销售,电脑图文设计制作,旅游用品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件销售,商务信息咨询,企业管理咨询,建筑智能化建设工程专业施工,计算机网络系统工程服务,计算机维修,机械设备的维修、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(4) 上海同舟电梯有限公司

同舟电梯成立于 2000 年 3 月 6 日,住所地为上海市杨浦区赤峰路 75 号,法定代表人:成斌。注册资本:120 万元人民币。经营范围:电梯维修保养,电梯内装潢,电梯配件销售,水箱水泵,普通机械维修,机械配件加工,空调设备安装、维修,提供劳务;消防设施工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(5) 上海寰旭文化传播有限公司

寰旭文化成立于 2016 年 5 月 25 日,住所地为:上海市浦东新区杨高北路 528 号,注册资本为:1000 万元人民币。法定代表人:王静红。经营范围:文化艺术交流活动策划,企业形象策划,图文设计制作,市场营销策划,体育赛事活动策划,公关活动策划,商务咨询,企业管理咨询,会展服务,鲜花的销售,婚

庆礼仪服务，摄影摄像服务，仓储（除危险品），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）上海朴存创业投资中心（有限合伙）

朴存创业成立于 2015 年 7 月 22 日，住所地为：上海市浦东新区莲振路 298 号 3 幢 W208 室。执行事务合伙人：上海朴存投资管理有限公司。注册资本：1000 万元人民币。经营范围：创业投资，投资咨询，实业投资，投资管理，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）上海曙荣信息科技有限公司

曙荣信息成立于 2017 年 11 月 9 日，住所地为：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 H 幢 329 室（上海城桥经济开发区），注册资本为：1,000 万元人民币。法定代表人：陆祎文。经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软硬件开发，计算机系统集成服务，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，上述对外投资单位与公司经营范围不同，实际经营业务与公司没有重合之处，与公司之间不存在同业竞争的行为，也不存在利益冲突。

因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，苏州英尔捷微电子股份有限公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具了《避免同业竞争承诺函》，并签字承诺如下：

“本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争

威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。

本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

序号	姓名	职位（与管理层的关系）	持股数量（股）	
			直接持股	间接持股
1	陆孙华	董事长、总经理	—	28,922,854
2	沈霞	董事、财务总监、董事会秘书	—	—
3	李伟	董事	—	4,150,537
4	张建	董事	—	—
5	叶明	董事	—	—
6	陈荣	监事会主席	—	—
7	任艳	监事	—	5,786
8	沈平	职工代表监事	—	—

（注：陆孙华持有英尔捷智能99.98%的股权，英尔捷智能持有公司59.28%的股份。因此，陆孙华通过英尔捷智能间接持有公司59.27%的股份，间接持股数为28,922,854股。

李伟持有英格诺22%的股权，英格诺持有公司38.66%的股份。因此，李伟通过英格诺间接持有公司8.51%的股份，间接持股数为4,150,537股。

任艳持有英尔捷智能0.02%的股权，英尔捷智能持有公司59.28%的股份。因此，任艳通过英尔捷智能间接持有公司0.01%的股份，间接持股数为5,786股。）

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

经核查，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及核心技术人员均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下表：

姓名	担任本公司职务	兼职单位	对外担任职务	兼职单位与本公司关系
陆孙华	董事长、总经理	苏州英尔捷智能控制有限公司	执行董事	公司控股股东
		苏州英尔捷芯片设计有限公司	执行董事	公司全资子公司
		上海喜之家创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
		上海同济建筑工程有限公司	董事	无其他关联关系
		上海同舟电梯有限公司	董事	无其他关联关系
李伟	董事	苏州英尔捷半导体有限公司	执行董事	公司全资子公司

姓名	担任本公司职务	兼职单位	对外担任职务	兼职单位与本公司关系
		苏州英格诺智能科技有限公司	监事	持有公司 5%以上股份股东
叶明	董事	潍坊弘景源投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	无其他关联关系
		潍坊泰兴源投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	无其他关联关系
任艳	监事	苏州英尔捷智能控制有限公司	监事	公司控股股东
		上海寰旭文化传播有限公司	监事	无其他关联关系
		上海鼓霓新能源科技有限公司	监事	无其他关联关系
		上海曙荣信息科技有限公司	监事	公司实际控制人之子陆祎文持股 100%

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除本公司外对外投资情况如下表所示：

姓名	职务 (与公司其他关系)	投资公司名称	持股比例 (%)
陆孙华	控股股东、实际控制人、 董事长、总经理	苏州英尔捷智能控制有限公司	99.98
		上海喜之家创业投资中心 (有限合伙)	50.00
李伟	董事	苏州英格诺智能科技有限公司	22.00
		苏州斯柏莱微电子有限公司	5.00
		上海增祥电子科技有限公司	5.00
叶明	董事	临沂泰源资产管理有限公司	30.00
任艳	监事	上海寰旭文化传播有限公司	50.00
		上海鼓霓新能源科技有限公司	1.00
		苏州英尔捷智能控制有限公司	0.02
王静红	控股股东、实际控制人	上海寰旭文化传播有限公	50.00

姓名	职务 (与公司其他关系)	投资公司名称	持股比例 (%)
	陆孙华之妻	司	
		上海朴存创业投资中心(有限合伙)	29.96
		上海喜之家创业投资中心(有限合伙)	50.00

2、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

董事、监事、高级管理人员上述对外投资与公司不存在利益冲突情形。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面声明,郑重承诺:公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形;不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为,不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股转系统公司公开谴责的情形。

(七) 董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形,不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

(八) 董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

董事、监事、高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下:

（一）董事变动情况及原因

有限公司阶段，公司未设立董事会，仅设 1 名执行董事，自 2012 年 10 月 15 日起由李伟担任。

2018 年 1 月 31 日，公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，选举陆孙华、沈霞、李伟、潘道强、叶明等 5 名董事组成公司第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举陆孙华为公司董事长。

2018 年 3 月 16 日，董事潘道强因个人原因辞去董事职务，公司召开 2018 年第二次临时股东大会选举张建为公司董事。

由上可见，报告期内公司董事变动主要系业务发展和规范治理需要。目前，公司董事会构成符合现阶段公司发展需要，能够较好地保护公司及广大股东利益，对促进公司规范运作具有积极意义。

（二）监事变动情况及原因

有限公司阶段，公司未设立监事会，仅设立 1 名监事。

2018 年 1 月 31 日，公司召开职工代表大会，选举沈平为股份公司职工代表监事。

2018 年 1 月 31 日，公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，选举陈荣、任艳为股东代表监事，与经职工代表大会选举产生的监事沈平共同组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举陈荣为公司监事会主席。

由上可见，报告期内公司监事变动主要系公司业务发展和规范治理需要，亦符合现阶段公司发展需要，能够较好地保护公司及广大股东利益，对促进公司规范运作具有积极意义。

（三）高级管理人员变动情况及原因

报告期内，2016 年 1 月 1 日到 2018 年 1 月 30 日为有限公司时期，公司高级管理人员仅设总经理一职，为李伟先生。

2018年1月31日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任陆孙华为公司总经理；沈霞为财务总监、董事会秘书。

由上可见，报告期内公司高级管理人员变动主要系股份公司成立后公司经营管理的需要。目前，公司高级管理人员构成符合现阶段公司发展需要，有利于公司现代化的经营管理，对促进公司规范运作具有积极意义。

因此，报告期内公司董事、监事、高级管理人员虽产生了变动，但都是由于公司业务发展需要，在新增股东，扩大规模的前提下发生的，不会对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

第四节 公司财务会计信息

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

（一）最近两年一期的审计意见

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

公司2016年度、2017年度、2018年1-7月财务会计报告已经证券期货相关业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字(2018)3095号标准无保留意见的审计报告。

（二）合并报表范围及变化情况

1、纳入合并范围的子公司

单位：元

单位名称	注册资本 (万元)	实缴资本 (万元)	持股比例 (%)	取得时间	取得方式	注册地
苏州英尔捷半导体有限公司	1,500.00	600.86	100.00	2017.8.28	设立	苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园19-2号厂房
苏州英尔捷芯片设计有限公司	2,000.00	0.00	100.00	2017.11.24	设立	苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场1幢1507室

注：截至2018年7月31日，子公司苏州英尔捷芯片设计有限公司尚未开展经营活动。

2、合并范围变化情况

公司于2017年8月28日设立苏州英尔捷半导体有限公司，公司持股100.00%，自成立日起，公司将其纳入财务报表合并范围。

公司于2017年11月24日设立苏州英尔捷芯片设计有限公司，公司持股100.00%，自成立日起，公司将其纳入财务报表合并范围。

（三）最近两年一期的财务报表

1、合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,244,270.58	505,717.50	115,631.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	10,105,944.69	10,969,427.46	3,034,064.42
预付款项	3,234,564.59	280,126.18	284,680.14
其他应收款	187,062.07	4,280,948.78	159,656.18
存货	358,850.13	1,107,014.73	9,106,375.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,678,648.02	
流动资产合计	17,130,692.06	23,821,882.67	12,700,407.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			138,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	38,928,944.58	41,131,951.36	11,903,244.44
在建工程	122,343.69		
生产性生物资产			
油气资产			

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,177,387.94	4,587,182.66	55,500.52
递延所得税资产	152,990.56	163,364.71	39,921.90
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,381,666.77	45,882,498.73	12,136,666.86
资产总计	60,512,358.83	69,704,381.40	24,837,073.91
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,947,117.86	4,598,482.45	4,298,775.88
预收款项	2,918,325.29	2,687,948.60	497,188.40
应付职工薪酬	176,143.27	150,485.27	87,008.40
应交税费	405,862.14	4,393,768.41	1,093,256.67
其他应付款	775,745.71	6,173,619.33	15,122,381.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,223,194.27	18,004,304.06	21,098,611.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
负债合计	8,223,194.27	18,004,304.06	21,098,611.32
所有者权益：			
实收资本（或股本）	48,800,000.00	38,800,000.00	1,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,219,785.46	11,219,785.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	184,890.21	184,890.21	273,846.26
未分配利润	2,084,488.89	1,495,401.67	2,464,616.33
归属于母公司所有者权益 总计	52,289,164.56	51,700,077.34	3,738,462.59
少数股东权益			
所有者权益合计	52,289,164.56	51,700,077.34	3,738,462.59
负债和所有者权益总计	60,512,358.83	69,704,381.40	24,837,073.91

合并利润表

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	10,473,482.33	35,116,027.83	17,689,275.66
减：营业成本	7,322,701.60	18,452,059.68	13,559,446.89
税金及附加	28,231.09	69,458.22	57,524.09
销售费用	257,827.98	338,289.53	173,732.63
管理费用	1,528,852.10	969,594.03	397,340.55
研发费用	500,318.19	1,039,400.75	478,716.37
财务费用	-112,557.08	91,115.45	-49,740.26
其中：利息费用			
利息收入	978.83	1,195.81	624.12
资产减值损失	-86,179.82	600,294.82	-195,942.43
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	756.16		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,035,044.43	13,555,815.35	3,268,197.82
加：营业外收入		36,352.80	
减：营业外支出	204,327.24	567.70	506.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	830,717.19	13,591,600.45	3,267,691.76
减：所得税费用	241,629.97	3,429,985.70	817,554.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
1. 归属于母公司所有者的净利润	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
2. 少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0121	2.4486	2.4501
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0121	2.4486	2.4501

合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	12,748,954.99	34,810,833.29	22,606,185.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	35,978.83	37,568.61	624.12
经营活动现金流入小计	12,784,933.82	34,848,401.90	22,606,809.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6,785,241.84	8,856,708.35	9,107,116.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,529,698.90	2,001,628.72	1,303,112.91
支付的各项税费	4,467,769.31	683,863.09	206,930.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,691.85	516,801.11	294,957.26
经营活动现金流出小计	14,034,401.90	12,059,001.27	10,912,116.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,468.08	22,789,400.63	11,694,693.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	6,000,000.00	138,000.00	
取得投资收益收到的现金	756.16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	4,240,931.34		
投资活动现金流入小计	10,241,687.50	138,000.00	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,728.70	41,141,840.83	4,285,328.05
投资支付的现金		6,000,000.00	138,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,240,931.34	
投资活动现金流出小	917,728.70	51,382,772.17	4,423,328.05

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
计			
投资活动产生的现金流量净额	9,323,958.80	-51,244,772.17	-4,423,328.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		37,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	335,153.86	5,670,719.33	
筹资活动现金流入小计	335,153.86	43,470,719.33	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	5,670,719.33	14,622,381.97	7,334,551.68
筹资活动现金流出小计	5,670,719.33	14,622,381.97	7,334,551.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,335,565.47	28,848,337.36	-7,334,551.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372.17	-2,879.48	
五、现金及现金等价物净增加额	2,738,553.08	390,086.34	-63,186.66
加：期初现金及现金等价物余额	505,717.50	115,631.16	178,817.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,244,270.58	505,717.50	115,631.16

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2018 年 1-7 月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	38,800,000.00	11,219,785.46			184,890.21	1,495,401.67	51,700,077.34		51,700,077.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	38,800,000.00	11,219,785.46			184,890.21	1,495,401.67	51,700,077.34		51,700,077.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00	-10,000,000.00				589,087.22	589,087.22		589,087.22
(一) 综合收益总额						589,087.22	589,087.22		589,087.22
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入和减少资本									

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	10,000,000.00	-10,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,000,000.00	-10,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变									

动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本期期末余额	48,800,000.00	1,219,785.46			184,890.21	2,084,488.89	52,289,164.56		52,289,164.56

合并所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	1,000,000.00				273,846.26	2,464,616.33	3,738,462.59	3,738,462.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000.00				273,846.26	2,464,616.33	3,738,462.59	3,738,462.59
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）	37,800,000.00	11,219,785.46			-88,956.05	-969,214.66	47,961,614.75	47,961,614.75
（一）综合收益总额						10,161,614.75	10,161,614.75	10,161,614.75
（二）股东投入和减 少资本	37,800,000.00						37,800,000.00	37,800,000.00
1. 股东投入和减少 资本	37,800,000.00						37,800,000.00	37,800,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配					184,890.21	-184,890.21			
1. 提取盈余公积					184,890.21	-184,890.21			
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		11,219,785.46			-273,846.26	-10,945,939.20			
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变									

动额结转留存收益									
5. 其他		11,219,785.46			-273,846.26	-10,945,939.20			
四、本期期末余额	38,800,000.00	11,219,785.46			184,890.21	1,495,401.67	51,700,077.34		51,700,077.34

合并所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2016 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,000,000.00				28,832.51	259,492.58	1,288,325.09		1,288,325.09
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,000,000.00				28,832.51	259,492.58	1,288,325.09		1,288,325.09
三、本期增减变动金额(减					245,013.75	2,205,123.75	2,450,137.50		2,450,137.50

少以“－”号填列)									
(一) 综合收益总额						2,450,137.50	2,450,137.50		2,450,137.50
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入和减少资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配					245,013.75	-245,013.75			
1. 提取盈余公积					245,013.75	-245,013.75			
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									

1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益									
5. 其他									
四、本期期末余额	1,000,000.00				273,846.26	2,464,616.33	3,738,462.59		3,738,462.59

2、母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,073,710.90	308,048.06	115,631.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	8,022,421.03	10,533,949.46	3,034,064.42
预付款项	3,049,794.92	169,242.18	284,680.14
其他应收款	178,703.52	1,343,179.23	159,656.18
存货	235,541.48	1,080,724.13	9,106,375.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,678,648.02	
流动资产合计	14,560,171.85	20,113,791.08	12,700,407.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			138,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,008,600.00	3,708,600.00	
投资性房地产			
固定资产	38,152,256.12	41,131,951.36	11,903,244.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,177,387.94	4,587,182.66	55,500.52
递延所得税资产	142,683.83	145,610.77	39,921.90
其他非流动资产			

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
非流动资产合计	48,480,927.89	49,573,344.79	12,136,666.86
资产总计	63,041,099.74	69,687,135.87	24,837,073.91
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,829,863.66	4,493,468.45	4,298,775.88
预收款项	2,918,325.29	2,629,948.60	497,188.40
应付职工薪酬	82,535.45	60,578.39	87,008.40
应交税费	346,548.24	4,355,052.46	1,093,256.67
其他应付款	3,499,412.84	6,279,400.39	15,122,381.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	10,676,685.48	17,818,448.29	21,098,611.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	10,676,685.48	17,818,448.29	21,098,611.32
所有者权益：			
实收资本（或股本）	48,800,000.00	38,800,000.00	1,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资本公积	1, 219, 785. 46	11, 219, 785. 46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	184, 890. 21	184, 890. 21	273, 846. 26
未分配利润	2, 159, 738. 59	1, 664, 011. 91	2, 464, 616. 33
所有者权益合计	52, 364, 414. 26	51, 868, 687. 58	3, 738, 462. 59
负债和所有者权益总计	63, 041, 099. 74	69, 687, 135. 87	24, 837, 073. 91

母公司利润表

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	7,268,117.65	34,717,552.70	17,689,275.66
减：营业成本	5,239,801.21	18,228,980.54	13,559,446.89
税金及附加	14,499.14	63,950.39	57,524.09
销售费用	126,474.19	261,806.27	173,732.63
管理费用	631,205.49	870,149.25	397,340.55
研发费用	500,318.19	1,039,400.75	478,716.37
财务费用	-114,692.81	90,097.38	-49,740.26
其中：利息费用			
利息收入	657.38	999.34	624.12
资产减值损失	-11,707.77	422,755.47	-195,942.43
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	756.16		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	882,976.17	13,740,412.65	3,268,197.82
加：营业外收入		35,872.80	
减：营业外支出	166,434.85	567.70	506.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,541.32	13,775,717.75	3,267,691.76
减：所得税费用	220,814.64	3,445,492.76	817,554.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	495,726.68	10,330,224.99	2,450,137.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,726.68	10,330,224.99	2,450,137.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	495,726.68	10,330,224.99	2,450,137.50
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,798,344.49	34,745,015.29	22,606,185.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	35,657.38	36,872.14	624.12
经营活动现金流入小计	10,834,001.87	34,781,887.43	22,606,809.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,693,199.96	8,625,412.11	8,870,005.78
支付给职工以及为职工支付的现金	634,882.41	1,953,701.26	1,303,112.91
支付的各项税费	4,354,923.40	683,863.09	206,930.12
支付其他与经营活动有关的现金	637,304.33	419,649.84	532,067.91
经营活动现金流出小计	10,320,310.10	11,682,626.30	10,912,116.72
经营活动产生的现金流量净额	513,691.77	23,099,261.13	11,694,693.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	6,000,000.00	138,000.00	
取得投资收益收到的现金	756.16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494,224.14		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,148,542.34		
投资活动现金流入小计	7,643,522.64	138,000.00	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,000.00	41,141,840.83	4,285,328.05

投资支付的现金	2,300,000.00	9,708,600.00	138,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,148,542.34	
投资活动现金流出小计	2,610,000.00	51,998,983.17	4,423,328.05
投资活动产生的现金流量净额	5,033,522.64	-51,860,983.17	-4,423,328.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		37,800,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	2,889,539.93	5,779,400.39	
筹资活动现金流入小计	2,889,539.93	43,579,400.39	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	5,670,719.33	14,622,381.97	7,334,551.68
筹资活动现金流出小计	5,670,719.33	14,622,381.97	7,334,551.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,781,179.40	28,957,018.42	-7,334,551.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372.17	-2,879.48	
五、现金及现金等价物净增加额	2,765,662.84	192,416.90	-63,186.66
加：期初现金及现金等价物余额	308,048.06	115,631.16	178,817.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,073,710.90	308,048.06	115,631.16

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2018 年 1-7 月						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,800,000.00	11,219,785.46			184,890.21	1,664,011.91	51,868,687.58
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	38,800,000.00	11,219,785.46			184,890.21	1,664,011.91	51,868,687.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00	-10,000,000.00				495,726.68	495,726.68
（一）综合收益总额						495,726.68	495,726.68
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入和减少资本							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）专项储备提取和使用							

1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	10,000,000.00	-10,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,000,000.00	-10,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
四、本年年末余额	48,800,000.00	1,219,785.46			184,890.21	2,037,073.65	52,364,414.26

母公司所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2017 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00				273,846.26	2,464,616.33	3,738,462.59
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,000,000.00				273,846.26	2,464,616.33	3,738,462.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,800,000.00	11,219,785.46			-88,956.05	-800,604.42	48,130,224.99
（一）综合收益总额						10,330,224.99	10,330,224.99
（二）股东投入和减少资本	37,800,000.00						37,800,000.00
1. 股东投入和减少资本	37,800,000.00						37,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							

(三) 专项储备提取和使用							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
(四) 利润分配					184,890.21	-184,890.21	
1. 提取盈余公积					184,890.21	-184,890.21	
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转		11,219,785.46			-273,846.26	-10,945,939.20	
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他		11,219,785.46			-273,846.26	-10,945,939.20	
四、本年年末余额	38,800,000.00	11,219,785.46			184,890.21	1,664,011.91	51,868,687.58

母公司所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2016 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00				28,832.51	259,492.58	1,288,325.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,000,000.00				28,832.51	259,492.58	1,288,325.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					245,013.75	2,205,123.75	2,450,137.50
（一）综合收益总额						2,450,137.50	2,450,137.50
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入和减少资本							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）专项储备提取和使用							

1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
(四) 利润分配					245,013.75	-245,013.75	
1. 提取盈余公积					245,013.75	-245,013.75	
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
四、本年年末余额	1,000,000.00				273,846.26	2,464,616.33	3,738,462.59

二、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收

益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企

业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将

其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性

项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金

融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资

产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为上年度的 12 月 31 日。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映

债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

①不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	押金、保证金；合并范围内的关联方、控股股东和实际控制人的应收款项等

②不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账
无风险组合	不计提

采用账龄分析法计提坏账准备的组合：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大但存在发生减值的客观证据的款项，单项计提坏账准备
-------------	--------------------------------------

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失。
-----------	---

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类:

本公司存货分为原材料、在产品-生产成本、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法:

本公司存货盘存制度采用永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销;周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法:

本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法:

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见9、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定：

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的

公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法:

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵

销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按

比例结转当期损益。

13、固定资产及折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率%
机器设备	10.00	5.00	9.50
运输设备	5.00	5.00	19.00
办公设备及电子设备	3.00	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如

为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

19、收入

（1）一般原则

①商品销售收入

公司主要提供晶圆研磨切割服务、封装测试服务和设备、配件销售。

切割和封装测试服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将完成切割和测试后的产品交付给服务客户，且切割和测试服务收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入企业，产品相关的成本能够可靠地计量。

设备、配件销售收入确认需满足以下条件：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

④让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确

定。

b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

境内销售以商品发运并取得客户或承运人确认为时点确认收入；出口销售以完成出口报关为时点确认收入。

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的

期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资

产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标分析

（一）盈利能力分析

类 别	2018年1-7月	2017年度	2016年度
净利润（元）	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
毛利率（%）	30.08	47.45	23.35
净资产收益率（%）	1.13	84.90	97.48

每股收益（元/股）	0.0121	2.4486	2.4501
-----------	--------	--------	--------

2017 年，公司毛利率、净利润呈上升趋势，盈利水平已有明显提高，主要是因为公司的产品结构发生变化，加大了晶圆研磨切割这一高毛利业务的规模及比例，具体产品毛利率详见下文“四、营业收入、主要费用、利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、利润及变动情况”。公司逐步进行产品结构调整，积极开拓新产品市场，增加高利润率产品在生产销售中所占比重，在可见未来期间，公司产品综合毛利将会有进一步上升。2016 年公司营业收入 90%以上为半导体设备、配件的销售，因此毛利率较低。2018 年 1-7 月公司净利润和毛利率较 2017 年大幅下降，主要是由于（1）受整体行业形势影响，收入规模有所下降；（2）随着 2017 年业务规模的扩大，公司员工增加，同时为拓展业务购置了大额生产设备，租赁了新的办公室，故 2018 年 1-7 月相应的折旧、摊销、租赁等固定费用增加。

2017 年净资产收益率和每股收益较 2016 年降低，主要原因为公司股东于 2017 年对公司进行货币增资，公司实收资本由 100.00 万元增加至 3,880.00 万元，因此导致相关指标较低。2018 年 1-7 月净资产收益率和每股收益降低主要系公司当期注册资本从 3880 万增加到 4880 万元及公司净利润的下降。

（二）偿债能力分析

类 别	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率（%）（母公司）	16.94	25.57	84.95
流动比率（倍）	2.08	1.32	0.60
速动比率（倍）	1.65	1.25	0.16

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 7 月 31 日公司资产负债率分别为 84.95%、25.57%、16.94%，公司整体的资产负债率不高，且呈下降趋势。其中 2016 年末公司的资产负债率较高，主要原因为 2016 年股东投入资本金较小，净资产较小，而负债相对占比较大。随着 2017 年、2018 年 1-7 月公司股本从 100 万元增加到 3,880 万元，再到 4,880 万元，同时公司偿还了部分负债，相应的资产负债率随之下降。

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 7 月 31 日公司流动比率分别为 0.60 倍、1.32 倍、2.08 倍，速动比率分别为 0.16 倍、1.25 倍、1.65 倍。总体来看，报告期内公司流动比率、速动比率较高，呈增长趋势。而且报告期内的全部负债均为流动负债，其中流动负债又以应付账款、预收账款、其他应付款等为主，无长期负债。公司与供应商合作关系良好，有一定的信用期限，因此公司偿债压力不大。总体来说，公司不存在较大偿债风险，偿债能力较强。

（三）营运能力分析

类 别	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	0.96	4.77	3.43
存货周转率（次）	9.99	3.61	1.43

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司的应收账款周转率分别为 3.43 次、4.77 次、0.96 次。公司 2017 年应收账款周转率提高，主要因为主营业务收入的增加幅度高于应收账款的增加幅度。而 2018 年 1-7 月的应收账款周转率有所下降，主要系公司应收账款与年初变化不大，但收入却因整体行业状况而有所下降。

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司的存货周转率分别为 1.43 次、3.61 次、9.99 次，呈增长趋势。主要是原因有：（1）公司业务规模迅速扩大，相应的与收入匹配的成本有所增加；（2）由于公司战略方针的调整，原有针对半导体设备、配件的销售的业务逐渐下降，因此在 2017 年大幅降低了与该项业务的相关的库存。公司为了追逐更高的利润率，着重发展晶圆研磨切割业务，加强了存货量的控制，因而在 2017 年及 2018 年 1-7 月存货大幅下降。

（四）现金流量分析

单位：元

类 别	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
经营活动现金流入	12,784,933.82	34,848,401.90	22,606,809.79
经营活动现金流出	14,034,401.90	12,059,001.27	10,912,116.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,468.08	22,789,400.63	11,694,693.07
投资活动产生的现金流量净额	9,323,958.80	-51,244,772.17	-4,423,328.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,335,565.47	28,848,337.36	-7,334,551.68

类 别	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
现金及现金等价物净增加净额	2,738,553.08	390,086.34	-63,186.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372.17	-2,879.48	
期末现金及现金等价物余额	3,244,270.58	505,717.50	115,631.16

报告期内，现金及现金等价物余额主要受经营活动、投资活动和筹资活动的影响。

1、经营活动现金流量分析

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 11,694,693.07 元、22,789,400.63 元和-1,249,468.08 元。报告期内公司经营活动产生的现金流量波动较大，其中 2018 年 1-7 月经营活动产生的现金流量金额为负数，主要系：（1）公司 2018 年 1-7 月的行业形势严峻，收入规模有所下降，部分应收款项尚未收回；（2）公司为下半年的发展，预付了部分货款，较年初增加了 2,954,438.41 元；（3）公司当期支付前期及本期应缴的税费，使得“支付的各项税费”较 2017 年度增加了 3,783,906.22 元。

2017 年，公司经营性现金流量净额较 2016 年有所改善，主要原因为公司改变了原有的发展战略，着重发展利润率高、回款周期短的晶圆研磨切割业务，使得收入规模有较大幅度的增加。

经营活动现金流量净额与净利润匹配情况如下：

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
净利润	589,087.22	10,161,614.75	2,450,137.50
加：资产减值准备	-86,179.82	600,294.82	-195,942.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,578,475.10	3,823,977.98	949,953.75
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销	710,765.60	1,146,795.60	12,263.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	372.17	2,879.48	
投资损失（收益以“-”号填列）	-756.16		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,374.15	-123,442.81	48,985.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	748,164.60	7,999,360.42	775,427.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,737,833.88	-9,090,113.18	4,446,454.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,061,937.06	8,268,033.57	3,207,412.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,468.08	22,789,400.63	11,694,693.07

2016年、2017年、2018年1-7月，公司净利润分别为2,450,137.50元、10,161,614.75元、589,087.22元，经营活动现金净流量分别为11,694,693.07元、22,789,400.63元、-1,249,468.08元，公司经营活动现金流量净额和公司净利润的差异主要是由于公司存货、经营性应收和应付项目的变动引起。

2、投资活动现金流量分析

投资活动主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产、购买理财产品、拆出资金及对外投资，2016年度、2017年度、2018年1-7月投资活动现金流量净额分别为-4,423,328.05元、-51,244,772.17元、9,323,958.80元。公司2017年较2016年投资活动现金流量净额的减少46,821,444.12元主要系：（1）当期购买集成电路全自动晶圆减薄抛光生产线、集成电路全自动封装线、集成电路产品测试系统等使公司当年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加36,856,512.78元。（2）公司将闲置资金600.00万元用于购买随时可以赎回的银行理财产品。（3）公司当期向关联方苏州冠群微电子有限公司、苏州英尔捷智能控制有限公司提供借款4,240,931.34元。公司2018

年 1-7 月相应的投资活动现金流量金额为正，且较 2017 年有变化较大的原因主要为 2017 年借给关联方款项的收回、理财产品的赎回以及公司当期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期支出有较大幅度减少。

3、筹资活动现金流量分析

筹资活动主要是公司向关联方的借款、还款及公司增资活动，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月筹资活动现金流量净额分别为-7,334,551.68 元、28,848,337.36 元、-5,335,565.47 元。2017 年现金流量净额增加的主要原因是 2017 年公司增资收到股东出资款 3,780 万元。

四、营业收入、主要费用、利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度		2016 年度
	金 额	金额	增长率 (%)	金 额
营业收入	10,473,482.33	35,116,027.83	98.52	17,689,275.66
营业成本	7,322,701.60	18,452,059.68	36.08	13,559,446.89
毛利率	30.08	47.45		23.35
营业利润	1,035,044.43	13,555,815.35	314.78	3,268,197.82
利润总额	830,717.19	13,591,600.45	315.94	3,267,691.76
净利润	589,087.22	10,161,614.75	314.74	2,450,137.50

1、营业收入分析

公司主要提供晶圆研磨切割服务、封装测试服务和设备、配件销售。

切割和封装测试服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将完成切割和测试后的产品交付给服务客户，且切割和测试服务收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入企业，产品相关的成本能够可靠地计量。

设备、配件销售收入确认需满足以下条件：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流

入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

报告期内，公司收入确认的具体方法如下：

境内销售以商品发运并取得客户或承运人确认为时点确认收入；出口销售以完成出口报关为时点确认收入。

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司营业收入分别为 10,473,482.33 元、35,116,027.83 元、17,689,275.66 元。报告期内公司的营业收入增长明显，其中 2017 年较 2016 年增长了 17,426,752.17 元，增幅为 98.52%，主要原因如下：中国大陆地区已经成为全球最大和发展速度最快的半导体市场，随着技术进步和产业提升，我国新进的设计、制造和封装企业对于晶圆研磨切割、封装测试业务的共同需求越来越大。因此，公司瞄准这块巨大的市场，调整公司的产品结构，即 2017 年公司加大了晶圆研磨切割这一高毛利业务的规模及比例，该业务收入比重占 73.24%。而 2016 年公司 90%以上为半导体设备、配件的销售。2018 年 1-7 月营业收入降低主要系中美贸易战中，美国针对中国加征关税主要集中在航空航天、信息技术、通信技术、半导体和机器人等行业。在半导体及信息技术领域，美国主要加征对象为半导体相关设备及零部件、集成电路及零部件（处理器和控制器，存储器，放大器等）、LED、光敏半导体器件、微波器件、分立器件、激光设备，印刷电路板和组件等，作为半导体产业链的重要一环，公司所处行业在 2018 年上半年也受到了较大影响，收入降低。

2、营业利润分析

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司营业利润分别为 3,268,197.82 元、13,555,815.35 元、1,035,044.43 元。随着公司 2017 年销售规模扩大，营业收入大幅增加，公司高附加值的产品投放市场，产生经营效益，产品综合毛利有了明显提高，营业利润有了大幅提高，随着产品市场的逐步扩大和其他新产品的量化生产，营业利润有望继续扩大。

3、利润总额分析

报告期内，公司各期间利润总额与营业利润的差额，主要系税收滞纳金的影响，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月发生的税收滞纳金分别为 506.06 元、567.70 元、166,434.85 元，利润总额与营业利润基本一致。

（二）营业收入构成及变动情况

1、按业务性质分类

单位：元

业务性质	2018 年 1-7 月		2017 年度		2016 年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
主营业务	10,473,482.33	100	35,116,027.83	100	17,689,275.66	100
其他业务						
合计	10,473,482.33	100	35,116,027.83	100	17,689,275.66	100

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月主营业务收入分别为 17,689,275.66 元、35,116,027.83 元、10,473,482.33 元，占营业收入均为 100.00%。报告期内，公司主营业务较为突出。

2、按产品或服务类别分类

单位：元

产品或服务类别	2018 年 1-7 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
设备、配件销售	3,307,518.63	31.58	9,094,869.37	25.90	16,631,821.19	94.02
晶圆研磨切割	6,886,525.75	65.75	25,720,090.20	73.24	799,276.45	4.52
封装测试	279,437.95	2.67	301,068.26	0.86	258,178.02	1.46
合计	10,473,482.33	100.00	35,116,027.83	100.00	17,689,275.66	100.00

公司营业收入主要包括设备、配件销售、晶圆研磨切割和封装测试收入。公司 2016 年，主要是以设备、配件销售为主，占比 94.02%，但从 2017 年起，公司保持原有设备、配件销售业务的基础上，抓住半导体市场发展的趋势，着力发

展晶圆研磨切割业务，同时为封装测试业务做准备，公司当期的晶圆研磨切割收入占比 73.24%，公司收入有了大规模的提高。公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月晶圆研磨切割收入金额分别为 799,276.45 元、25,720,090.20 元、6,886,525.75 元，占总收入的额比重分别为 4.52%、73.24%、65.75%。

3、按地区分布情况

单位：元

地区名称	2018 年 1-7 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华北	49,572.65	0.47		0.00	6,957.26	0.04
华东	8,374,868.73	79.96	33,891,177.57	96.51	15,993,066.78	90.41
华南	510,000.00	4.87	792,000.00	2.26	431,256.40	2.44
西南	1,539,040.95	14.69	281,598.29	0.80		0.00
国外		-	151,251.97	0.43	1,257,995.22	7.11
合计	10,473,482.33	100.00	35,116,027.83	100.00	17,689,275.66	100.00

报告期内，公司的主要销售区域是国内市场，国外市场销售比例较小。国内的销售主要来自于华东地区，主要是公司身处华东地区，利用区域客户群体优势，深度挖掘客户，拓展本区域业务及周边地区业务。后期随着业务的发展，公司市场会逐渐拓展到其他区域。

（三）营业成本构成及变动情况

1、成本构成

单位：元

营业成本构成	2018 年 1-7 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	1,457,670.77	19.91	10,619,750.96	57.55	11,074,107.08	81.67
直接人工	615,783.52	8.41	872,367.92	4.73	612,912.79	4.52
制造费用	5,249,247.31	71.68	6,959,940.80	37.72	1,872,427.02	13.81
合计	7,322,701.60	100.00	18,452,059.68	100.00	13,559,446.89	100.00

报告期内，设备、配件销售的营业成本包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料包括用于晶圆切割业务硅片原片，用于设备销售的半导体设备及配件。制造费用主要包括公司的消耗性存货（蓝膜、刀片、晶片框架、清洗液等）、硅片原片、水电费、装修摊销费、设备折旧费等。

公司业务包括设备、配件销售、晶圆研磨切割和封装测试收入，根据不同业务成本构成有所不同，其中设备、配件销售业务的主要成本为直接材料，晶圆研磨切割和封装测试业务成本主要为制造费用和直接人工，相应的原材料主要是蓝膜、刀片、晶片框架等，为消耗性存货，且部分原材料以循环使用，公司为了便于核算，除客户未提供晶片切割的样本，公司需要单独采购硅片原片外，一般原材料投入直接归集到制造费用核算。2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月直接材料占总成本的比例分别为 81.67%、57.55%、19.91%，2016 年占比较高，系该年度设备、配件的销售收入占比达到 94.02%；2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月制造费用占总成本的比例分别为 13.81%、37.72%、71.68%，比例呈现递增趋势，主要系（1）公司晶圆切割和封装测试业务的增加。（2）系公司在 2017 年购置了价值加大的集成电路全自动晶圆减薄抛光生产线、集成电路全自动封装线、集成电路产品测试系统，生产折旧成本增加。（3）报告期内，仅有 2017 年发生了客户未提供晶圆切割样本的订单，相应“直接材料”发生金额 4,569,570.85 元，除此之外的晶圆切割研磨和封装业务的原材料投入都归集入“制造费用”科目。

2、成本的归集、分配、结转方法

公司生产成本主要包括直接人工、直接材料和制造费用。公司采用分批法即订单法进行成本核算，公司采用订单法进行成本核算与公司业务模式相符，公司以订单式生产为主，以销定产，根据订单情况组织生产。直接材料按订单归集在生产成本-直接材料科目下；直接人工成本按生产人员职工薪酬的每月实际计提数进行归集；制造费用各项目按实际领用材料成本、每月实际发生水电费、折旧费、维修费、加班费、工资等进行归集。直接人工和制造费用月末按实际工时分配到订单，完工后按订单归集的料工费结转至库存商品，实现销售后从库存商品结转至营业成本。

（四）毛利率构成及变动情况

1、主要产品毛利率情况

单位：元

产品或服务类别	2018 年 1-7 月			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
设备、配件销售	3,307,518.63	2,264,767.79	1,042,750.84	31.53
晶圆研磨切割	6,886,525.75	4,888,684.11	1,997,841.64	29.01
封装测试	279,437.95	169,249.70	110,188.25	39.43
合 计	10,473,482.33	7,322,701.60	3,150,780.73	30.08

(续表)

产品或服务类别	2017 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
设备、配件销售	9,094,869.37	6,563,638.53	2,531,230.84	27.83
晶圆研磨切割	25,720,090.20	11,766,359.05	13,953,731.15	54.25
封装测试	301,068.26	122,062.10	179,006.16	59.46
合 计	35,116,027.83	18,452,059.68	16,663,968.15	47.45

(续表)

产品或服务类别	2016 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
设备、配件销售	16,631,821.19	12,886,049.38	3,745,771.81	22.52
晶圆研磨切割	799,276.45	475,567.15	323,709.30	40.50
封装测试	258,178.02	197,830.36	60,347.66	23.37
合 计	17,689,275.66	13,559,446.89	4,129,828.77	23.35

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月的毛利率分别为 23.35%、47.45%、30.08%，毛利率波动较大。公司的收入按产品分类主要分为设备、配件销售、晶圆研磨切割、封装测试收入，其中设备、配件的销售业务与晶圆研磨切割业务毛利率差异较大，故两者占总收入的比重决定着公司综合毛利率的水平。

（1）设备、配件销售业务的毛利率分析

报告期内，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月设备、配件销售业务的毛

利率分别为 22.52%、27.83%、31.53%。其中 2017 年较 2016 年的毛利率增加 5.31 个点，毛利率变动较大，主要有两个原因：第一，集成电路封装测试设备的维修改造升级业务单个订单金额较大，订单数量较小，单一订单的毛利率对整体毛利率影响较大。第二，集成电路封装测试设备的维修改造升级业务为非标业务，客户对设备技术指标及功能要求不同，改造技术指标要求较高或功能要求丰富的订单往往毛利率也较高，不同设备根据成新率、功能、厂商的不同采购及销售价格有较大差异。随着公司在行业内知名度及自身技术储备的提升，公司订单价格也会逐步提升。2018 年 1-7 月毛利率较 2017 年增加 3.7 个百分点的原因主要为 2018 年 1-7 月承接苏州埃缇益自动化科技有限公司设备升级改造及配件销售的订单 692,091.63 元，毛利达到 50.27%，及向光力科技股份有限公司销售半导体设备切割机订单 504,310.34 元，毛利达到 42.00%，且两笔订单收入金额占设备、配件销售金额的比重为 36.17%，综合作用使得公司当期毛利率提高。

（2）晶圆研磨切割业务的毛利率分析

报告期内，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月晶圆研磨切割业务的毛利率分别为 40.50%、54.25%、29.01%。其中 2017 年毛利率较 2016 年增加了 13.75 个点，主要系公司 2016 年刚接触该业务，相应的生产设备及能力有一定的限制，前期生产成本较高，同时为了更好的开拓市场，给予了客户一定的优惠，故 2016 年毛利率较低；随着公司相应业务熟练程度的增加，公司购置了更先进的设备及引进了更专业的工程师，生产成本得以控制。同时公司 2017 年公司订单的增加，大规模生产，设备生产能力得到充分利用，规模效应较大。

2018 年 1-7 月毛利率较 2017 年度有所下降，主要原因为，受业务所在行业季节性因素及中兴事件、中美贸易战的影响，我国集成电路产业受到了一定冲击，公司晶圆研磨切割业务受此影响订单减少，2018 年 1-7 月收入较少，而公司在 2017 年购置了金额较大的生产设备，相应的固定折旧费用增加，故相应制造费用分摊到单位产品成本提高，毛利率有所下降。

（3）封装测试业务的毛利率分析

报告期内，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月封装测试业务的毛利率分别为 23.37%、59.46%、39.43%，毛利率波动较大，原因系 2016 年度公司开始接触该

业务，议价能力较弱，故相应毛利率较低；而且公司承接的该业务，为非标业务，体量较小，相应毛利率波动较大。该业务为公司未来发展的主要业务之一，随着未来业务量的扩大，毛利率会趋于稳定。

2、同行业对比情况

公司选取了晶方科技（603005）、利扬芯片（833474）、明芯微（872556）、技美科技（834064）、艾科瑞思（872600）四家在新三板挂牌公司以及一家主板上市公司进行综合毛利对比分析：

证券代码	证券简称	2017 年综合毛利率 (%)	2016 年综合毛利率 (%)	2017 年营业收入 (元)	2016 年营业收入 (元)
603005.SH	晶方科技	37.20	32.22	628,779,607.76	512,390,368.91
833474.OC	利扬芯片	44.61	55.65	129,320,021.49	96,221,138.82
872556.OC	明芯微	34.72	33.59	48,783,633.57	39,342,053.39
834064.OC	技美科技	12.96	52.08	13,063,222.86	5,801,799.76
872600.OC	艾科瑞思	54.30	55.13	44,254,795.74	20,445,404.27
	平均值	36.76	45.73	172,840,256.28	134,840,153.03
	英尔捷	47.45	23.35	35,116,027.83	17,689,275.66

注：数据来源东方财富choice。

公司2016年主要业务为半导体设备、配件的销售，故选取两家设备销售公司为对比公司。其中：艾科瑞思主营业务为半导体封装测试设备的研发、设计、生产、销售。技美科技主营业务是半导体设备研发、生产与销售。

考虑到公司从2017年开始将业务拓展到晶圆研磨切割方面，且相应的收入占总收入的比重加大，上市公司及新三板公司没有严格的主要做晶圆切割研磨方面的可比公司，故选取主要业务为封装测试、晶圆测试等的对比公司三家。其中：晶方科技主营业务为集成电路的封装测试业务，主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统（MEMS）、生物身份识别芯片、发光电子器件（LED）等提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）及测试服务。利扬芯片主营业务是集成电路制造中的晶圆测试、芯片成品测试等。明芯微主要从事半导体分立器件的研发生产、封装测试和产品销售。

由上表可以看出，2016年公司的综合毛利率低于同行业的平均水平，主要系公司当年销售设备及配件公司销售的收入占比为94.02%，设备、配件的毛利率较

低，而且的设备备件销售系公司进行自主设计，相应部件从外部采购，进行整机装配完成后，运输到客户现场进行安装调试。相应销售的设备为非标准设备，不同订单差异化较大，而且购买的设备多为旧设备，较新设备利润空间较小。

由表中，可以看出同行业的对比公司毛利率波动较大，主要系不同公司主要细分主营业务、公司规模等不同。其中封装测试普遍的行业毛利率在 30%-40%左右，对比公司中晶方科技、明芯微主要业务都为封装测试。公司业务规模扩大到一定程度后，为了继续扩大体量，则必须承接更多标准化的业务，而标准化的业务，虽然可以形成规模效应，但其本身的毛利率相较于特殊定制化的业务而言却更低。可以看出，业务规模最大的晶方科技、毛利率最低。2017 年公司的综合毛利率高于同行业的平均水平，一方面是公司晶圆切割业务占比为 73.24%，相应业务的行业毛利率在 50%-60%左右，且公司承接的封装测试业务大多数为打样订单，具有一定的溢价空间，总体来说公司当年毛利率处于行业最低值和最高值之间，具有一定的合理性。

从上表来看，报告期内公司综合毛利率呈上升趋势，公司具有较好的盈利能力及持续经营能力。

（五）主要费用及变动情况

单位：元

项 目	2018 年 1-7 月	2017 年度		2016 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	257,827.98	338,289.53	94.72	173,732.63
管理费用	1,528,852.10	969,594.03	144.02	397,340.55
研发费用	500,318.19	1,039,400.75	117.12	478,716.37
财务费用	-112,557.08	91,115.45	-283.18	-49,740.26
期间费用合计	2,174,441.19	2,438,399.76	143.83	1,000,049.29
销售费用占主营业务收入 比重 (%)	2.46	0.96		0.98
管理费用占主营业务收入 比重 (%)	14.60	2.76		2.25
研发费用占主营业务收入 比重 (%)	4.78	2.96		2.71

财务费用占主营业务收入 比重 (%)	-1.07	0.26		-0.28
期间费用占比合计	20.76	6.94		5.65

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、运输费、差旅费及摊销费等；管理费用主要是包括职工薪酬、办公费、折旧费、摊销费、车辆租赁费和中介机构费用等；研发费用主要包括人员人工，直接材料投入、折旧费用和摊销费用。财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费支出。

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月期间费用合计分别为 1,000,049.29 元、2,438,399.76 元、2,174,441.19，占营业收入的比重分别为 5.65%、6.94%、20.76%。

从上表可看出报告期内公司期间费用占营业收入的比例整体较低。2018 年 1-7 月的期间费用占收入比例较 2017 年度增加主要是由于 2018 年 1-7 月收入规模较小，而相应的固定费用支出并未减少。

1、销售费用明细及分析

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	83,889.69	215,696.15	103,267.29
包装费	7,684.43	1,642.06	
办公费		200.00	
差旅费	41,013.13	14,234.88	
业务招待费	28,180.00	12,407.00	
运输费	48,203.99	85,889.17	70,465.34
摊销费	41,801.50		
其他	7,055.24	8,220.27	
合计	257,827.98	338,289.53	173,732.63

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司的销售费用分别为 173,732.63 元、338,289.53 元、257,827.98 元，占营业收入的比例分别为 0.98%、0.96%、2.46%，2017 年销售费用有所增加，主要原因为公司新增销售人员且原有销售人员工资上升，当年销售费用的增加比例小于当年营业收入的增加比例。2018 年

1-7 月销售费用占收入比例有所增加，主要系当期房屋装修工程完成，增加了销售部门办公室的摊销费支出 41,801.50 元，同时当期为拓展业务，开市场发生业务招待费及差旅费有所增加。

2、管理费用明细及分析

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	480,992.21	519,137.35	261,864.84
办公费	69,592.48	136,350.30	72,911.77
折旧	19,968.97	13,398.73	699.37
能源费	77,333.41	17,472.44	7,268.61
业务招待费	31,439.37	20,631.00	5,048.00
差旅费	6,374.40	2,465.50	
摊销	66,896.41	114,679.56	8,584.72
中介机构费用	603,635.43	51,171.94	15,434.31
租赁费	135,969.41	93,868.59	9,600.00
印花税			287.90
其他	36,650.01	418.62	15,641.03
合计	1,528,852.10	969,594.03	397,340.55

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司的管理费用分别为 397,340.55 元、969,594.03 元、1,528,852.10 元，占营业收入的比例分别为 2.25%、2.76%、14.60%，2017 年管理费用较 2016 年有较大幅度的增长，主要原因是公司新增管理人员及原有管理人员的工资增加；同时出于公司发展及业务拓展的考虑，租赁了新的办公场所，且新办公室当年装修完毕，相应的租赁费及摊销费用增加。

公司 2018 年 1-7 月管理费用增加一方面系公司于 2017 年 8 月 28 日设立子公司苏州英尔捷半导体有限公司，相应管理人员于 2017 年 11 月陆续入职，相应的人工费，房屋租赁费用增加；另一方面公司当期支付资产评估费、审计费等企业挂牌过程中的中介服务费 603,635.43 元。

3、研发费用明细及分析

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
直接人工	215,246.36	328,427.18	234,091.68
直接投入	211,802.27	585,627.17	237,110.65
折旧费用	6,373.15	10,666.84	7,514.04
长期待摊费用	66,896.41	114,679.56	
合计	500,318.19	1,039,400.75	478,716.37

2016年度、2017年度、2018年1-7月公司的研发费用分别为478,716.37元、1,039,400.75元、500,318.19元，占营业收入的比例分别为2.71%、2.96%、4.78%。研发费用主要为直接材料投入及人工成本。

4、财务费用明细及分析

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
利息支出			
减：利息收入	978.83	1,195.81	624.12
金融机构手续费	10,780.42	29,684.16	4,390.38
汇兑损益	-122,358.67	62,627.10	-53,506.52
合计	-112,557.08	91,115.45	-49,740.26

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月公司的研发费用分别为-49,740.26 元、91,115.45 元、-112,557.08 元，主要系人民币对美元汇率的变动，产生的汇兑损益所致。2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 7 月 31 日人民币对美元的汇率中间价分别为 6.4936、6.937、6.5342、6.8165，美元从升值到贬值再到升值，引起公司汇兑损益先增加后减少到再增加。

公司规模较小尚处于成长期，收入波动较大，相应的期间费用占营业收入的比例也呈现较大波动。但总体而言，期间费用的发生额与公司的规模相匹配，符合公司成长阶段的特征。

(六) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2018年1-7月	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	756.16		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,327.24	35,785.10	-506.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-189.04	-9,016.20	126.52
少数股东权益影响额			
合计	-203,760.12	26,768.90	-379.55

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月非经常性损益分别为-379.55 元、26,768.90 元、-203,760.12 元，金额较小，对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司的非经常性损益，主要为税收滞纳金。

（七）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、税项

税种	计税依据	税率%		
		2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
增值税	应税销售商品收入	6/16/17	6/17	6/17
城市维护建设税	应纳流转税额	7	7	7
教育费附加	应纳流转税额	3	3	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2	2	2
企业所得税	应纳税所得额	25/10	25/10	25

2、公司及子公司税收优惠情况

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于小微企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34 号），自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

子公司苏州英尔捷半导体有限公司报告期内为小微企业，享受减半征收企业所得税优惠政策。

五、报告期的主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
库存现金：	-	-	-
银行存款：	3,244,245.09	505,717.50	115,631.16
其他货币资金：	-	-	-
合计	3,244,245.09	505,717.50	115,631.16
其中：受限货币资金情况	-	-	-

报告期内，公司的货币资金为银行存款。2018年7月末，银行存款余额增长幅度较大，主要原因为2018年1-7月公司业务较少，因此有闲置资金3,244,245.09元。

报告期末，公司货币资金余额能够满足现有业务的日常经营需求，不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放境外潜回收风险的款项。

（二）应收票据及应收账款

单位：元

种类	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收票据	370,141.69	50,000.00	
应收账款	9,735,803.00	10,919,427.46	3,034,064.42
合计	10,105,944.69	10,969,427.46	3,034,064.42

1、应收票据

（1）应收票据分类

单位：元

项 目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	370,141.69	50,000.00	
商业承兑汇票			
合 计	370,141.69	50,000.00	

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项 目	2018.7.31 终止确认金 额	2018.7.31 未终止确 认金额	2017.12.31 终止确认金 额	2017.12.31 未终止确认 金额	2016.12.31 终止确认金 额	2016.12.31 未终止确认 金额
银 行 承	613,659.00	-	400,000.00	-	-	-

项 目	2018. 7. 31 终止确认金 额	2018. 7. 31 未终止确 认金额	2017. 12. 31 终止确认金 额	2017. 12. 31 未终止确认 金额	2016. 12. 31 终止确认金 额	2016. 12. 31 未终止确认 金额
兑汇票						
商 业 承 兑汇票	-	-	-	-	-	-
合 计	613,659.00	-	400,000.00	-	-	-

(3) 截至2018年7月31日，公司应收票据的明细情况如下：

单位：元

出票人全称	前手	票据号	汇票金额	出票日期	票据到期日
深圳市凌云微 科技有限公司	苏州市锐拓 微电子有限 公司	132058400200 220180205159 161409	88,376.69	2018/2/5	2018/8/5
深圳市万恒光 电有限公司	四川遂宁市 利普芯微电 子有限公司	132058400210 920180301167 229989	71,765.00	2018/3/1	2018/9/1
西安特锐德智 能充电科技有 限公司	南京矽邦半 导体有限公 司	130179100050 820180514193 509618	40,000.00	2018/5/14	2018/11/14
宁波市诚意电 子科技有限公 司	四川遂宁市 利普芯微电 子有限公司	140233201241 320180207160 908102	20,000.00	2018/2/7	2018/8/7
张家港市澳东 帆尔针织服饰 有限公司	四川遂宁市 利普芯微电 子有限公司	131330566001 120180521196 369950	50,000.00	2018/5/21	2018/11/21
海宁凯耀国际 贸易有限公司	四川遂宁市 利普芯微电 子有限公司	140233554110 220180517195 214247	100,000.00	2018/5/17	2018/11/17

2、应收账款

(1) 报告期内，公司应收账款列示如下：

单位：元

种 类	2018 年 7 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,408,346.38	100.00	672,543.38	6.46	9,735,803.00
组合1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,408,346.38	100.00	672,543.38	6.46	9,735,803.00
组合2 无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,408,346.38	100.00	672,543.38	6.46	9,735,803.00

续:

种 类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,524,790.43	100.00	605,362.97	5.25	10,919,427.46
组合1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,524,790.43	100.00	605,362.97	5.25	10,919,427.46
组合2 无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,524,790.43	100.00	605,362.97	5.25	10,919,427.46

续:

种 类	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,193,752.02	100.00	159,687.60	5.00	3,034,064.42
组合1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,193,752.02	100.00	159,687.60	5.00	3,034,064.42
组合2 无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,193,752.02	100.00	159,687.60	5.00	3,034,064.42

① 报告期内，公司无年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

时间	账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	净值
2018年7月31日	1年以内	7,365,825.20	70.77	368,291.26	6,997,533.94
	1至2年	3,042,521.18	29.23	304,252.12	2,738,269.06
	合计	10,408,346.38	100.00	672,543.38	9,735,803.00
2017年12月31日	1年以内	10,942,321.52	94.95	547,116.08	10,395,205.44
	1至2年	582,468.91	5.05	58,246.89	524,222.02
	合计	11,524,790.43	100.00	605,362.97	10,919,427.46
2016年12月31日	1年以内	3,193,752.02	100.00	159,687.60	3,034,064.42
	合计	3,193,752.02	100.00	159,687.60	3,034,064.42

报告期内，公司无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

如上表所示，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年7月31日公司的应收账款账面价值分别为3,034,064.42元、10,969,427.46元、9,735,803.00元。2017年12月31日，应收账款余额较大，主要系本年度新增业务导致相应的应收账款余额迅速扩大。公司与客户关系紧密，历年应收款项回收状况良好，回款风险小，不存在应收账款无法收回的情况。

报告期内，公司业务主要包括晶圆切割研磨、封装测试、设备及配件销售业

务。公司的应收账款的结算政策为：晶圆切割研磨及封装测试业务一般是月结，在每月结算后6个月内收款，长期合作的客户会适当给予延长3个月的信用期。设备销售的结算方法是：签合同后三日内先预付30%货款，出货前支付30%货款，货物达到及调试完成后二周内支付30%，剩余款项在对方验收合格之后结清，公司一般在调试完成后确定收入。封装测试的信用期一般为订单完成的次月结清。报告期内，公司的信用期未发生明显发生变化。

报告期内,2017年12月31日应收款项增加主要系当年大规模拓展晶圆切割研磨业务，相应收入增加25,720,090.20元，造成该部分应收款项增加，且相应款项都在信用期内。

2018年1-7月的应收款项主要系公司当年销售收入的款项尚在信用期内，及前期销售设备款项尾款未收回所致。截至2018年7月31日，1-2年的应收款项主要系销售给苏州拓为机电有限公司、万享供应链管理（上海）有限公司、浙江红果微电子有限公司等公司设备尾款未收回，而半导体设备销售行业普遍存在设备尾款拖延时间较长的情况，公司的相应事项符合行业基本情况。

综上，公司各报告期的应收账款是与公司生产经营规模相匹配的。

（2）公司的坏账政策

报告期内公司应收账款坏账准备计提政策见说明书“第四节公司财务会计信息”之“二、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响”之“（一）主要会计政策、会计估计”之“10、应收款项”。

公司采用账龄分析法计提坏账准备的坏账政策与同行业其他公司对比：

账龄	603005.SH 晶方科技	833474.OC 利扬芯片	872556.OC 明芯微	834064.OC 技美科技	872600.OC 艾科瑞思	
1年以内	2%	3%	5%	5%	3%	5%
1至2年	10%	10%	10%	10%	5%	10%
2至3年	30%	30%	20%	50%	10%	30%
3至4年	50%	100%	50%	100%	30%	50%
4至5年	50%	100%	50%	100%	50%	80%

5 年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-------	------	------	------	------	------	------

说明：数据来源于东方财富 choice。

如上表所示，由于报告期内公司应收账款账龄都未超过两年，故采用账龄分析法一年以内、1-2 年分别按 5%、10%计提坏账准备，与同行业其他公司相比选取了较为谨慎的坏账政策。同时公司采用账龄分析法整体计提比例处于行业较为谨慎的中间值，体现了公司严谨的坏账计提政策。

(3) 报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下表：

2018 年 7 月 31 日应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
上海增祥电子科技有限公司	2,207,262.50	1 年以内	21.21	非关联方	货款
苏州埃缇益自动化科技有限公司	1,451,600.00	1 年以内	13.95	非关联方	货款
万享供应链管理（上海）有限公司	1,187,084.27	1-2 年	11.40	非关联方	货款
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	781,947.00	1 年以内	7.51	非关联方	货款
苏州拓为机电有限公司	842,880.00	1-2 年	8.10	非关联方	货款
合 计	6,470,773.77		62.17		

2017 年 12 月 31 日应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
苏州埃缇益自动化科技有限公司	1,634,974.40	1 年以内 1,600,974.40 元，1-2 年 34,000.00	14.19	非关联方	货款
苏州德瑞恩电子有限公司	1,603,017.00	1 年以内	13.91	非关联方	货款

上海增祥电子科技有限公司	1,522,462.50	1年以内	13.21	非关联方	货款
苏州新美光纳米科技有限公司	1,342,036.50	1年以内	11.64	非关联方	货款
万享供应链管理（上海）有限公司	1,137,922.11	1年以内	9.87	非关联方	货款
合 计	7,240,412.51		62.82		

2016年12月31日应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占比(%)	与公司关系	款项性质
万享供应链管理（上海）有限公司	989,414.95	1年以内	30.98	非关联方	货款
嘉兴景焱智能装备技术有限公司	690,877.50	1年以内	21.63	非关联方	货款
浙江红果微电子有限公司	416,182.91	1年以内	13.03	非关联方	货款
泛泰科技股份有限公司	277,480.00	1年以内	8.69	非关联方	货款
苏州微邦电子有限公司	200,000.00	1年以内	6.26	非关联方	货款
合 计	2,573,955.36		80.59		

（4）公司应收款余额中不存在应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（5）报告期内，公司不存在应收账款长期未收回款项。

（6）报告期内或期后，公司不存在有大额冲减的应收款项。

（7）公司截至2018年12月18日的期后回款情况如下：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	期后回款金额	回款占比
上海增祥电子科技有限公司	2,207,262.50	1年以上	21.21	2,000,000.00	19.22

苏州埃缙益自动化科技有限公司	1,451,600.00	1 年以上	13.95	1,451,600.00	13.95
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	781,947.00	1 年以内	7.51	781,947.00	7.51
南京矽邦半导体有限公司	318,834.24	1 年以内	3.06	318,834.24	3.06
苏州百克晶电子科技有限公司	204,000.00	1 年以内	1.96	204,000.00	1.96
上海泰睿思微电子有限公司	141,295.62	1 年以内	1.36	141,295.62	1.36
其他	5,303,407.02		50.95	494,086.00	4.75
合计	10,408,346.38		100.00	5,391,762.86	51.80

截至到 2018 年 12 月 18 日，公司的应收账款回款收回比例为 51.80%，公司会继续保持收款催收力度，将应收款项尽快收回。

（三）预付款项

1、预付款项按照账龄列示如下：

单位：元

账龄	2018 年 7 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,110,269.24	96.16	280,126.18	100.00	284,680.14	100.00
1 至 2 年	124,295.35	3.84				
合计	3,234,564.59	100.00	280,126.18	100.00	284,680.14	100.00

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 7 月 31 日公司预付账款余额分别为 284,680.14 元、280,126.18 元、3,234,564.59 元。预付账款主要为预付原材料款及设备款，预付账款与公司的生产活动相匹配，且无长期挂账情况。

公司 2018 年 1-7 月预付款项较 2017 年度大幅度增加主要系预付给供应商的设备款项，是公司购买的用于公司设备销售的存货及少量用于生产活动必备的新购置的固定资产，都与生产经营活动相关，相应的存货采购是根据相应的销售订单进行采购，固定资产的采购是根据公司生产经营需要，经过采购部申请，层层

审批之后进行的采购事项。该部分预付款项，根据会计准则进行确认和计量，不存在未及时转销的情形。

2、报告期内预付款项前五名列示如下：

(1) 2018 年 7 月 31 日预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
ALLTECA ELECTRONIC TECANOLOGY CO., LIMITED	1,243,309.50	1 年以内	38.44
苏州斯尔特微电子有限公司	742,400.00	1 年以内	22.95
苏州首肯机械有限公司	213,900.00	1 年以内	6.61
SEMIMAX KOREA CORPORATION	204,495.00	1 年以内	6.32
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	180,000.00	1 年以内	5.57
合 计	2,584,104.50		79.89

(2) 2017 年 12 月 31 日预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
SURPLUSGLOBAL INC	116,962.18	1 年以内	41.75
迪思科科技（中国）有限公司	52,884.00	1 年以内	18.88
上海允哲机电科技有限公司	50,000.00	1 年以内	17.85
上海增祥电子科技有限公司	28,000.00	1 年以内	10.00
中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司	15,000.00	1 年以内	5.35
合 计	262,846.18		93.83

(3) 2016 年 12 月 31 日预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
苏州威盾环保科技有限公司	257,950.00	1 年以内	90.62
苏州中智人力资源有限公司	10,971.36	1 年以内	3.85

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
上海宏轶电子科技有限公司	8,400.00	1 年以内	2.95
苏州工业园区兆阳资产管理有限公司	7,358.78	1 年以内	2.58
合 计	284,680.14		100.00

截至报告期各期末，应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种 类	2018 年 7 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	188,321.29	100.00	1,259.22	0.67	187,062.07
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	25,184.40	13.37	1,259.22	5.00	23,925.18
组合 2 无风险组合	163,136.89	86.63			163,136.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	188,321.29	100.00	1,259.22	0.67	187,062.07

续：

种 类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,435,568.23	100.00	154,619.45	3.49	4,280,948.78

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	3,092,389.00	69.72	154,619.45	5.00	2,937,769.55
组合 2 无风险组合	1,343,179.23	30.28			1,343,179.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合 计	4,435,568.23	100.00	154,619.45	3.49	4,280,948.78

续:

种 类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	159,656.18	100.00			159,656.18
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款					
组合 2 无风险组合	159,656.18	100.00			159,656.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合 计	159,656.18	100.00			159,656.18

① 报告期内, 公司无年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净值
2018 年 7 月 31 日	1 年以内	25,184.40	100.00	1,259.22	5.00
	合计	25,184.40	100.00	1,259.22	5.00
2017 年 12 月 31 日	1 年以内	3,092,389.00	100.00	154,619.45	5.00
	合计	3,092,389.00	100.00	154,619.45	5.00
2016 年 12 月 31 日	1 年以内	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-

③ 报告期内, 公司无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证金、押金	163,136.89	194,636.89	159,636.89
应收控股股东款项		1,148,542.34	
备用金	25,184.40		
代扣社保			19.29
往来款		3,092,389.00	
合计	188,321.29	4,435,568.23	159,656.18

(3) 报告期内公司其他应收款欠款前五名情况如下表：

2018年7月31日其他应收款前五名情况

单位：元

供应商名称	金额	账龄	占比(%)	与公司关系	款项性质
苏州工业园区兆阳资产管理有限公司	159,636.89	1-2年	84.77	非关联方	保证金、押金
彭劲松	11,000.00	1年以内	5.84	员工	备用金
徐祥丽	7,000.00	1年以内	3.72	员工	备用金
张海云	5,584.40	1年以内	2.97	员工	备用金
苏州红璞公寓管理有限公司	3,500.00	1年以内	1.86	非关联方	保证金、押金
合 计	186,721.29		99.15		

2017年12月31日其他应收款前五名情况

单位：元

供应商名称	金额	账龄	占比(%)	与公司关系	款项性质
苏州冠群微电子有限公司	3,092,389.00	1年以内	69.72	关联方	往来款
苏州英尔捷智能控制有限公司	1,148,542.34	1年以内	25.89	关联方	往来款

苏州工业园区兆阳资产管理有限公司	159,636.89	1-2 年	3.60	非关联方	押金
格上租赁有限公司	35,000.00	1 年以内	0.79	非关联方	押金
合 计	4,435,568.23		100.00		

2016 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

单位：元

供应商名称	金额	账龄	占比 (%)	与公司关系	款项性质
苏州工业园区兆阳资产管理有限公司	159,636.89	1 年以内	99.99	非关联方	保证金、押金
代扣社保	19.29	1 年以内	0.01	非关联方	代扣社保
合 计	159,656.18		100.00		

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年7月31日其他应收款前五名余额分别159,656.18元、4,435,568.23元、186,721.29元，分别占当年其他应收款余额的比例为100.00%、100.00%、99.15%。公司的其他应收款前五名主要是往来款、押金、备用金等。

(4) 公司其他应收款余额中应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况如下：

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应收款：			
苏州英尔捷智能控制有限公司		1,148,542.34	

(5) 报告期内，公司其他应收款不存在长期未收回款项。

(五) 存货

单位：元

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
原材料	358,850.13	1,107,014.73	9,106,375.15
合计	358,850.13	1,107,014.73	9,106,375.15

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年7月31日，公司存货分别为9,106,375.15元、1,107,014.73元、358,850.13元，占公司总资产的比例分别为36.66%、1.59%、0.59%，随着公司发展战略的改变，公司逐步清空原有库存，减少低利润率业务，因此存货余额逐年下降。

存货主要是为进行晶圆研磨切割所需要的晶片框架、蓝色胶带、蓝膜、不同尺寸的硅片、金刚石切割片、离型纸、圆划片刀等消耗性的存货，以及为销售设备购入的焊割机、固晶体、贴膜机等设备，都为一年内购入。

公司存货状态良好，不存在呆滞、毁损等明显减值迹象，各类产品毛利率为正，并且公司以销定产，根据订单确定采购备货与生产，不存在存货账面价值低于可变现净值（即合同价格），不存在跌价迹象，故不需计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税		678,648.02	
理财产品		6,000,000.00	
合计		6,678,648.02	

公司的其他流动资产主要是待抵扣的进项税及购买的理财产品。

报告期内，银行理财产品明细如下：

合作方名称	产品类型	风险等级	产品名称	购买金额(元)	起始日期	产品期限	预期收益率	已赎回金额(元)	赎回日期	剩余金额(元)
中国建设银行苏州分行	非保本浮动收益型	两盏警示灯	“乾元-鑫溢江南”（按日）开放式资产组	6,000,000.00	2017年12月31日	无固定期限	浮动收益 1天-7天， 2.80%； 7天-14天， 2.90%； 14天-30天， 3.00%； 30天-60	6,000,756.16	2018年1月2日	0

			合型 人民 币理 财产 品				天， 3.30%； 60天-90 天， 3.50%； 90天-270 天， 3.80%； 270天 -365天， 3.90%。			
合计				6,000,000.00				6,000,756.16		0

公司购买的理财产品属于随时可以赎回的类型，上述理财产品虽然都为浮动收益产品，但都属于稳健型，本金亏损的风险较小。公司购买银行理财产品的资金为公司闲置资金，对公司持续经营能力不存在重大不利影响。

（七）可供出售金融资产

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
可供出售权益性工具			138,000.00
合计			138,000.00

1、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股 比例（%）
	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31	
苏州捷研芯纳米科技有限公司		138,000.00		138,000.00	6.00
合计		138,000.00		138,000.00	6.00

（续）

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股 比例（%）
	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31	

苏州捷研芯纳米材料科技有限公司	138,000.00		138,000.00		
合计	138,000.00		138,000.00		

可供出售金融资产核算的主要是 2016 年 12 月公司以 13.8 万购买持公司股份 1.55% 的股东苏州捷研芯纳米材料科技有限公司 6% 股权的事项, 该股权公司于 2017 年 8 月分别将实缴出资 6.9 万元以 6.9 万元的价格转给李伟, 将实缴出资 2.3 万元以 2.3 万元的价格转给方醉敏, 将实缴出资 2.3 万元以 2.3 万元的价格转给龚洁伟, 将实缴出资 2.3 万元以 2.3 万元的价格转给申亚琪, 相应的股权全部转让, 截至 2018 年 7 月 31 日不存在对外参股的事项。

(八) 固定资产

1、截至 2018 年 7 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表:

单位: 元

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 2017.12.31 余额	45,684,582.95	150,660.42	210,307.69	46,045,551.06
2. 本年增加金额	375,468.32	-	-	375,468.32
(1) 购置	375,468.32	-	-	375,468.32
(2) 在建工程转入				
3. 本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2018.7.31 余额	46,060,051.27	150,660.42	210,307.69	46,421,019.38
二、累计折旧				
1. 2017.12.31 余额	4,813,430.87	69,668.74	30,500.09	4,913,599.70
2. 本年增加金额	2,536,933.53	18,232.48	23,309.09	2,578,475.10
(1) 计提	2,536,933.53	18,232.48	23,309.09	2,578,475.10
3. 本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2018.7.31 余额	7,350,364.40	87,901.22	53,809.18	7,492,074.80
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2018.7.31 账面价值	38,709,686.87	62,759.20	156,498.51	38,928,944.58

2. 2017. 12. 31 账面价值	40,871,152.08	80,991.68	179,807.60	41,131,951.36
----------------------	---------------	-----------	------------	---------------

2、截至 2017 年 12 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 2016. 12. 31 余额	12,777,266.31	84,437.46	131,162.39	12,992,866.16
2. 本年增加金额	32,907,316.64	66,222.96	79,145.30	33,052,684.90
（1）购置	32,907,316.64	66,222.96	79,145.30	33,052,684.90
（2）在建工程转入				
3. 本年减少金额				
4. 2017. 12. 31 余额	45,684,582.95	150,660.42	210,307.69	46,045,551.06
二、累计折旧				
1. 2017. 1. 1 余额	1,041,705.35	47,217.00	699.37	1,089,621.72
2. 本年增加金额	3,771,725.52	22,451.74	29,800.72	3,823,977.98
（1）计提	3,771,725.52	22,451.74	29,800.72	3,823,977.98
3. 本年减少金额				
4. 2017. 12. 31 余额	4,813,430.87	69,668.74	30,500.09	4,913,599.70
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2017. 12. 31 账面价值	40,871,152.08	80,991.68	179,807.60	41,131,951.36
2. 2016. 12. 31 账面价值	11,735,560.96	37,220.46	130,463.02	11,903,244.44

3、截至 2016 年 12 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 2015. 12. 31 余额	9,224,669.27	51,958.83		9,276,628.10
2. 本年增加金额	3,552,597.04	32,478.63	131,162.39	3,716,238.06
（1）购置	3,552,597.04	32,478.63	131,162.39	3,716,238.06
（2）在建工程转入				
3. 本年减少金额				
4. 2016. 12. 31 余额	12,777,266.31	84,437.46	131,162.39	12,992,866.16
二、累计折旧				

1. 2015. 12. 31 余额	94,390.57	45,277.40		139,667.97
2. 本年增加金额	947,314.78	1,939.60	699.37	949,953.75
(1) 计提	947,314.78	1,939.60	699.37	949,953.75
3. 本年减少金额				
4. 2016. 12. 31 余额	1,041,705.35	47,217.00	699.37	1,089,621.72
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2016. 12. 31 账面价值	11,735,560.96	37,220.46	130,463.02	11,903,244.44
2. 2015. 12. 31 账面价值	9,130,278.70	6,681.43		9,136,960.13

公司的固定资产分为机器设备、电子设备和办公设备三类。其中机器设备主要是晶圆研磨切割机、集成电路全自动晶圆减薄抛光生产线、集成电路全自动封装线、集成电路产品测试系统等，电子设备主要系公司办公用的设备，如电脑、打印机等，办公设备主要是公司的空调及办公家具等。

其中 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 7 月 31 日机器设备占固定资产的比例分别为 98.34%、99.22%、99.22%，机器设备成新率较高，都在 80%以上，不存在淘汰的情况。

目前，公司固定资产能够满足日常经营的需要，保存良好，公司经营活动稳定，未来有足够的现金流入，且均处于正常使用状态，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

（九）在建工程

1、截至 2018 年 7 月 31 日公司在建工程情况如下表：

单位：元

项 目	2018. 7. 31 余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	122,343.69		122,343.69
合 计	122,343.69		122,343.69

2. 重要在建工程项目本年变动情况

单位：元

项目名称	预算数	2017 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2018 年 7 月 31 日
装修工程	230,000.00		122,343.69			122,343.69
合 计			122,343.69			122,343.69

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
装修工程	53.19	54.00		0		自有
合 计				0		

公司的在建工程为公司三楼车间的装修工程，系公司委托苏州净佰仟环保净化工程有限公司进行装修的业务，预算金额为 230,000.00 元，现该装修工程进度达到 50%以上，待全部完工后转让长期待摊费用，在剩余租赁期内进行摊销。

(十) 长期待摊费用

1、截至 2018 年 7 月 31 日公司长期待摊费用如下表：

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2018 年 7 月 31 日
装修费	4,587,182.66	300,970.88	710,765.60	4,177,387.94
合 计	4,587,182.66	300,970.88	710,765.60	4,177,387.94

2、2017 年 12 月 31 日公司长期待摊情况如下表：

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2017 年 12 月 31 日
装修费	55,500.52	5,678,477.74	1,146,795.60	4,587,182.66
合 计	55,500.52	5,678,477.74	1,146,795.60	4,587,182.66

3、2016 年 12 月 31 日公司长期待摊情况如下表：

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2016 年 12 月 31 日
-----	------------------	------	------	------------------

装修费	12,263.85	55,500.52	12,263.85	55,500.52
合 计	12,263.85	55,500.52	12,263.85	55,500.52

公司的长期待摊费用主要是公司现位于星华产业园 19 号楼的办公场所的装修工程 500 万及弱电工程 80 万。相应摊销期限按照相应工程竣工后，现办公室的剩余租赁期限摊销。现办公室的租赁期限为 2016 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，其中合同约定前两个月为装修阶段的免租期。

六、报告期的主要负债情况

（一）应付票据及应付账款

1、应付票据

报告期内，公司未发生相应事项。

2、应付账款

（1）报告期内公司应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2018 年 7 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,992,582.64	50.48	4,062,816.81	88.35	4,276,230.44	99.48
1-2 年	1,931,989.78	48.95	513,120.20	11.16	22,545.44	0.52
2-3 年	22,545.44	0.57	22,545.44	0.49		0.00
合 计	3,947,117.86	100.00	4,598,482.45	100.00	4,298,775.88	100.00

报告期内，公司的应付账款大多在2年以内，公司应付账款结构较为合理，与多家供应商保持了较为稳定的合作关系，且已经制定严格的付款计划，确保及时付款。截至说明书签署日，公司不存在大额未及时归还的应付款项。

（2）报告期内公司应付账款按款项性质列示：

单位：元

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付货款	1,656,438.08	2,173,257.22	4,298,775.88

应付装修款	2, 290, 679. 78	2, 425, 225. 23	
合计	3, 947, 117. 86	4, 598, 482. 45	4, 298, 775. 88

公司的应付账款主要由应付货款及应付装修款组成。

(3) 报告期内应付账款前五名情况：

2018 年 7 月 31 日应付账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	上海建善建筑装饰工程有限公司	非关联方	1, 670, 679. 78	装修款	1-2 年
2	深圳市蓝科星科技有限公司	非关联方	960, 800. 81	货款	1 年以内
3	上海迪建信息科技有限公司	非关联方	620, 000. 00	装修款	1 年以内
4	苏州新美光纳米科技有限公司	非关联方	268, 820. 00	货款	1 年以内 7, 650. 00 元, 1-2 年 261, 170. 00 元
5	深圳市韦奥电子有限公司	非关联方	118, 000. 00	货款	1 年以内
合计			3, 638, 300. 59		

2017 年 12 月 31 日应付账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	上海建善建筑装饰工程有限公司	非关联方	2, 425, 225. 23	装修款	1 年以内
2	深圳市蓝科星科技有限公司	非关联方	1, 048, 712. 81	货款	1 年以内
3	东莞观在自动化设备有限公司	非关联方	510, 000. 00	货款	1-2 年
4	苏州新美光纳米科技有限公司	非关联方	267, 270. 00	货款	1 年以内
5	深圳市韦奥电子有限公司	非关联方	118, 000. 00	货款	1 年以内
合计			4, 369, 208. 04		

2016 年 12 月 31 日应付账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	苏州冠群微电子有限公司	关联方	2,766,176.00	货款	1 年以内
2	东莞观在自动化设备有限公司	非关联方	510,000.00	货款	1 年以内
3	格福斯半导体（苏州）有限公司	非关联方	300,000.00	货款	1 年以内
4	苏州新美光纳米科技有限公司	非关联方	237,200.00	货款	1 年以内
5	万享供应链管理（上海）有限公司	非关联方	113,846.44	货款	1 年以内
合计			3,927,222.44		

（二）预收账款

（1）报告期内公司预收账款情况如下表：

单位：元

项目	2018 年 7 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,720,736.89	93.23	2,510,360.20	93.39	307,900.00	61.93
1-2 年	20,000.00	0.69			189,288.40	38.07
2-3 年	177,588.40	6.09	177,588.40	6.61		0
合 计	2,918,325.29	100.00%	2,687,948.60	100.00%	497,188.40	100.00%

截至2018年7月31日，公司预收账款金额2,918,325.29元，报告期内公司预收账款为公司已向客户收取的货款，但不符合收入确认原则形成的款项。公司大部分预收账款账龄为一年以内，长账龄的预收款较少，金额变动符合公司的实际运营情况。

（2）报告期内预收账款前五名情况：

2018 年 7 月 31 日预收账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	江苏格立特电子股份有限公司	非关联方	2,182,360.20	货款	1 年以内
2	苏州市锐拓微电子有限公司	非关联方	485,965.09	货款	1 年以内 288,376.69 1-2 年 20,000.00, 2-3 年 177,588.40
3	苏州微邦电子有限公司	非关联方	150,000.00	货款	1 年以内
4	无锡费尔森电子设备有限公司	非关联方	100,000.00	货款	1 年以内
合计			2,918,325.29		

2017 年 12 月 31 日预收账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	江苏格立特电子股份有限公司	非关联方	1,732,360.20	货款	1 年以内
2	苏州格尼达机电有限公司	非关联方	500,000.00	货款	1 年以内
3	苏州市锐拓微电子有限公司	非关联方	397,588.40	货款	1 年以内 220,000.00, 2-3 年 177,588.40
4	北京中电科电子装备有限公司	非关联方	58,000.00	货款	1 年以内
合计			2,687,948.60		

2016 年 12 月 31 日预收账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	苏州拓为机电有限公司	非关联方	307,900.00	货款	1 年以内
2	苏州市锐拓微电子有限公司	非关联方	189,288.40	货款	1-2 年

合计		497,188.40		
----	--	------------	--	--

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 7 月 31 日
一、短期薪酬	150,485.27	1,435,464.16	1,409,806.16	176,143.27
二、离职后福利-设定提存计划		119,892.74	119,892.74	
合 计	150,485.27	1,555,356.90	1,529,698.90	176,143.27

续：

项 目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	87,008.40	1,962,654.67	1,899,177.80	150,485.27
二、离职后福利-设定提存计划		102,450.92	102,450.92	
合 计	87,008.40	2,065,105.59	2,001,628.72	150,485.27

续：

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	48,507.35	1,299,897.79	1,261,396.74	87,008.40
二、离职后福利-设定提存计划		41,716.17	41,716.17	
合 计	48,507.35	1,341,613.96	1,303,112.91	87,008.40

2、短期薪酬列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 7 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	150,485.27	1,095,181.60	1,090,073.60	155,593.27
二、职工福利费		119,372.47	119,372.47	
三、社会保险费		34,807.57	34,807.57	
其中：医疗保险费		23,205.04	23,205.04	

工伤保险费		3,867.51	3,867.51	
生育保险费		7,735.02	7,735.02	
四、住房公积金		68,415.52	68,415.52	
五、劳务派遣工资		117,687.00	97,137.00	20,550.00
合 计	150,485.27	1,435,464.16	1,409,806.16	176,143.27

续:

项 目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	87,008.40	1,568,598.49	1,505,121.62	150,485.27
二、职工福利费		93,267.53	93,267.53	
三、社会保险费		29,743.82	29,743.82	
其中: 医疗保险费		19,829.21	19,829.21	
工伤保险费		3,304.87	3,304.87	
生育保险费		6,609.74	6,609.74	
四、住房公积金		54,801.53	54,801.53	
五、劳务派遣工资		216,243.30	216,243.30	
合 计	87,008.40	1,962,654.67	1,899,177.80	150,485.27

续:

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,507.35	1,100,980.70	1,062,479.65	87,008.40
二、职工福利费		30,819.00	30,819.00	
三、社会保险费		12,111.15	12,111.15	
其中: 医疗保险费		8,074.10	8,074.10	
工伤保险费		1,345.68	1,345.68	
生育保险费		2,691.37	2,691.37	
四、住房公积金		21,576.00	21,576.00	
五、劳务派遣工资		134,410.94	134,410.94	
合 计	48,507.35	1,299,897.79	1,261,396.74	87,008.40

3、设定提存计划列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 7 月 31 日
1、基本养老保险		116,025.23	116,025.23	
2、失业保险费		3,867.51	3,867.51	
合 计		119,892.74	119,892.74	

续：

项 目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		99,146.05	99,146.05	
2、失业保险费		3,304.87	3,304.87	
合 计		102,450.92	102,450.92	

续：

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		40,370.49	40,370.49	
2、失业保险费		1,345.68	1,345.68	
合 计		41,716.17	41,716.17	

报告期内，公司应付职工薪酬主要是短期薪酬。

（四）应交税费

报告期内公司应交税费情况如下：

单位：元

项 目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	162,764.67	29,325.23	278,337.03
印花税	217,995.62	4,334,314.71	780,886.20
企业所得税	4,938.29	2,455.44	
城建税	11,393.53	2,052.77	19,483.59
教育费附加	4,882.94	879.76	8,350.11
地方教育费附加	3,255.29	586.50	5,566.74
个人所得税	631.80	24,154.00	633.00
合 计	405,862.14	4,393,768.41	1,093,256.67

报告期内，公司按照规定的税种与税率依法纳税。

(五) 其他应付款

1、报告期内公司其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	2018 年 7 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	775,745.71	100.00	6,173,619.33	100.00	15,122,381.97	100.00
合 计	775,745.71	100.00	6,173,619.33	100.00	15,122,381.97	100.00

2、报告期内公司其他应付款按款项性质列示如下表：

单位：元

项目	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	772,153.86	6,170,719.33	15,122,381.97
员工报销款	3,591.85	2,900.00	
合计	775,745.71	6,173,619.33	15,122,381.97

3、报告期内其他应付款前五名列示如下表：

2018 年 7 月 31 日其他应付款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	李伟	关联方	500,000.00	往来款	1 年以内
2	苏州英尔捷智能控制有限公司	关联方	185,153.86	往来款	1 年以内
3	苏州晶捷芯半导体科技有限公司	关联方	87,000.00	往来款	1 年以内
4	张建	关联方	2,400.00	员工报销款	1 年以内
5	李勇	非关联方	1,191.40	员工报销款	1 年以内
合计			775,745.26		

2017 年 12 月 31 日其他应付款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
----	------	-------	-------	------	----

1	苏州冠群微电子有限公司	关联方	4,670,719.33	往来款	1年以内
2	苏州捷研芯纳米科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	往来款	1年以内
3	李伟	关联方	502,900.00	往来款	1年以内
合计			6,173,619.33		

2016年12月31日其他应付款前五名情况如下表：

单位：元

序号	公司名称	与公司关系	金额（元）	款项性质	账龄
1	李伟	关联方	15,122,381.97	往来款	1年以内
合计			15,122,381.97		

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年7月31日公司其他应付款金额分别为15,122,381.97元、6,173,619.33元、775,745.71元，主要系关联方李伟、苏州英尔捷智能控制有限公司、苏州晶捷芯半导体科技有限公司向公司提供免息暂借款，以补充经营性资金流。

公司其他应付款期末余额中有关应付关联方款项详见下文“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”。

七、报告期的股东权益情况

报告期内公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
股本（实收资本）	48,800,000.00	38,800,000.00	1,000,000.00
资本公积	1,219,785.46	11,219,785.46	
盈余公积	184,890.21	184,890.21	273,846.26
未分配利润	2,084,488.89	1,495,401.67	2,464,616.33
少数股东权益			
合计	52,289,164.56	51,700,077.34	3,738,462.59

公司实收资本形成情况详见上文“第一节”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”。

八、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1. 控股股东、实际控制人

序号	关联方名称	持股比例（%）	与公司关系
1	苏州英尔捷智能控制有限公司	59.28%	控股股东
2	陆孙华	间接持股 59.28%	实际控制人、董事长、总经理

2. 不存在控制关系的关联自然人

序号	关联方名称	与公司关系
1	沈霞	董事、财务负责人、董秘
2	李伟	董事、间接持股 5%以上的股东
3	叶明	董事
4	张建	董事
5	陈荣	监事
6	沈平	监事
7	任艳	监事
8	蔡 娥	持股 5%以上法人股东苏州英格诺智能科技有限公司的实际控制人
9	潘道强	报告期内曾任公司董事

10	蒋卫凤	董事、间接持股 5%以上的股东的妻子，股份公司曾任监事
11	陆祎文	实际控制人陆孙华之子

3. 其他关联方

序号	关联方名称	经营范围	关联关系说明
1	苏州英尔捷智能控制有限公司	自动化控制系统、计算机及物联网领域的技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司控股股东
2	上海朴存投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。	持股 5%以上法人股东的实际控制人担任法定代表人、股东、高管的企业
3	苏州英尔捷半导体有限公司	开发、生产、销售：半导体及电子元器件、电子产品、电器、仪器仪表及设备；集成电路和半导体器件制造、测试服务，并提供与集成电路和半导体器件相关的售后服务和技术咨询；从事上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	拟挂牌公司的全资子公司
4	苏州英尔捷芯片设计有限公司	半导体、集成电路芯片设计、销售，并提供相关技术服务；计算机系统集成；软件开发、销售，并提供技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	拟挂牌公司的全资子公司
5	上海喜之家创业投资中心(有限合伙)	创业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	实际控制人陆孙华持有该公司 50%的出资额比例，并担任此公司法定代表人和执行事务合伙人。
6	上海同济建筑工程有限公司	建筑装修装饰建设工程设计施工一体化，建筑施工，绿化工程施工，建筑装潢材料，化工产品（不含危险品），机电产品，房屋装潢，通风管道安装，水电安装，制冷设备安装；木制家具的生产、销售；花卉、盆景制作销售与租赁，工艺品制作销售，电脑图文设计制作，旅游用品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件销售，商务信息咨询，企业管理咨询，建筑智能化建设工程专业施工，计算机网络系统工程服务，计算机维修，机械设备的维修、安装。【依法须经批准的项目，	实际控制人陆孙华担任此公司董事

		经相关部门批准后方可开展经营活动】	
7	上海同舟电梯有限公司	电梯维修保养, 电梯内装潢, 电梯配件销售, 水箱水泵, 普通机械维修, 机械配件加工, 空调设备安装、维修, 提供劳务; 消防设施工程。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	实际控制人陆孙华担任此公司董事
8	苏州英格诺智能科技有限公司(曾用名“苏州英格诺纳米科技有限公司”)	智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	公司董事李伟持有该企业 22%的股权, 并担任监事
9	苏州冠群微电子有限公司	研发、销售: 集成电路、半导体设备、电子产品。销售: 机电设备及配件, 并提供相关上门维修、保养服务, 技术咨询服务、从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	公司董事李伟报告期内曾为该公司的实际控制人(2017 年 12 月已退出)
10	苏州晶捷芯半导体科技有限公司	研发、生产、销售: 半导体设备、集成电路、电子元器件; 销售: 机电设备及配件, 并提供相关上门维修、保养服务; 从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	报告期内曾经是董事李伟控制及担任法定代表人的企业, 2017. 12. 18 日已经转让给无关联方于军、黄静兰。
11	临沂泰源资产管理有限公司	企业自有资金对外投资、股权投资、股权投资管理(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务))(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)未经金融监管部门审批, 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)	公司董事叶明持有该企业 30%的股权

12	潍坊弘景源投资中心（有限合伙）	以企业自有资金对中小企业进行项目投资；商务信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临沂泰源资产管理有限公司持有潍坊弘景源投资中心（有限合伙）50%的出资额比例，担任执行事务合伙人，叶明持有临沂泰源资产管理有限公司30%的出资额，故叶明间接持有临沂泰源资产管理有限公司（有限合伙）15%的出资额。
13	潍坊泰兴源投资中心（有限合伙）	以企业自有资金对中小企业进行项目投资；商务信息咨询（以上范围不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临沂泰源资产管理有限公司持有潍坊泰兴源游资中心（有限合伙）50%的出资额比例，担任执行事务合伙人，叶明持有临沂泰源资产管理有限公司30%的股权，故叶明间接持有潍坊泰兴源游资中心（有限合伙）15%的出资额。
14	上海寰旭文化传播有限公司	文化艺术交流活动策划，企业形象策划，图文设计制作，市场营销策划，体育赛事活动策划，公关活动策划，商务咨询，企业管理咨询，会展服务，鲜花的销售，婚庆礼仪服务，摄影摄像服务，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司监事任艳持有该企业50%的股权，并任监事
15	上海鼓霓新能源科技有限公司	新能源、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子产品、日用百货、金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、五金交电、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司监事任艳持有该企业1%的股权，并任监事

16	上海曙荣信息科技有限公司	信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软硬件开发，计算机系统集成服务，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司监事任艳任该企业监事；公司实际控制人陆孙华之子陆祎文 100%控股该企业，为该企业的实际控制人。
17	苏州盛世通网络技术有限公司	许可经营范围:一般经营范围:提供计算机软硬件开发、企业管理咨询、电子商务咨询、通讯（网通）业务代理。	公司董事、财务总监、董事会秘书沈霞的配偶姚家根持有该企业 84%的股权，并任该企业的法定代表人、执行董事兼总经理。
18	苏州华信商务咨询有限公司	提供商务咨询、企业营销策划、信息中介；计算机软硬件开发；销售五金交电、日用百货、玩具、非危险化学品原料和产品、工艺品、办公用品、建材、水性涂料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司董事、财务总监、董事会秘书沈霞的配偶姚家根持有该企业 70%的股权，并任该企业的法定代表人、执行董事。
19	姑苏区顺合和棋牌室	棋牌活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司董事、财务总监、董事会秘书沈霞的配偶姚家根实际控制该个体户企业
20	赴港资产管理（上海）有限公司	资产管理，投资管理，实业投资，投资信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，证券咨询（不得从事金融、证券、保险业务），保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），会务服务，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	持股 5%以上法人股东的实际控制人蔡娥担任法定代表人、股东、执行董事的企业

（三）关联方交易

1. 关联方采购情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年 1-7 月发生额		2017 年度发生额		2016 年度发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

苏州冠群微电子有 限公司	采购设 备	协议定 价	0	0	0	0	3,608,868.38	19.98
-----------------	----------	----------	---	---	---	---	--------------	-------

主要基于公司所采购的二手设备为半导体切割、研磨及封装设备，此行业的设备生产商集中在美国与日本，由于芯片行业的敏感性，美日两国相关设备对华禁售或价格高昂，二手设备来源多为韩国和台湾，该供应商在此行业深耕多年，有较为广阔的二手设备渠道且价格低廉。相应采购设备未显著高于非关联方供应商的报价，可确认为采购价格是公允的。同时为减少关联交易公司从 2017 年开始停止从苏州冠群微电子有限公司采购二手半导体设备，故不存在对关联方的持续依赖。

2. 关联方销售情况：

单位：元

关联方	关联交 易内容	关联交 易定价 方式及 决策程 序	2018 年 1-7 月发生额		2017 年度发生额		2016 年度发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
苏州冠群微电子有 限公司	销售商 品	协议定 价	0	0	0	0	1,538,461.54	8.70

报告期，公司主营业务包括销售半导体设备及配件，而苏州冠群微电子有限公司主要业务为二手半导体设备的销售，公司销售给该客户的设备系根据客户需求进行定制采购，再由公司工程师对相应的设备进行升级改造之后的设备。相应设备价格采用协议定价，销售价格未显著高于或低于其他无关联客户的价格，可确认为销售价格公允，占公司同类交易的比重较小，故不存在对关联方的持续依赖。

报告期内，公司经营对关联交易不存在依赖，未影响公司的独立性，公司的资产独立、完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

3. 关联方资金拆借：

单位：元

关联方	2018 年 1-7 月
-----	--------------

	年初余额	拆入金额	归还金额	年末余额
苏州冠群微电子有限公司	4,670,719.33		4,670,719.33	
李伟	500,000.00			500,000.00
苏州英尔捷智能控制有限公司		18,771,302.80	18,586,148.94	185,153.86
苏州晶捷芯半导体科技有限公司		87,000.00		87,000.00
合计	5,170,719.33	18,858,302.80	23,256,868.27	772,153.86

(续)

关联方	2018年1-7月			
	年初余额	拆出金额	收回金额	年末余额
苏州英尔捷智能控制有限公司	1,148,542.34		1,148,542.34	
苏州冠群微电子有限公司	3,092,389.00		3,092,389.00	
合计	4,240,931.34		4,240,931.34	

(续)

关联方	2017年度			
	年初余额	拆入金额	归还金额	年末余额
苏州冠群微电子有限公司		5,000,000.00	329,280.67	4,670,719.33
李伟	15,122,381.97	9,122,750.69	23,745,132.66	500,000.00
合计	15,122,381.97	14,122,750.69	24,074,413.33	5,170,719.33

(续)

关联方	2017年度			
	年初余额	拆出金额	收回金额	年末余额
苏州英尔捷智能控制有限公司		35,835,385.00	34,686,842.66	1,148,542.34
苏州冠群微电子有限公司		3,092,389.00		3,092,389.00
合计		38,927,774.00	34,686,842.66	4,240,931.34

(续)

关联方	2016年度			
	年初余额	拆入金额	归还金额	年末余额
李伟	22,456,933.65	12,200,262.92	19,534,814.60	15,122,381.97
合计	22,456,933.65	12,200,262.92	19,534,814.60	15,122,381.97

(四) 关联方往来款项余额

单位：元

项目名称	关联方	2018年7月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款	苏州英尔捷智能控制有限公司		1,148,542.34	
其他应收款	苏州冠群微电子有限公司		3,092,389.00	
应付账款	苏州冠群微电子有限公司			2,766,176.00
其他应付款	苏州冠群微电子有限公司		4,670,719.33	
其他应付款	苏州英尔捷智能控制有限公司	185,153.86		
其他应付款	李伟	500,000.00	502,900.00	15,122,381.97
其他应付款	张建	2,400.00		
其他应付款	苏州晶捷芯半导体科技有限公司	87,000.00		

报告期初至公开转让说明书签署之日，公司与关联方苏州英尔捷智能控制有限公司、苏州冠群微电子有限公司、李伟、苏州晶捷芯半导体科技有限公司存在多笔资金拆入、拆出往来，系公司资金周转需要而发生，且都未收取利息。公司向关联方借款，能够有效解决公司流动资金需求，控制公司融资成本，具有一定的持续性和必要性；但从长期来看，随着公司运营能力逐渐增强，公司计划通过资本市场融资，关联方资金拆入将不再具有必要性或持续性。公司拆出资金发生在有限公司阶段，公司的相应内控不规范，各项制度不健全，公司已经于2018年7月31日之前全部收回了相应的拆出资金，而且公司将进一步规范运营，严格限制对关联方的运营资金的出借。

有限公司阶段，公司各项制度不健全，内控存在不规范之处，公司章程及内部规定尚未制定详细的关联交易及资金拆借等重大事项的审批流程，上述资金拆入及拆出在有限公司阶段发生时未经股东会审议。股份公司成立后发生的资金拆入均履行了相关的审批程序。

综上，报告期内，公司与关联方的关联交易不存在严重损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

为了防止再次发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况，公司制定了《公司章程》、《关联方交易管理制度》等。截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、资产或其他资源被关联方占用的情形。控股股东、实际控制人、主要股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，承诺本人或本人控制的企业严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

（五）减少和规范关联交易的安排

1、关联交易决策程序

公司为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，已建立起完善的内部控制制度，制定《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等，对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。公司已在《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》中制定了对外担保、关联交易的相关审批和决策制度，对于将来可能发生的对外担保、关联交易情况，公司将严格按照上述规章制度的规定履行相关决策程序。

2、减少和规范关联交易的承诺

为了防止再次发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况，公司制定了《公司章程》、《关联方交易管理制度》等。截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、资产或其他资源被关联方占用的情形。控股股东、实际控制人、主要股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，承诺本人或本人控制的企业严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需提醒投资者关注的其他重要事项。

十、报告期内的资产评估情况

有限公司改制设立股份公司时，委托北京亚超资产评估有限公司对公司全部资产及负债进行了资产评估，评估基准日为 2017 年 11 月 30 日，2018 年 1 月 15 日，北京亚超资产评估有限公司出具了北京亚超评报字（2018）第 A013 号《资产评估报告》。

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	4,112.30	4,112.30	-	-
非流动资产	4,981.42	4,996.34	14.92	0.30
其中：长期股权投资	320.00	320.00	-	-
固定资产	4,143.55	4,158.46	14.91	0.36
长期待摊费用	468.27	468.27	-	-
递延所得税资产	49.60	49.60	-	-
资产总计	9,093.72	9,108.64	14.92	0.16
流动负债	4,081.16	4,081.16	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	4,081.16	4,081.16	-	-
净资产（所有者权益）	5,012.57	5,027.48	14.91	0.30

股份公司设立时，未按照上述评估结果调整公司的资产、负债的账面值。

十一、股利分配情况

（一）公司股利分配政策

有限公司时期，公司未约定股利分配政策。整体变更为股份公司后，《公司章程》对股利分配约定如下：

第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司

法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第一百六十二条 公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。由董事会拟定方案，经股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期分配股利的情况。

单位：元

项目	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度
普通股股利（股票股利）	10,000,000.00	0	0

合计		0	0
----	--	---	---

2018年3月16日，股份公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于苏州英尔捷微电子股份有限公司以资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积转增股本，以现有总股本38,800,000股为基数，以资本公积10,000,000.00元向全体股东以每10股转增2.577320股，资本公积转增共计10,000,000股。资本公积转增股本前公司总股本为38,800,000股，转增股本后股本增至48,800,000股。

2018年6月4日，上海仟一会计师事务所有限公司出具了编号为“沪仟验字（2018）第0036号”验资报告，报告确认：“经我们审验，截至2018年7月31日止，贵公司已收到资本公积金人民币1,000.00万元转增股本，变更或的注册资本为人民币4,880.00万元、累计实收资本为人民币4,880.00万元”。

公司已经按照规定，对负有纳税义务的自然人股东王建国分配的股息、红利代扣代缴了个人所得税，履行了纳税义务。

（三）未来股利分配政策

公司未来的股利分配根据“（一）公司股利分配政策”来执行。

十二、控股子公司情况

（一）公司基本情况

单位名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
苏州英尔捷半导体有限公司	苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园19-2号厂房	1,500.00	开发、生产、销售；半导体及电子元器件、电子产品、电器、仪器仪表及设备；集成电路和半导体器件制造、测试服务，并提供与集成电路和半导体器件相关的售后服务和技术咨询；从事上述产品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00
苏州英尔捷芯片设计有限公司	苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场1幢1507室	2,000.00	半导体、集成电路芯片设计、销售，并提供相关技术服务；计算机信息系统集成；软件开发、销售，并提供技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00

（二）主要财务指标

单位：元

苏州英尔捷半导体有限公司			
项目	2018 年 1-7 月 /2018. 7. 31	2017 年度/2017. 12. 31	2016 年度 /2016. 12. 31
资产总额	6, 507, 587. 67	3, 834, 526. 59	0
负债总额	574, 237. 37	294, 536. 83	0
净资产额	5, 933, 350. 30	3, 539, 989. 76	0
营业收入	3, 812, 865. 42	398, 475. 13	0
净利润	93, 360. 54	-168, 610. 24	0

其中：苏州英尔捷半导体有限公司的收入构成如下：

单位：元

项目	2018 年 1-7 月		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
晶圆切割研磨	3, 812, 865. 42	100. 00	398, 475. 13	100. 00
合计	3, 812, 865. 42	100. 00	398, 475. 13	100. 00

苏州英尔捷半导体报告期内收入前五名情况如下：

单位：元

2018 年 1-7 月销售前五名情况		
名称	销售金额	占比 (%)
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	1, 539, 040. 95	40. 36
南京矽邦半导体有限公司	475, 136. 59	12. 46
上海泰睿思微电子有限公司	347, 103. 97	9. 10
无锡麟力科技有限公司	196, 920. 42	5. 16
苏州洛合镭信光电科技有限公司	178, 323. 09	4. 68
合计	2, 736, 525. 02	71. 77
2017 年销售前五名		
名称	销售金额	占比 (%)
江苏格立特电子股份有限公司	165, 489. 74	41. 53
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	129, 188. 03	32. 42
上海泰睿思微电子有限公司	46, 119. 66	11. 57
江苏尚飞光电科技有限公司	16, 923. 08	4. 25
淮安元源光电科技有限公司	16, 422. 22	4. 12
合计	374, 142. 73	93. 89

注：截至 2018 年 7 月 31 日，子公司苏州英尔捷芯片设计有限公司尚未开展经营活动，

且注册资本并未实际缴纳。

十三、风险因素及自我评估

（一）实际控制人变更风险

有限公司成立初期，李伟持为公司的控股股东及实际控制人。2017年9月，李伟将其持有的股权全部转让，不再是公司的控股股东及实际控制人。同时，英尔捷智能向公司进行增资，持股比例为59.28%，成为公司的控股股东，陆孙华同时成为公司的实际控制人。公司实际控制人变更前后，公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未产生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

风险管理措施：公司依法制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循，从而避免可能的实际控制人控制而损害股东利益的情形，保障全体股东的利益。

（二）公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和总经理组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了公司治理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较晚，公司治理层对相关规章制度还尚未理解和全面执行。因此，短期内仍存在公司治理不规范的风险。

风险管理措施：针对上述潜在风险，公司将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，不断完善公司内部控制制度，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

（三）行业政策变动的风险

集成电路产业属于国家鼓励发展的行业，国家相关主管部门多年来陆续颁布了多项支持集成电路产业发展的规划和政策，充分体现出国家对集成电路产业的重视。国家的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前一系列的政策性文件对行业的发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业的发展，另外还存在一些政策落实不到位、与市场脱节的情况，这些都可能对公司生产经营造成不利影响。

风险管理措施：公司认为随着持续不断的产业转移，国内集成电路产业仍然处于快速发展周期之中，同时随着经济开始复苏，未来几年市场仍然将保持增长态势。公司未来将开拓集成电路整包服务，加强与产业链上下游联系合作，并借助国家重大专项的实施还将投入资金添置测试设备，从业务结构和产能上进一步提升公司的竞争实力，降低行业波动给公司带来的风险。

（四）宏观经济波动的风险

集成电路芯片运用范围广，产品涉及消费类电子、工业控制、汽车电子、医疗等诸多领域，尤其是消费类电子领域，市场规模大，产品更新速度快等特点为集成电路芯片的应用提供了巨大的发展空间。但同时消费类电子也是受宏观经济波动影响较为明显的行业，一旦宏观经济发生波动，下游市场的需求萎缩将会阻碍本行业的持续发展。

风险管理措施：公司会不断加强研发投入，保持公司技术在行业内的竞争地位，同时加强公司的内部控制，完善公司治理机制，对成本加强控制，提升自身的综合实力，以降低因宏观经济波动带来的风险。

（五）技术研发与创新风险

集成电路行业所面对的下游终端市场产品更新换代迅速，因此芯片产品生命周期很短，升级频繁。为了在行业中保持一定的竞争力，要求集成电路公司在技术创新及新产品开发方面持续投入，不断创新，开发出市场认可的新产品和升级产品，才能实现持续成长。公司未来若无法保持对行业高端人才的吸引力，维持一支具有持续创新能力、良好项目管理能力和敏锐市场判断能力的人才队伍，则可能因研发和创新能力不足导致技术落后企业发展停滞。

集成电路企业还面临新产品研发风险,包括产品规划、研发周期及投入风险。产品规划包括产品路线图、新产品的开发以及功能定位。新产品的研发周期通常在两到三年,这取决于公司对未来两到三年甚至更长期的市场预判,而对未来市场预测的准确性往往存在一定的局限。若未来公司产品研发失败,或者不能被市场接受,不能实现量产,则投入的大量的研发资金不能产生效益。此外,研发周期如果过长会导致研发投入大幅增加,增加产品的研发成本,对公司的经营业绩造成不利影响。

风险管理措施:公司管理层及销售人员加强与客户沟通,研发人员及时了解行业动态,满足不同类型客户的各种需求,同时,加大研发投入,实现技术创新,以保证公司技术及产品在业内竞争力。

(六) 应收账款坏账风险

公司业务处于成长阶段,应收账款增加较快。2018年7月31日、2017年12月31日和2016年12月31日,公司应收账款余额分别为10,408,346.38元、11,524,790.43元、3,193,752.02元。随着公司业务发展,企业应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

风险管理措施:公司将进一步加强应收账款的管理,目前已派专人负责应收账款的管理和催收,缩短销售货款的回款周期,公司目前绝大部分应收账款账龄在2年以内。此外,公司在今后的业务开展过程中将加强对客户信用度的甄别和管理,侧重选择信誉度较高、付款周期较短的客户以减少应收账款的坏账风险。

(七) 经营场所后期装修未办理消防备案,存在被行政处罚的风险。

公司经营场所-苏州市工业园区双马街2号星华产业园19-2建设完成时已取得苏园公消竣复字(2015)第0010号的验收并已备案,但公司后期对经营场所的装修中未按相关规定及时进行第一时间进行消防备案。虽然公司备案工作已经

开始办理，然而，仍然存在被消防部门行政处罚的风险，可能会对公司及子公司经营产生不利影响。

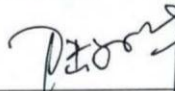
风险管理措施：目前公司已开始办理备案手续。实际控制人陆孙华，就公司因消防未及时备案导致公司承担赔偿责任或受到相关主管部门处罚，其本人将无条件对公司全额补偿，且不要求公司支付任何对价。为预防消防安全风险，公司制定了《消防安全管理制度》，定期检查消防栓、灭火器等消防设施设备；定期开展消防安全教育、培训，要求员工在生产经营的过程中严控消防安全。

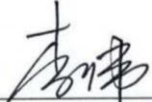
第五节 有关声明

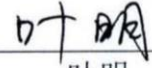
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）：


陆孙华

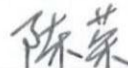

李伟


叶明

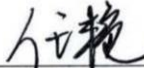

沈霞


张建

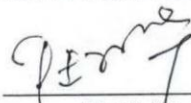
全体监事（签名）：


陈荣


沈平


任艳

全体高级管理人员（签名）：


陆孙华


沈霞



苏州英尔捷微电子股份有限公司

2018年12月27日

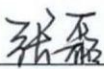
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表签字：



项目负责人签字：

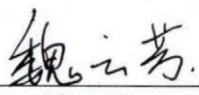


张磊

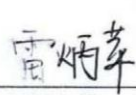
项目组人员签字：



张潇



魏云芳



雷炳强



开源证券股份有限公司

2018年12月27日

授权委托书

本人李刚（身份证号：612102197212210671）系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松（身份证号：330727198103240017）代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务（包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类）合同、相关申报文件、投标文件等，并办理相关事宜。

授权期间：自2018年9月1日起至2018年12月31日止。

同时，授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表，在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内，本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人（签字）：



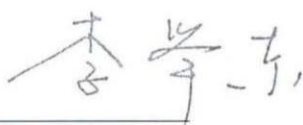
2018年9月1日



三、律师事务所声明

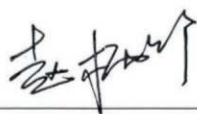
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：



李举东

经办律师签字：



赵柄竹



殷新

北京盈科(上海)律师事务所



2018年12月27日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字: _____

吕桦

签字注册会计师签字: _____



桂标



张琴



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

2018年12月27日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签字：


李应峰

签字注册资产评估师签字：







北京亚超资产评估有限公司



第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。

（正文完）